



FIZYCZNE PODSTAWY ELEKTRONIKI

dr hab. inż. Mateusz Pasternak

<http://mpasternak.wel.wat.edu.pl>

mateusz.pasternak@wat.edu.pl

bud. 80 p. 110, tel. 261 83 76 67

bud. 45. p.102, tel. 261 83 92 23

1

Podstawowe własności fizyczne

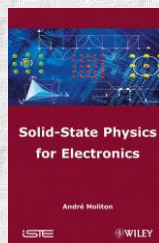
1. Prądu elektrycznego
2. Przewodników
3. Półprzewodników samoistnych
4. Półprzewodników domieszkowanych
5. Izolatorów
6. Materiałów o własnościach specjalnych

Zaliczenie na podstawie kolokwium końcowego, ocen z ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych

Konsultacje w czwartki po południu, piątki do 15.00 oraz poprzez dostępne media elektroniczne.
Inne dni po uprzednim umówieniu.

2

LITERATURA



Podstawowa

Antoni Rogalski, Podstawy fizyki dla elektroników, http://www.wtc.wat.edu.pl/wp-content/uploads/2018/04/podstawy_fizyki_dla_elektronikow.pdf, 2002.

André Moliton, Solid-State Physics for Electronics, Wiley 2010.

Aldert Ziel, Podstawy fizyczne elektroniki ciała stałego, WNT 1980.

Uzupełniająca

Zdzisław Celiński, Materiałoznawstwo elektrotechniczne, Oficyna Wyd. PW, wyd. 4, 2011

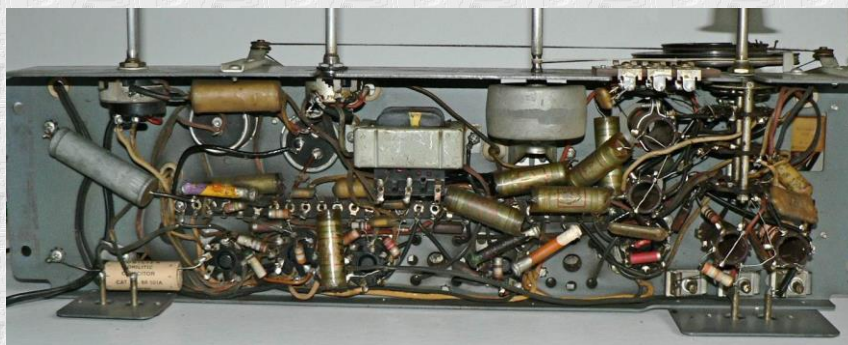
L. A. A. Warnes, Electronic Materials, Springer, 2014

3

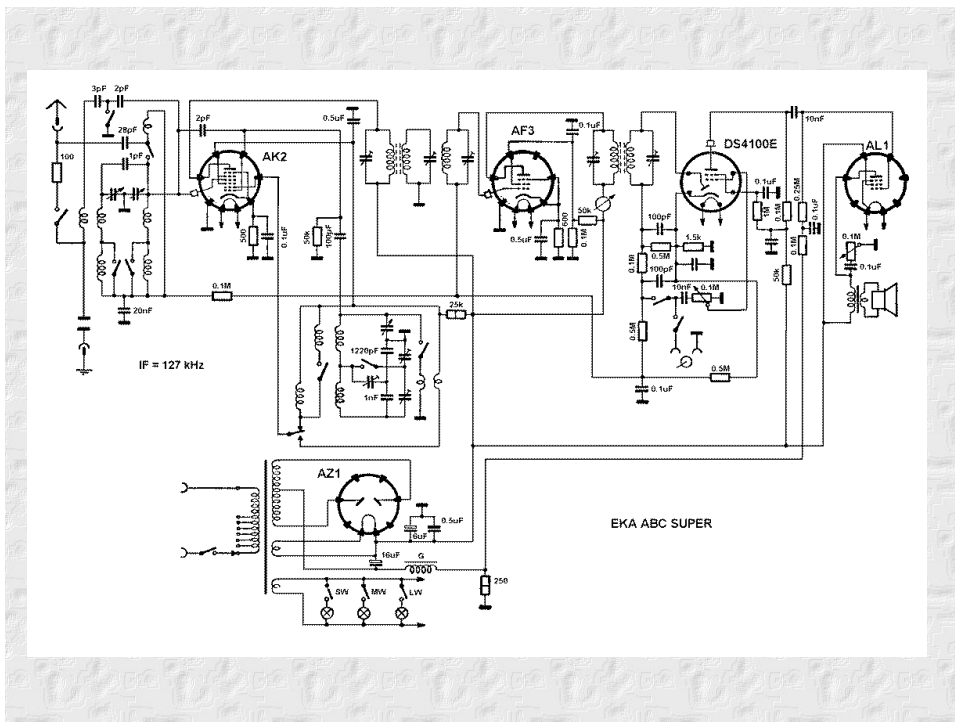
Elektronika szybko się zmienia



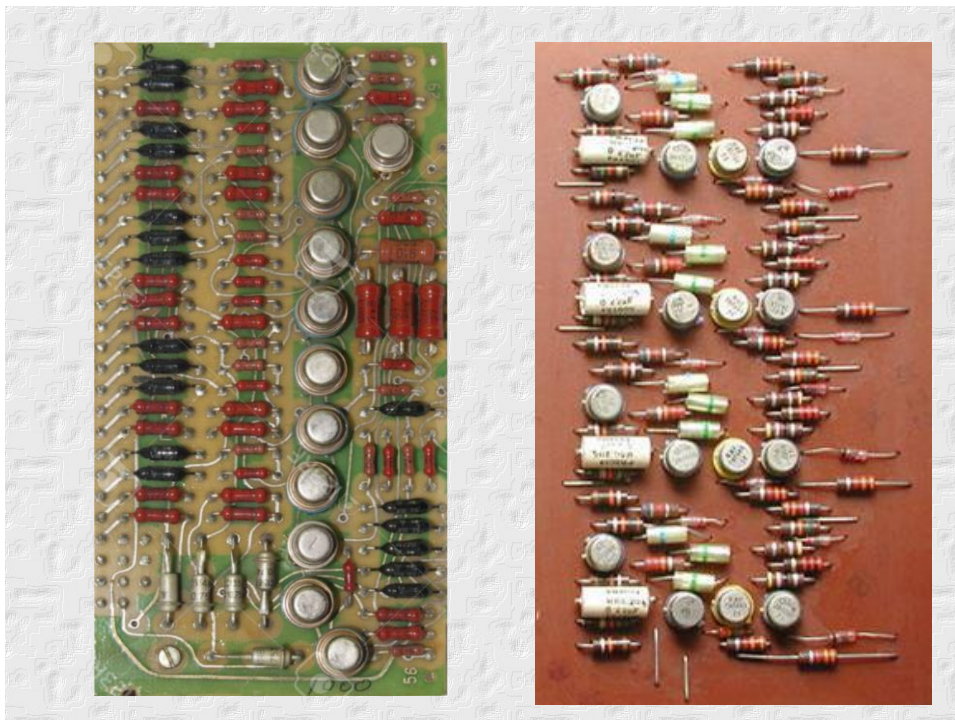
Prawa fizyki pozostają niezmienne



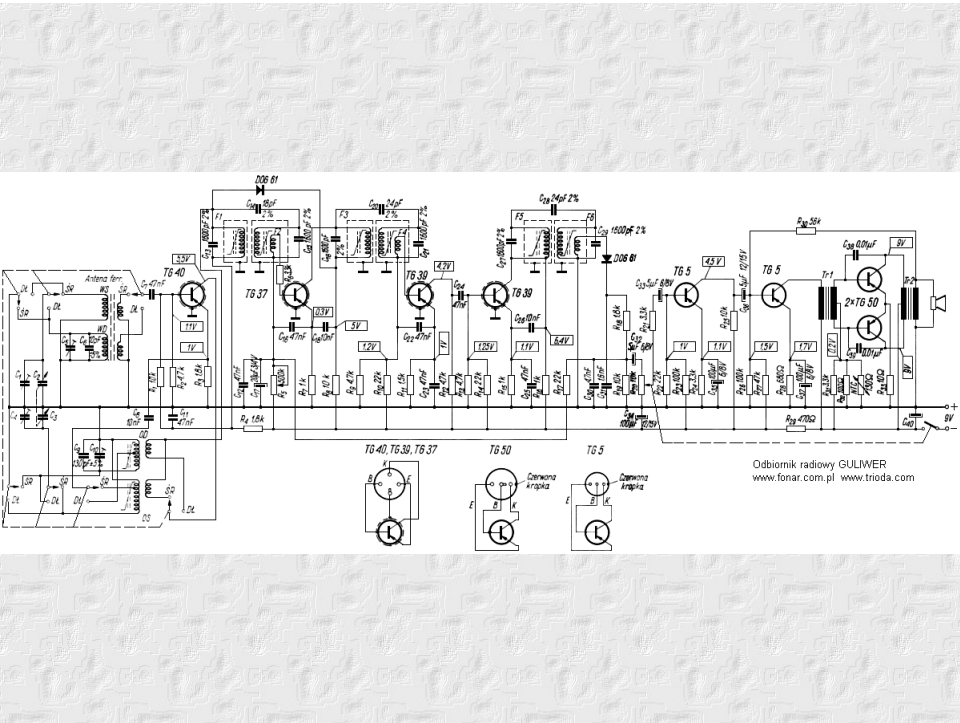
4



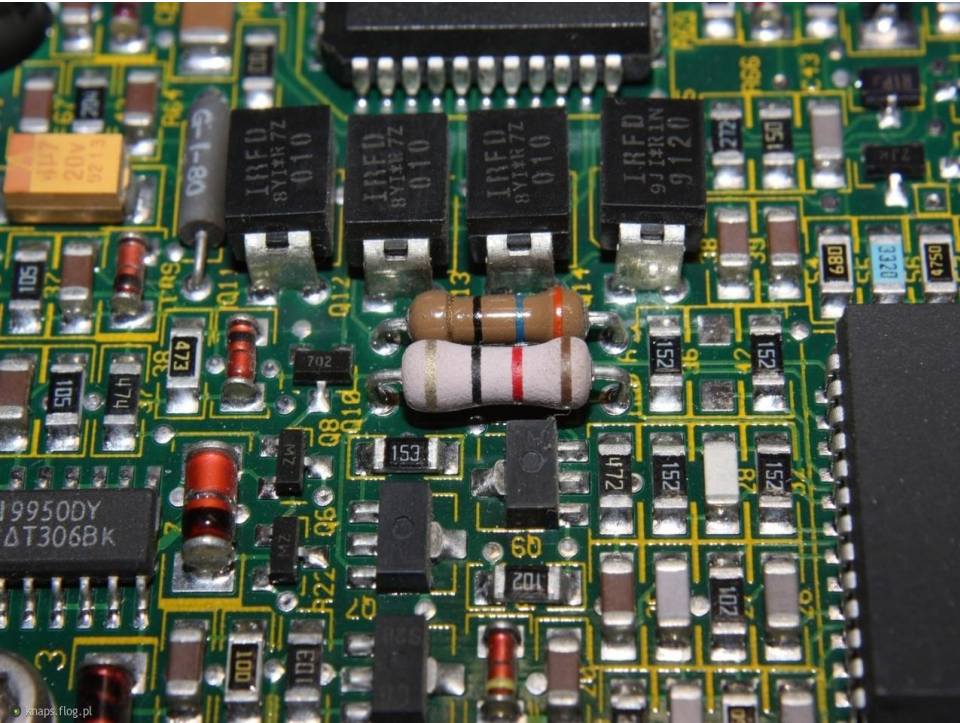
5



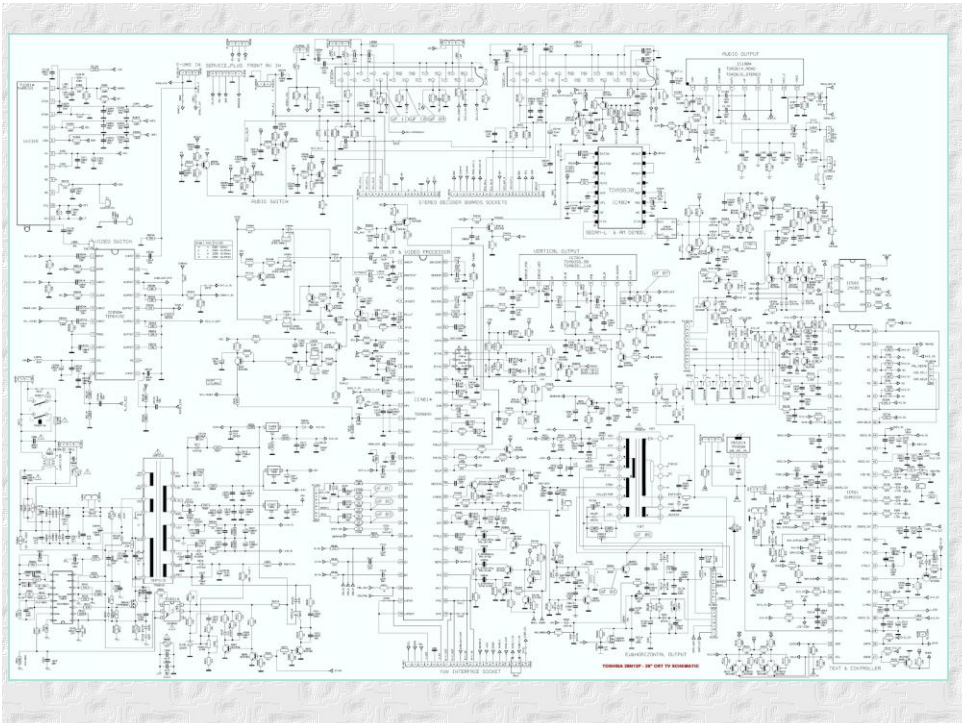
6



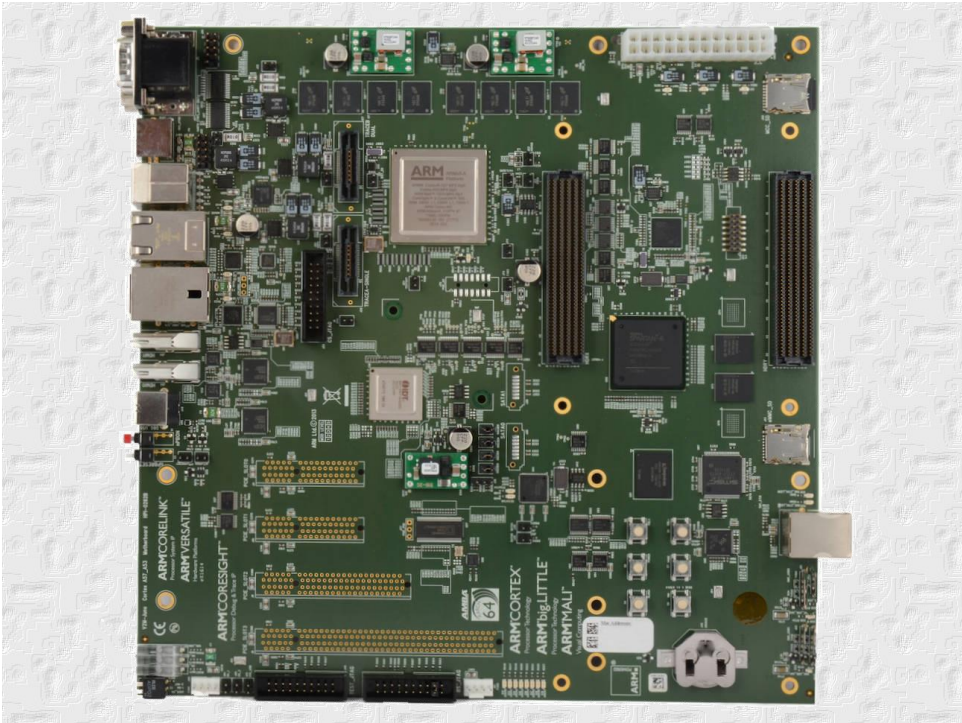
7



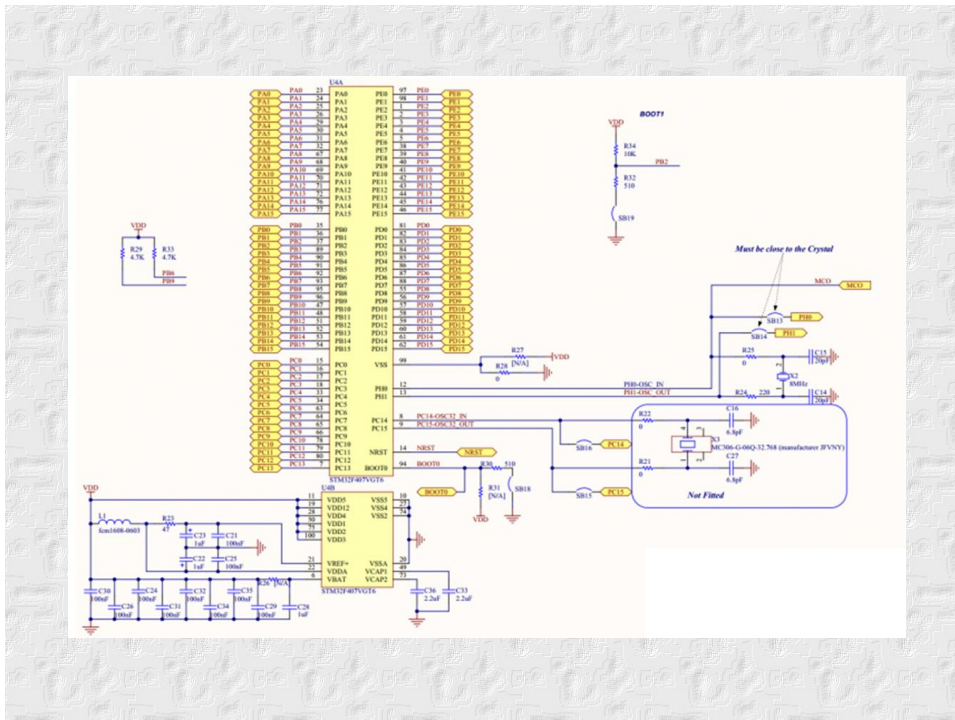
8



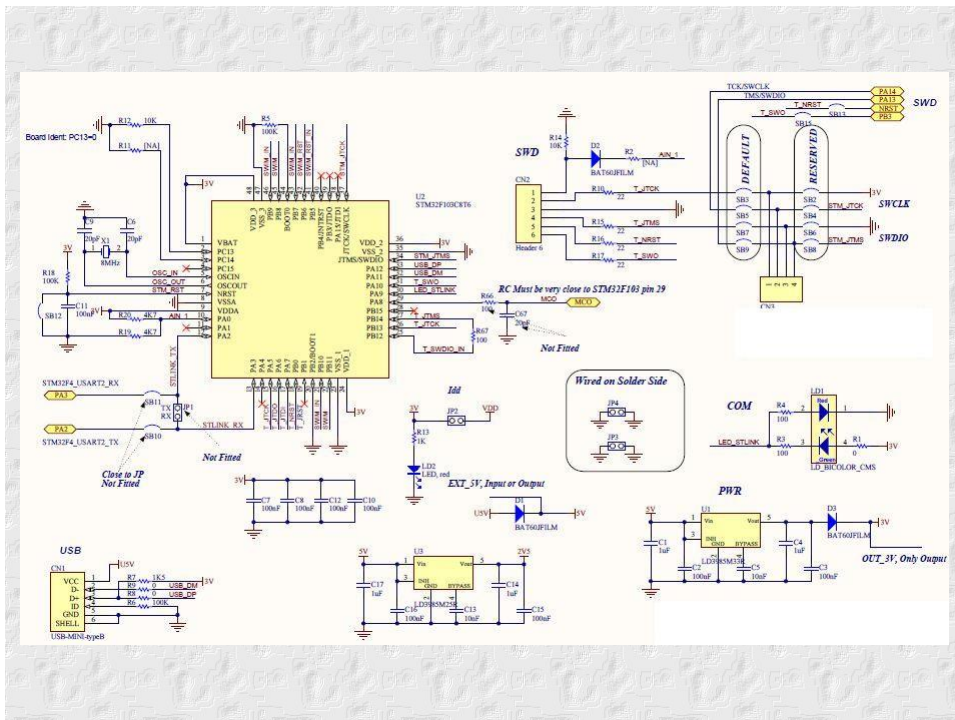
9



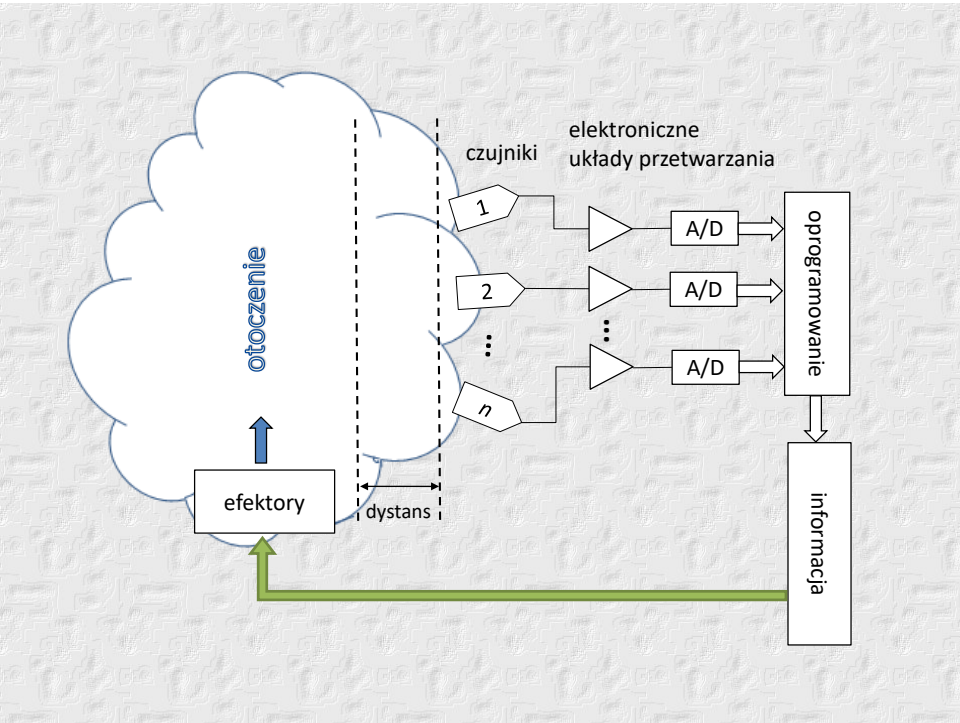
10



11



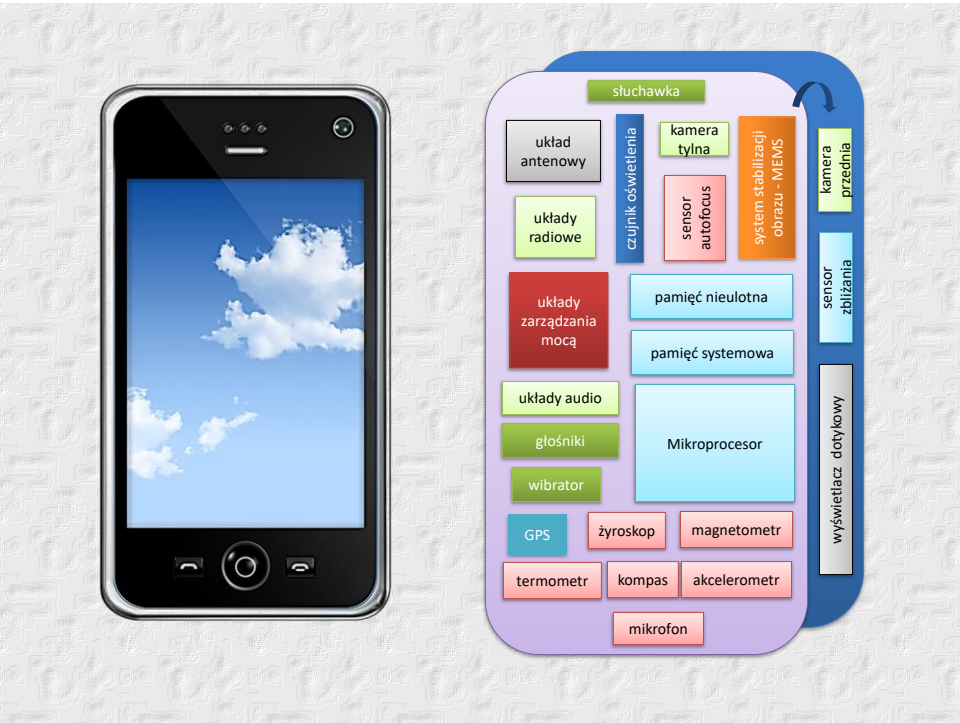
12



13



14



15

Wszystkie elementy elektroniczne wykonane są z materiałów będących pochodnymi istniejących pierwiastków

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 H 1,00784	2 He 4,002602																2 He 4,002602
3 Li 6,941	4 Be 9,012182																
5 Na 22,98976928	10 Mg 24,304																
19 K 39,0983	20 Ca 40,078	21 Sc 44,955912	22 Ti 47,88	23 V 50,9415	24 Cr 51,9961	25 Mn 54,938045	26 Fe 55,845	27 Co 58,933195	28 Ni 58,6934	29 Cu 63,546	30 Zn 65,38	31 Ga 69,723	32 Ge 72,64	33 As 74,9216	34 Se 78,96	35 Br 79,904	36 Kr 83,798
37 Rb 85,4678	38 Sr 87,62	39 Y 88,90584	40 Zr 91,224	41 Nb 92,90638	42 Mo 95,94	43 Tc 98	44 Ru 101,07	45 Rh 102,9055	46 Pd 106,42	47 Ag 107,8682	48 Cd 112,411	49 In 114,818	50 Sn 118,710	51 Sb 121,757	52 Te 127,6	53 I 126,90547	54 Xe 131,29
55 Cs 132,90545	56 Ba 137,327	57 La 138,90547	58 Ce 140,116	59 Pr 140,90768	60 Nd 144,242	61 Pm 144,9126	62 Sm 150,36	63 Eu 151,964	64 Gd 157,25	65 Tb 158,92534	66 Dy 162,5003	67 Ho 164,93032	68 Er 167,259	69 Tm 168,93421	70 Yb 173,044	71 Lu 174,967	
72 Hf 178,49	73 Ta 180,94735	74 W 183,84	75 Re 186,207	76 Os 190,23	77 Ir 192,222	78 Pt 195,084	79 Au 196,966569	80 Hg 200,59	81 Tl 204,3833	82 Pb 207,2	83 Bi 208,980398	84 Po 209	85 At 210	86 Rn 222	87 Fr 223	88 Ra 226	
89 Ac 227	90 Th 232,0377	91 Pa 231,03688	92 U 238,02891	93 Np 237,04817	94 Pu 244,0642	95 Am 243,061381	96 Cm 247	97 Bk 247	98 Cf 251	99 Es 252	100 Fm 257	101 Md 258	102 No 259	103 Lr 262	104 Rf 261	105 Db 262	106 Sg 266
107 Bh 264	108 Hs 277	109 Mt 268	110 Ds 271	111 Rg 272	112 Uub 285	113 Uut 284	114 Uuq 289	115 Uup 288	116 Uuh 292	117 Uus 294	118 Uuo 294	119 Uus 294	120 Uuo 294	121 Uuo 294	122 Uuo 294	123 Uuo 294	124 Uuo 294

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

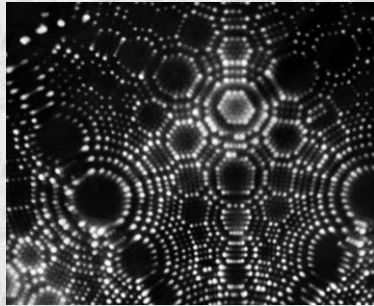
3

4

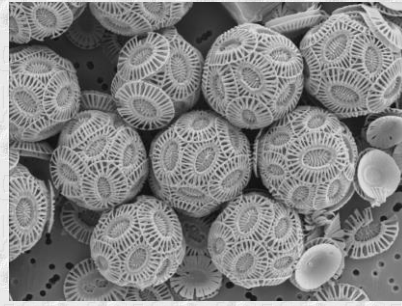
5</

16

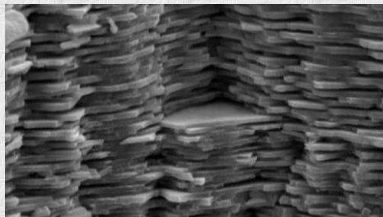
Własności materiałów wynikają zarówno z ich struktury atomowej, nanostruktury jak i struktury makroskopowej



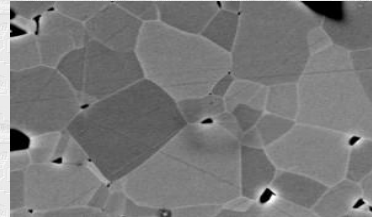
wolfram



kreda



macica perłowa



piezoceramika

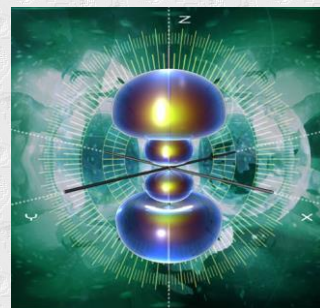
17

Atomy i ładunki

Jądro atomu składa się z protonów i neutronów. Ładunek dodatni protonów jest równy co wartości ładunkowi krążących wokół jądra elektronów.
Neutrony nie posiadają ładunku – atom jest elektrycznie obojętny.

Atom pozbawiony co najmniej jednego elektronu ma ładunek dodatni i nosi nazwę **JONU DODATNIEGO** (**KATIONU**)

Atom (cząsteczka), do którego dołączył się co najmniej jeden elektron nosi nazwę **JONU UJEMNEGO** (**ANIONU**)



ŁADUNKI = elektrony lub jony

Oznaczenie ładunków jest umowne

- za dodatnie uważa się takie, które gromadzą się na pręcie szklanym pocieranym jedwabiem
- za ujemne, ładunki gromadzące się na pręcie żywicznym pocieranym wełną

18

Elektron

e^- , β^- – trwała cząstka elementarna z rodziny leptonów będąca jednym z elementów atomu

elementarny ładunek elektryczny równy $e = -1,602\,176\,6208(98) \cdot 10^{-19}$ [C]

masa spoczynkowa $m_e \approx 9,109\,382\,91 \cdot 10^{-31}$ [kg]

promień $< 10^{-22}$ [m]

elektrony w atomach zajmują określony obszar (orbital) w przestrzeni wokół stosunkowo małego dodatniego **jądra**

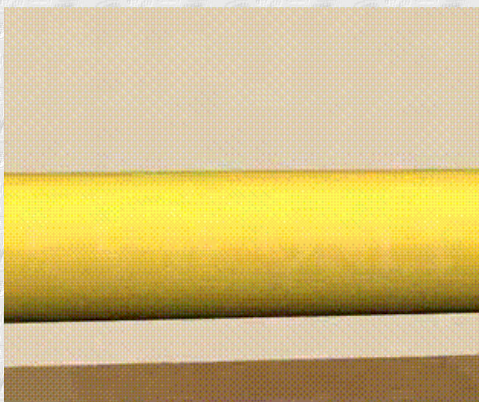
parametry orbitali zależą od oddziaływań elektronów z jądrem i pomiędzy sobą

rozmiary orbitali atomowych są rzędu 10^{-10} m – 1 Å czyli (w tzw. stanach wzbudzonych) mogą być kilkadziesiąt razy większe)

rozmiary orbitali są od 10 do 100 tysięcy razy większe od jądra atomowego, którego średnica wynosi od 10^{-15} do 10^{-14} m

19

Jeżeli ilość energii dostarczonej do atomu jest dostatecznie duża (np. energii cieplnej), to elektrony położone najdalej od jądra (elektrony walencyjne) mogą pokonać siły wiążące je z jądrem i stać się **elektronami swobodnymi**.



20

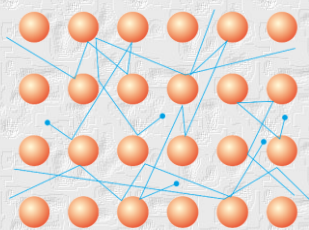
Założenia modelowe:

elektrony swobodne:

- są niezwiązane bądź słabo związane z atomami
- nie oddziałują ze sobą
- przeskakują między orbitalami
- poruszają się w sposób przypominający zderzenia z kationami
- poruszają się w sposób analogiczny do cząstek gęstego gazu
- są cząstkami punktowymi – praktycznie nie mają rozmiarów
- w próżni mają masę spoczynkową około $m_e = 0,511 \text{ MeV}/c^2$; $1 \text{ eV}/c^2 = 1,783 \times 10^{-36} \text{ kg}$
- w ośrodku mają masę mniejszą niż w próżni z uwagi na oddziaływania pól (tzw. masa efektywna) w skrajnych przypadkach może być ona ujemna (w Si $m_e^* = 0,36 m_e$, w InP $m_e^* = 0,08 m_e$) ponieważ masa zależy od energii kinetycznej może być różna w różnych kierunkach

21

Maksymalna liczba elektronów swobodnych w jednostce objętości metalu (dobrego przewodnika prądu) może być oszacowana z zależności:



$$n = \frac{ZN_{Av}\rho}{A}$$

Z - liczba elektronów walencyjnych

N_{Av} – stałą Avogadro

ρ – gęstość metalu

A – masa atomowa metalu

$$l_{z/s} = \frac{e^2 n}{2m\sigma}$$

$2 \cdot 10^{13}$ zderzeń/s w Cu

$0,9 \cdot 10^{22} / \text{cm}^3$ dla cezu

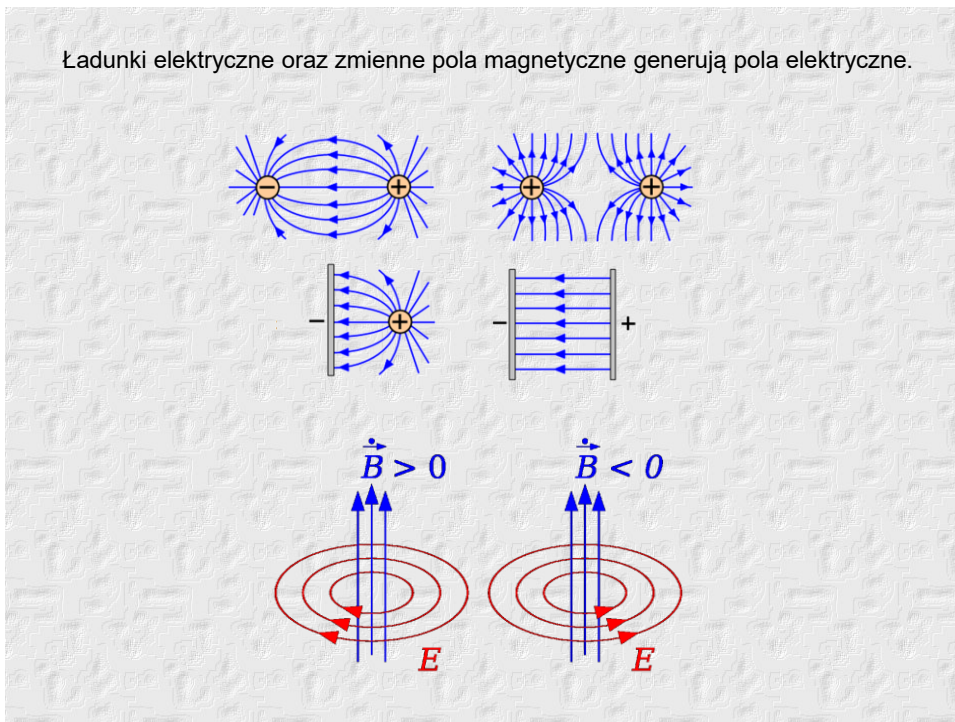
$8,4 \cdot 10^{22} / \text{cm}^3$ dla miedzi

$24,7 \cdot 10^{22} / \text{cm}^3$ dla berylu

$7 \cdot 10^{20}$ szacunkowa liczba ziarenek piasku na świecie

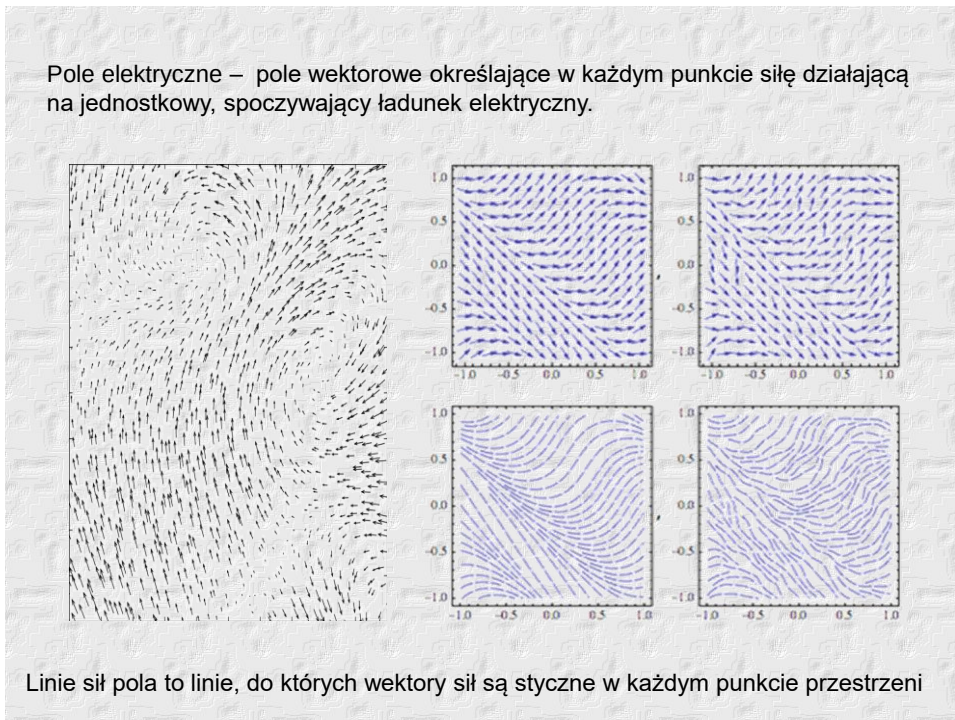
22

Ładunki elektryczne oraz zmienne pola magnetyczne generują pola elektryczne.



23

Pole elektryczne – pole wektorowe określające w każdym punkcie siłę działającą na jednostkowy, spoczywający ładunek elektryczny.



Linie sił pola to linie, do których wektory sił są styczne w każdym punkcie przestrzeni

24

Prąd jest ruchem ładunków wywołanym poprzez działanie pola elektrycznego

Ruch ładunków jest chaotyczny – pod działaniem pola elektrycznego w pewnym stopniu się porządkuje

prąd nie płynie – siły się równoważą (aczkolwiek w małym wycinku przewodnika nie całkiem dokładnie)

prąd płynie – brak równowagi sił

25

Prąd elektryczny wyraża więc pewien ogólny, statystyczny trend kierunku ruchu ładunków.

Kierunek przepływu prądu jest umowny.

Przyjęto, że jest on zgodny z ruchem ładunków dodatnich (jonów).

26

W rzeczywistości dla temperatur pokojowych ruch termiczny elektronów ma średnią wartość wielokrotnie wyższą niż ruch wynikający z istnienia zewnętrznego pola elektrycznego

Średnia prędkość elektronów w ruchu cieplnym wynosi

$$v_c = \sqrt{\frac{3kT}{m_e}} \quad \text{ponieważ} \quad \frac{m_e v_c^2}{2} = \frac{3}{2} kT$$

k – stała Boltzmanna $k \approx 1,38 \cdot 10^{-23} [\text{J/K}] \approx 2,08 \cdot 10^{10} [\text{Hz/K}]$

Średnią prędkość elektronów, przyspieszanych polem elektrycznym o natężeniu E , nazywa się **prędkością unoszenia**

$$v_u = \frac{eE}{m_e} \frac{\bar{\tau}}{2} = \mu E$$

e – ładunek elektronu

m_e – efektywna masa elektronu ($\text{Cu} \Rightarrow 1$, $\text{Al} \Rightarrow 0,97$, $\text{Zn} \Rightarrow 0,85$, $\text{Be} \Rightarrow 1,6$ wart. dla próżni)

$\bar{\tau}$ – średni czas relaksacji (średni czas pomiędzy kolejnymi zderzeniami)

μ – ruchliwość elektronu

przez dowolny przekrój przewodnika S w czasie t może więc przepłynąć ładunek

$$q = S e n v_u t$$

27

natężenie prądu wyniesie zatem

$$i = \frac{q}{t} = e n S v_u = \frac{e^2 n S \bar{\tau}}{2 m_e} E$$

gęstość prądu

$$j = \frac{i}{S} = e n S v_u = \frac{e^2 n \bar{\tau}}{2 m_e} E = e n \mu E = \sigma E$$

gęstość prądu nie zależy od geometrii przewodnika a jedynie od koncentracji elektronów ich średniego czasu relaksacji oraz wartości zewnętrznego pola elektrycznego

współczynnik proporcjonalności $\sigma = \frac{e^2 n \bar{\tau}}{2 m_e}$ nosi nazwę **konduktywności**

lub inaczej **przewodności elektrycznej**

a jego odwrotność nazywana jest **rezystywnością** $\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{2 m_e}{e^2 n \bar{\tau}}$

28

Proporcja

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$$

jest równoważna prawu Ohma, co łatwo sprawdzić uwzględniając zależności:

$$i = jS \quad E = \frac{U}{l} \quad R = \frac{l}{\sigma S} = \rho \frac{l}{S}$$

rezystywność i konduktywność można powiązać z ruchem cieplnym elektronów

$$\bar{\lambda} = v_c \bar{\tau}$$

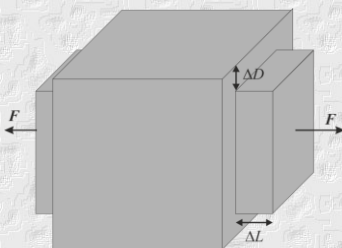
$\bar{\lambda}$ - średnia droga swobodna

$$\rho = \frac{2}{e^2 n \bar{\lambda}} \sqrt{3 m_e k T}$$

co uwiadamia zależność tych parametrów od temperatury oraz możliwość nadprzewodnictwa

29

Efekt piezorezystancyjny



Liczba (stała) Poissona - stosunek odkształcenia poprzecznego do odkształcenia podłużnego przy osiowym stanie naprężenia

$$\nu = - \frac{\Delta D}{\Delta L}$$

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

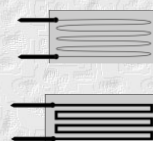
Jeżeli rezystancja zależy od geometrii to rozciąganie (ściskanie) materiału przewodzącego będzie miało wpływ na jego rezystancję (efekt piezorezystancyjny).

Po rozpisaniu wyrażenia na rezystancję w szereg Taylora i ograniczeniu się do początkowych członów rozwinięcia otrzyma się:

$$\frac{\Delta R}{R} \approx \underbrace{\frac{\Delta \rho}{\rho}}_{\text{dominuje w półprzewodnikach}} + \underbrace{\frac{\Delta l}{l} + \frac{\Delta S}{S}}_{\text{dominuje w metalach}}$$

dominuje w półprzewodnikach

dominuje w metalach



30

Przewodnictwo elektryczne materiałów – rezystywność i konduktywność

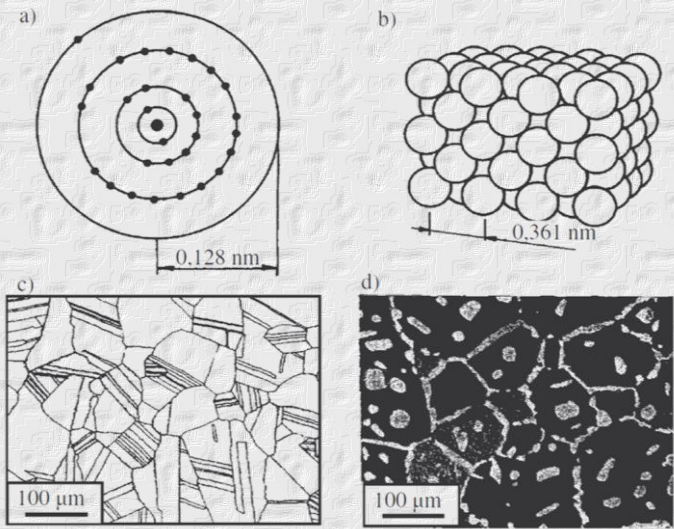
Materiał przy 20 °C	Rezystywność ρ [Ωm]	Konduktywność σ [1/Ωm]=[S/m]	Temperaturowy wsp. rezystancji α ₂₀ [1/°C] TWR
Aluminium	0,0285·10 ⁻⁶	35·10 ⁶	4,1·10 ⁻³
Cyna	0,115·10 ⁻⁶	8,7·10 ⁶	4,4·10 ⁻³
Miedź	0,0178·10 ⁻⁶	56·10 ⁶	3,9·10 ⁻³
Srebro	0,016·10 ⁻⁶	62,5·10 ⁶	3,6·10 ⁻³
Chromonikielina	1,0·10 ⁻⁶	1·10 ⁶	1,4·10 ⁻⁴
Konstantan	0,5·10 ⁻⁶	2·10 ⁶	3·10 ⁻⁵
Węgiel elektrotechniczny	2 - 4·10 ⁻⁵	2,86·10 ⁴	-2·10 ⁻³

Rezystancja przewodników zmienia się wraz z temperaturą: $R_t = R_{20} [1 + \alpha_{20} (t - 20^\circ)]$

- 1. Metale nieferromagnetyczne np. aluminium, miedź, cyna, srebro zmieniają swoją rezystywność w sposób liniowy $\alpha_{20} = 0,0004 \text{ 1/}^\circ \text{C}$
- 2. Metale ferromagnetyczne w temperaturze poniżej punktu Curie (temperatura utraty właściwości magnetycznych, żelazo ok. 760 °C) zmieniają współczynnik w znacznym stopniu w zależności od temperatury $\alpha_{20} = 0,0006 \text{ 1/}^\circ \text{C}$, jednak w temperaturze pokojowej można go przyjąć jako stały
- 3. Materiały oporowe: chromonikielina, konstantan wykazują niezależność rezystancji od temperatury
- 4. Półprzewodniki np. tlenki miedzi i tlenki manganu mają współczynnik α_{20} ujemny, stosowane jako termistory, ograniczają wartość prądu po włączeniu

31

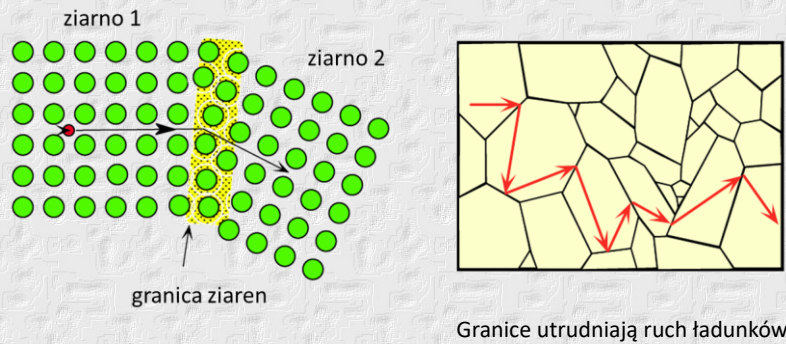
Metale mają strukturę polikrystaliczną



a) struktura atomu miedzi, b) struktura kryształu miedzi, c) struktura ziarnista miedzi (jednofazowa) , d) struktura ziarnista dwufazowa stopu miedzi z cynkiem (mosiądzu)

32

Struktura polikrystaliczna zwiększa rezystywność metali i stopów



33

Podstawowe cechy metali

- substancje proste (pierwiastki chemiczne) tworzące układy krystaliczne o wysokim stopniu wypełnienia przestrzeni atomami
- w temperaturze pokojowej występują w stanie stałym (z wyjątkiem Hg)
- dobre przewodnictwo elektryczne – dzięki temu są nieprzezroczyste
- (wysoka zdolność odbijania promieniowania elektromagnetycznego)
- dobre przewodnictwo cieplne
- niskie tłumienie dźwięku
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- dość wysoka twardość
- wysoki moduł sprężystości
- duża gęstość
- dobra kowalność
- wysoka temperatura topnienia
- wysoka reaktywność chemiczna (za wyj. metali szlachetnych)

34

Stopy metali

Pozwalają na modyfikację parametrów fizycznych metali poprzez wprowadzenie w ich strukturę innych pierwiastków.

Osnową stopu jest metal, a w jego skład wchodzi co najmniej jeden dodatkowy składnik zwany dodatkiem stopowym.

Dodatki są wprowadzane w celu poprawienia mechanicznych właściwości materiału.

Zwykle pogarszają plastyczność, przewodnictwo elektryczne i przewodnictwo cieplne.

Często zmniejszają również odporność na korozję.

Stopy otrzymuje się najczęściej przez stapianie składników w stanie ciekłym i odlewanie, po którym w czasie chłodzenia i dodatkowych zabiegów obróbki cieplnej powstaje struktura decydująca o właściwościach stopu.

Są stosowane również inne techniki wytwarzania stopów, tj. spiekanie, elektroliza lub nasycanie dyfuzyjne w stanie stałym.

Dla powierzchni stosuje się azotowanie, nawęglanie, węglazotowanie (cyjanowanie), kaloryzowanie, aluminowanie, naborowywanie, chromowanie, siarkowanie, fosforowanie, kadmowanie, cynkowanie i in.

35

Miedź

- liczba atomowa równa 29, masa atomowa wynosi 63,5463
- w związkach chemicznych miedź jest jedno- lub dwuwartościowa.
- nie wykazuje odmian alotropowych i krystalizuje w sieci ściennie centrowanej układu regularnego o parametrze 0,3617 nm
- temperatura topnienia miedzi wynosi 1084,88°C, a wrzenia ok. 2595°C
- gęstość 8,93 g/cm³ w 20°C
- wytrzymałość na rozciąganie $R_m = 200 \div 250$ MPa
- granica plastyczności $R_e = 35$ MPa
- twardość 45 HB (w skali Brinella)
- wydłużenie $A = 30 \div 35\%$.
- W wyniku obróbki plastycznej na zimno wytrzymałość miedzi zwiększa się do 400÷450 MPa, a twardość do 120 HB, przy zmniejszeniu wydłużenia do 1÷2%.
- dobra przewodność cieplna i elektryczna
- wysoka odporność na korozję atmosferyczną dzięki pokrywaniu się patyną, tj. zasadowym węglanem miedziowym, i na działanie wody,
- brak odporności na działanie amoniaku
- miedź dobrze się lutuje

36

Zastosowanie miedzi

- w elektrotechnice na przewody, gdzie wykorzystuje się jej wysoką przewodność elektryczną,
- w energetyce i przemyśle chemicznym na chłodnice i wymienniki ciepła – ze względu na dużą przewodność cieplną,
- w budownictwie są stosowane rury z czystej miedzi (min. 99,9%), z których wykonuje się instalacje ciepłej i zimnej wody, ogrzewania, gazowe, ciekłego paliwa, sanitarne i in.

37

Mosiądze

Stopy miedzi z cynkiem, jako głównym pierwiastkiem stopowym, są nazywane **mosiądzami**. Mosiądze dwuskładnikowe – ze względu na skład fazowy – dzieli się na:

- jednofazowe – o strukturze roztworu α i stężeniu od 2 do 39% Zn, - bardzo duża plastyczność - na wyroby głębokotłoczne (tombaki – zawierają 5 – 20% Zn)
- dwufazowe o strukturze mieszaniny $\alpha + \beta$ i stężeniu od 39 do 45% Zn. Wytrzymałość mosiądzów zawierających ok. 30 do 45% Zn zwiększa się przy znacznym zmniejszeniu plastyczności
- mosiądze charakteryzują się dobrą odpornością na korozję, szczególnie atmosferyczną i w wodzie morskiej. Odporność na korozję stopów miedzi z cynkiem zwiększa się wraz ze wzrostem stężenia Cu.
- najczęściej spotykanymi rodzajami korozji mosiądzów jest **odcynkowanie** oraz **korozja naprężeniowa**, zwana pękaniem sezonowym mosiądzów

38

Glin (aluminium)

- występuje w przyrodzie w bardzo wielu minerałach i jest trzecim (po tlenie i krzemie) pierwiastkiem pod względem udziału w skorupie ziemskiej, liczba atomowa 13 (liczba protonów w jądrze=liczbie elektronów przy braku jonizacji), masa atomowa 26,9815 (razy $1,66 \cdot 10^{-24}$ g czyli 1/12 masy węgla ^{12}C)
- nie wykazuje odmian alotropowych jedyny stabilny izotop to ^{27}Al
- krystalizuje w sieci regularnej ściennie centrowanej typu A1 o parametrze 0,40408 nm
- temperatura topnienia 660,37°C, wrzenia 2494°C
- gęstość 2,6989 g/cm³ w 20°C

W stanie wyżarzonym cechuje się:

- wytrzymałością na rozciąganie wynoszącą $R_m = 70 \div 120$ MPa,
- granicą plastyczności $R_e = 20 \div 40$ MPa,
- wydłużeniem $A = 30 \div 45\%$, przewężeniem $Z = 80 \div 95\%$.

39

Glin na powietrzu pokrywa się cienką warstwą Al_2O_3 , dobrze chroniącą przed korozją, działaniem wody, stężonego kwasu azotowego, licznych kwasów organicznych, a także siarkowodoru

Jest to metal nie nadający się do lutowania, trudno spawalny

Kwasy redukujące HCl i HF, słona woda, pary i jony rtęci powodują przyspieszenie korozji aluminium

W celu polepszenia odporności na korozję aluminium może być poddane tzw. anodowaniu, tj. elektrolitycznemu procesowi wytwarzania powłoki tlenkowej, np. w roztworze 10% kwasu siarkowego, połączonemu z barwieniem powierzchni metalu na różne kolory

Sproszkowany glin używany jest w hutnictwie do otrzymywania metali z ich tlenków w procesie aluminotermii. Stosowana w tym procesie mieszanina glinu oraz tlenków metali jest znana pod nazwą termit, który m. in. jest używany do spawania oraz jako surowiec do produkcji broni

Pył glinowy jest często składnikiem farb metalicznych odpowiedzialnym za charakterystyczny połysk.

Glin jest dobrym przewodnikiem ciepła i prądu

40

Żelazo i jego stopy

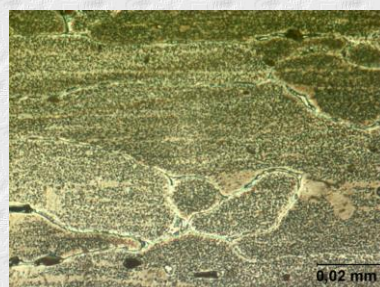
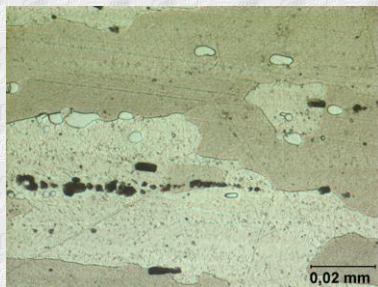
- Posiada 25 izotopów z przedziału mas 45–69. Trwałe są izotopy 54, 56, 57 i 58. najbardziej rozpowszechniony jest izotop 56 (ok. 92%)
- liczba atomowa równa 26
- w związkach chemicznych może być nawet sześciowartościowy
- rozróżnia się cztery odmiany alotropowe α , β , γ i δ krystalizujące w sieci regularne ściennie lub przestrzennie centrowane
- temperatura topnienia wynosi 1538 °C, a wrzenia ok. 2861 °C
- gęstość 7874 kg/m³ w 20 °C
- wytrzymałość na rozciąganie od 400-1500 MPa
- wysoka twardość
- dobra przewodność cieplna i elektryczna (konduktywność rzędu 7 MS/m)
- jest wysoce reaktywne, łatwo koroduje, brak odporności na działanie kwasów
- od ok. XV w p.n.e. jest stosowane w formie stopów z węglem
- do wytwarzania stopów żelaza (tzw. stale stopowe) stosuje się też mangan, chrom, molibden, wanad, krzem i in.

41

W stopach żelaza z węglem węgiel może występować w postaci czystej (grafit), roztworu stałego w sieci krystalicznej czyli ferrytu lub austenitu albo jako węglik żelaza (cementyt)

Stopy zawierające poniżej 2,11% (wg PN, 1,75% wg EN) węgla to stale lub staliwa, zaś powyżej tego stężenia - żeliwa.

Przy zawartości węgla poniżej 0,0218% uzyskuje się niemal czyste żelazo α zwane ferrytem, przy 0,77% uzyskuje się perlit będący mieszaniną eutektoidalną ferrytu i cementytu, przy zawartości węgla 4,3% powstaje ledeburyt



42

Najważniejsze zastosowania żelaza i jego stopów w elektronice

- wytrzymały materiał konstrukcyjny (chassis, obudowy, śruby i nakrętki), **wzmocnienie przewodów**, ekrany elektryczne, styki, sprężyny, trzpienie, i in.
- stop z niklem (79%) nazywany jest **permalojem** magnetycznie miękkim materiałem wykorzystywanym do budowy rdzeni prądnic, silników, transformatorów i cewek
- stop z niklem (79%), molibdenem (5%) i manganem (~0,5%) pozwala na uzyskanie **superpermaloju** o przenikalności magnetycznej dochodzącej do 900 000 (dla max. wartości pól magnetycznych) do jego rozmagnesowania wystarcza pole rzędu 0,3 A/m
- stopy z niklem (36-46%) z niewielkim dodatkiem węgla i chromu noszą nazwę **inwarów** charakteryzujących się bardzo niską rozszerzalnością cieplną i wysoką temperaturową stałością stałych sprężystych - super inwar Fe₆₃Ni₃₂Co₅ ma praktycznie zerową rozszerzalność w zakresie 20-215 °C
- żelazo stosowane jest także jako składnik bimetalu i domieszka do stopów oporowych

43

Stop żelaza z kobaltem i niewielkimi dodatkami wanadu (do 2%), tantalu i niobu nazywa się **permendurem**. Permendur ma najwyższą znaną wartość indukcji nasycenia dla materiałów magnetycznie miękkich. Dochodzi ona do 2,43 T.

Permendur stosowany jest tam, gdzie zachodzi konieczność uzyskania maksymalnej sprawności maszynach elektrycznych używanych w samolotach lub satelitach

Mumetal to stop niklu (75%) i żelaza (15%) z niewielkimi dodatkami miedzi i molibdenu. Stop ten wykazuje bardzo dużą względną przenikalność magnetyczną (nawet powyżej 10⁶), co jest wykorzystywane do ekranowania statycznych i wolnozmiennych pól magnetycznych.

Mumetal poddany ścisnieniu znacznie obniża swą przenikalność magnetyczną, dlatego elementy wykonane z tego stopu muszą być odpowiednio zabezpieczone.

Istnieje wiele modyfikacji tego stopu (np. super mumetal), które różnią się nieznacznie przede wszystkim właściwościami magnetycznymi.

44

Spojwa lutownicze miękkie

Zgodnie z unijną dyrektywą Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC) od 1 lipca 2006 w stopach lutowniczych (poza określonymi wyjątkami) nie może się znajdować ołowu, który wcześniej stanowił 20-60% ich zawartości:

Używano stopów np:

Sn63Pb37 (183 °C)

Sn62Pb36Ag2 (179 °C)

Obecnie w produkcji sprzętu elektronicznego stosuje się **stopy bezołowiowe**, w których skład wchodzi cyna z niewielkimi dodatkami srebra, miedzi, bizmutu i antymonu.

Temperatura topnienia stopów używanych przy lutowaniu bezołowiowym wynosi 215-230 °C.

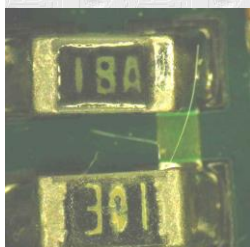
Najczęściej używa się :

SnAg3,5 (221 °C)

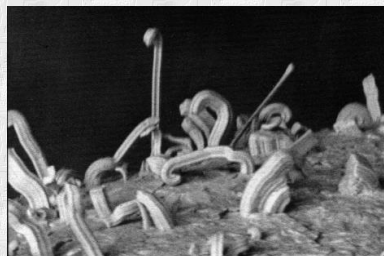
SnAg2,0 (221-226 °C)

SnCu0,7 (227 °C)

SnAg3,5Bi3,0 (206-213 °C)



Wąsy cynowe

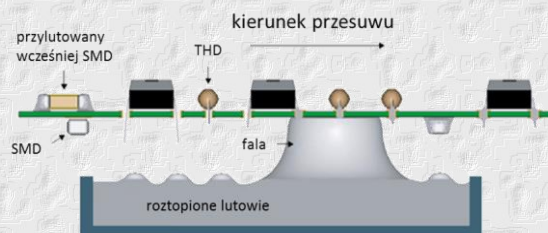


45

lutowanie ręczne



lutowanie na fali



lutowanie pieczone



SMD – Surface Mounted Device

THD - Through-Hole Device

46

Spoiwa lutownicze twarde

brązowe	SBK31	2,8÷3,5% Si 1,0÷1,5% Mn reszta Cu	1015	łączy miedź, brąz i stopy niklu; spawanie elementów przyrządów elektrotechnicznych
miedziane	SMS1	0,5÷1,0% Ag reszta Cu	1070	łączy miedź, stal i spieki; spawanie przewodów elektrycznych
srebrne	LS70	69÷71% Ag 24÷26 Cu reszta Zn	715÷770	lutowanie połączeń o małej rezystancji, wykonanych z niklu, stopów niklu, miedzi i stopów miedzi
	LS71F	70,5÷71,5% Ag 0,8÷1,2 P reszta Cu	645÷795	lutowanie styków elektrycznych

Stopy niskotemperaturowe

nazwa stopu	temp. top.	Bi	Pb	Sn	In	Cd	Tl	Ga	Sb
stop Rosa	98 °C	50%	25%	25%	–	–	–	–	–
Cerrosafe	74 °C	42,5%	37,7%	11,3%	–	8,5%	–	–	–
stop Wooda	70 °C	50%	26,7%	13,3%	–	10%	–	–	–
stop Fielda	62 °C	32,5%	–	16,5%	51%	–	–	–	–
Cerrolow 117	47.2 °C	44,7%	22,6%	8,3%	19,1%	5,3%	–	–	–
Bi-Pb-Sn-Cd-In-Tl	41.5 °C	40,3%	22,2%	10,7%	17,7%	8,1%	1,1%	–	–
Galinstan	–19 °C	<1,5%	–	9,5- 10,5%	21-22%	–	–	68-69%	<1,5%

47

Nikiel i stopy niklu

- liczba atomowa 28, masa atomowa 58,6934
- nie wykazuje odmian alotropowych, krystalizując w sieci ściennie centrowane układu regularnego o parametrze $a = 0,3516 \text{ nm}$, co decyduje o tym, że metal ten jest podatny na obróbkę plastyczną zarówno na zimno, jak i na gorąco.
- temperatura topnienia Ni wynosi 1453°C, wrzenia 2730°C.
- gęstość Ni 8,902 g/cm³.
- w stanie zmiękczonego uzyskuje wytrzymałość na rozciąganie $R_m = 450 \text{ MPa}$ i wydłużenie $A = 45\%$,
- w stanie odkształconym na zimno z 50% stopniem zgniotu rośnie wytrzymałość na rozciąganie do $R_m = 750 \text{ MPa}$, maleje jednak możliwość wydłużania $A = 3\%$.
- zachowuje dobre własności mechaniczne do ok. 500°C.
- jest stosowany w ograniczonym stopniu ze względu na stale powiększający się deficyt tego pierwiastka

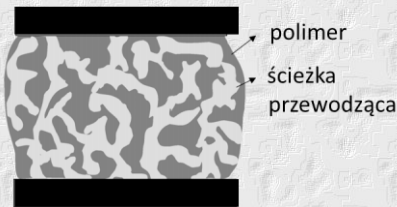
Czysty nikiel stosuje się na:

- podzespoły w lotnictwie i kosmonautyce (w tym na obudowy silników rakietowych), w elektronice i elektrotechnice,
- elementy specjalnej aparatury badawczej i chemicznej odpornej na działanie substancji żrących w tym na sprzęt w przetwórstwie żywności,
- w galwanotechnice,
- jako katalizator w wielu procesach chemicznych

48

Kleje przewodzące wytwarza się na bazie żywicy i srebra

Właściwości	Jednostka	Wartość
sposób utwardzania	-	chemiczny
Zakres temperatur pracy ciągłej	[°C]	od -40 do +140
Rezystywność po utwardzeniu	[Ω x m]	(2 - 8) · 10 ⁻⁶
Wytrzymałość mechaniczna spoiny na ścinanie	[N/mm ²]	18 - 22



Połączenia klejone z czasem pogarszają swe własności przewodzące – stosuje się je dość rzadko i tylko wtedy gdy nie ma możliwości stosowania innych rodzajów połączeń

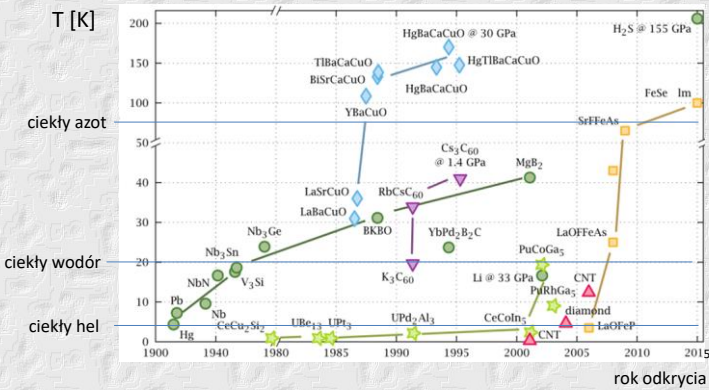
49

Nadprzewodniki

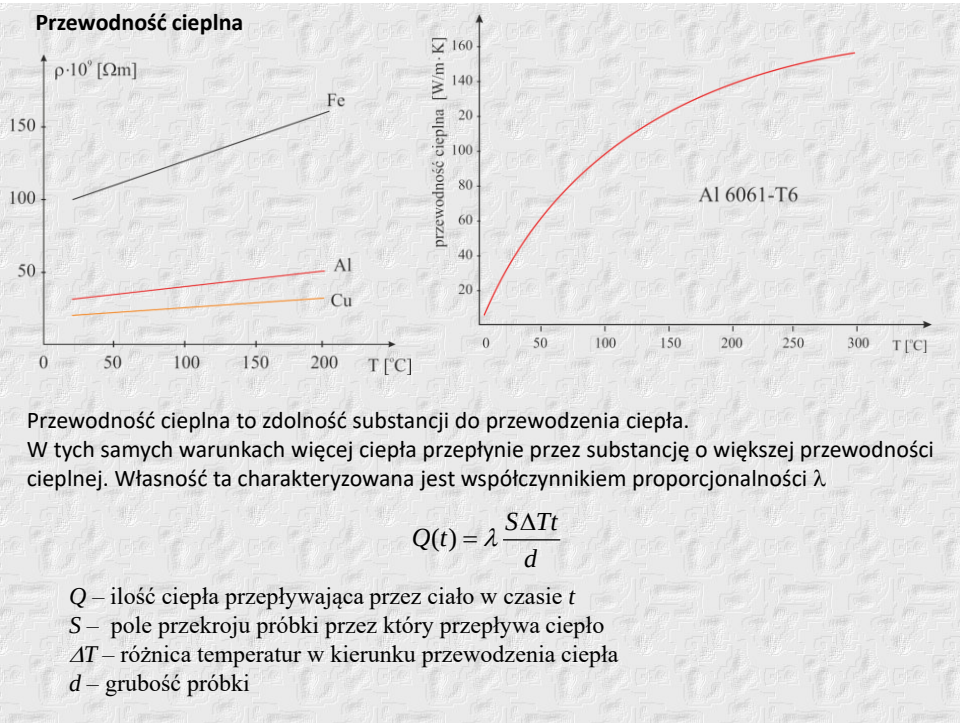
Są to materiały zdolne do osiągania zerowej rezystancji (kolektywne zjawiska kwantowe nośnikami nie są pojedyncze elektrony ale pary Coopera)

materiały takie są też idealnymi diamagnetykami w stanie nadprzewodzenia wypychając ze swej objętości linie sił pola magnetycznego (efekt Meissnera).

Nadprzewodnictwo jest obserwowane w różnorodnych materiałach takich jak: rtęć (po raz pierwszy - wykryte w 1911 przez Kamerlingha Onnesa), cyna i ołów, stopach, ceramikach tlenkowych i w materiałach organicznych.



50

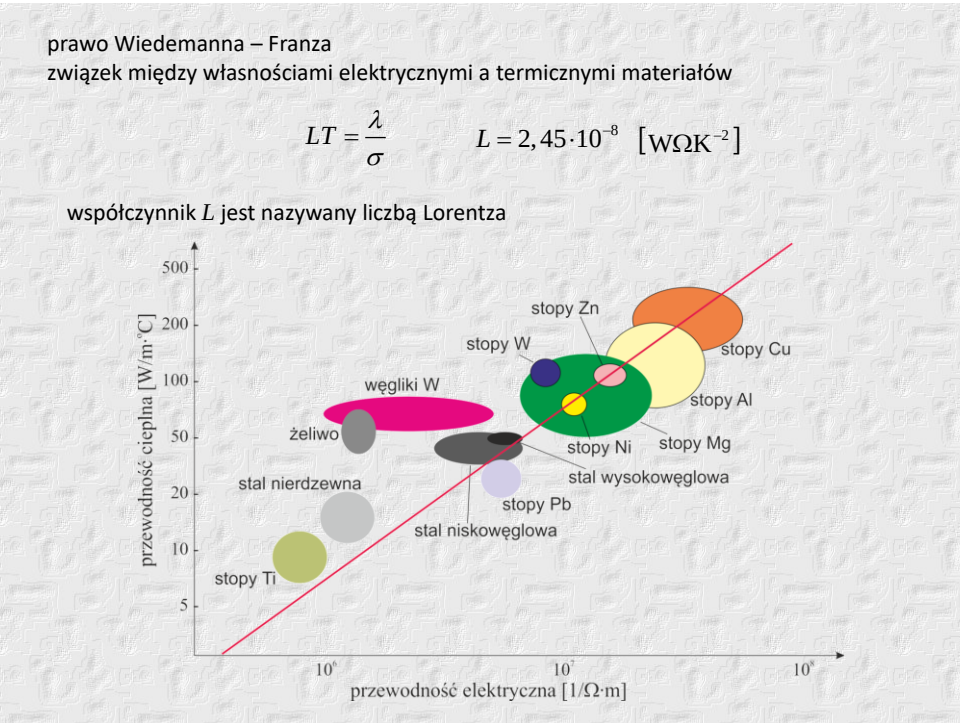


51

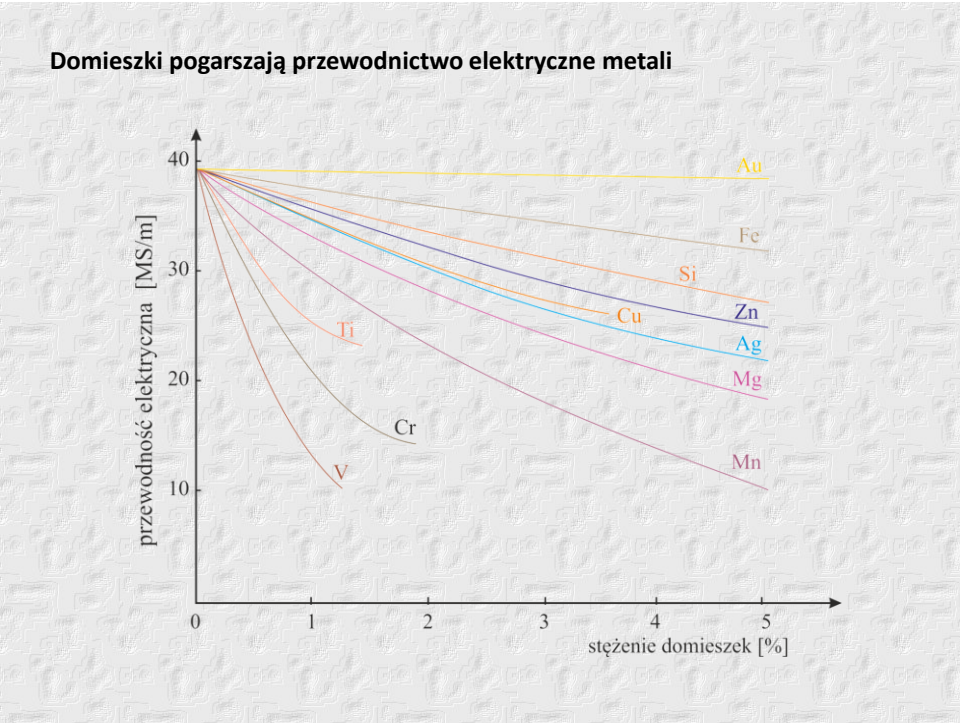
Przewodność cieplna wybranych materiałów

materiał	przewodność cieplna W/(m·K)
grafen	4840–5300
diament	900–2320
srebro	429
miedź	370 - 400
złoto	317
stopy aluminium	100 - 200
stopy żelaza	30 - 50
woda	0,6
drewno	0,2
styropian	0,036
powietrze	0,025

52



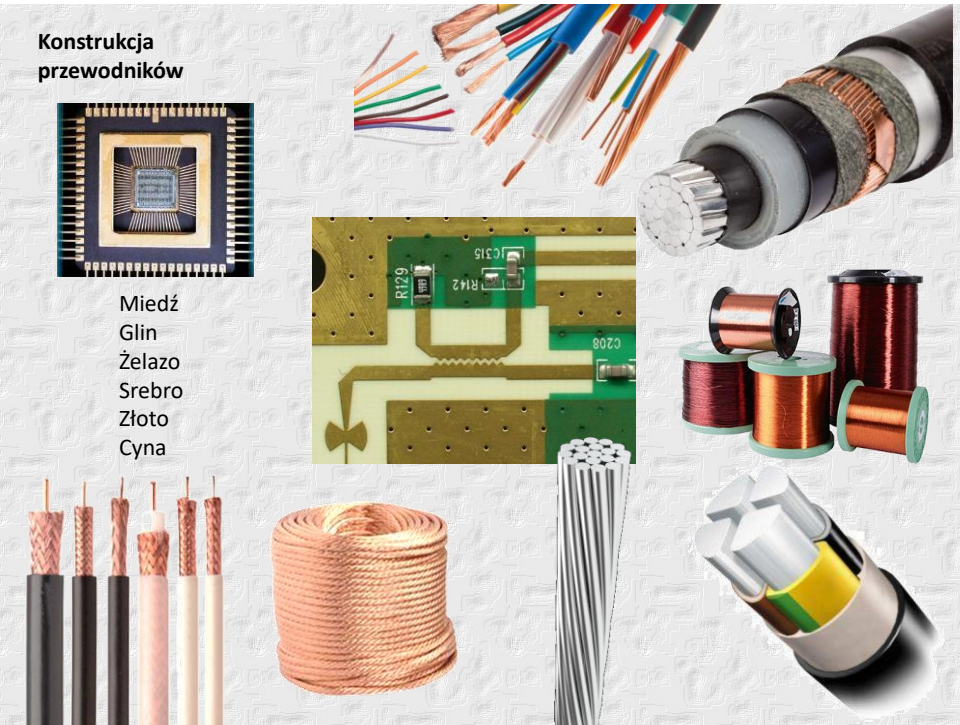
53



54

Zastosowania materiałów przewodzących

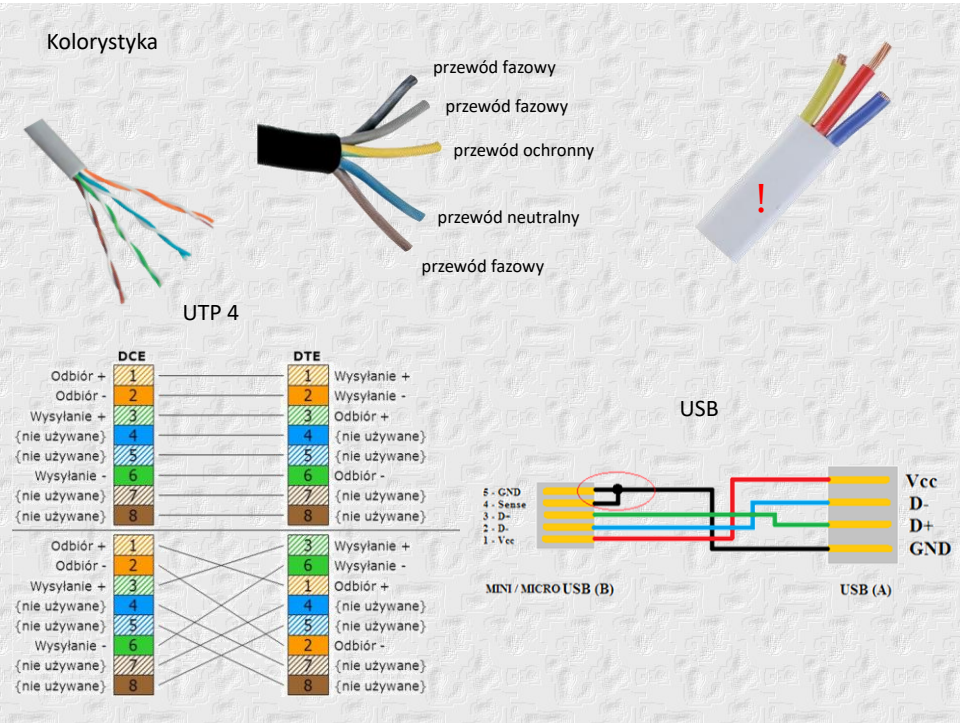
55



Konstrukcja
przewodników

Miedź
Glin
Żelazo
Srebro
Złoto
Cyna

56



57

Zjawisko naskórkowości

Prąd przemienny płynący w przewodniku powoduje powstawanie prądów wirowych. Mają one, w centralnej części przewodnika kierunek przeciwny do prądu w przewodniku, który je wzbudza. W efekcie w centralnej części przewodu przepływ prądu jest mniejszy, a w skrajnych sytuacjach nawet odwrócony

Podstawowym parametrem opisującym naskórkowość jest głębokość wnikania zwana też głębokością dyfuzji magnetycznej.

$$\delta \approx \sqrt{\frac{2\rho}{\omega\mu}} = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}$$

μ – bezwzględna przenikalność magnetyczna przewodnika
 f – częstotliwość prądu

Głębokość wnikania - odległość od powierzchni przewodu, na której gęstość prądu osiąga wartość $1/e$ ($\sim 37\%$) swojej wartości maksymalnej.

$R = 0,5 \text{ mm}$ $i = 1 \text{ A}$ $f = 50 \text{ Hz}$

I_w
 H
 I

58

Własności wybranych materiałów przewodowych					
Rodzaj materiału	Skład	ρ g/cm ³	σ MS/m	α K ⁻¹	R_t MPa
Miedź	99,95% Cu	8,9	54÷58	0,0039	220
Brąz	Cu + 0,1% Mg lub Cu + (0,2÷1%) Cd	8,9	48	0,004	500÷520
Brąz	Cu+ (0,5+0,8%) Mg lub Cu + 1%Sn+ 1%Cd	8,9	36	0,004	560÷680
Brąz	Cu + 2,4% Sn	8,9	18	0,004	660÷740
	Cu + 1,2% Sn + 1,2 Zn				
Aluminium	99,5% Al	2,7	36	0,0041	120
Stop aluminiumo- magnezowo-krzemowy (Aldrey, Almelec)	(0,3+0,5%) Mg + (0,5 + 0,6%) Si + Al (reszta)	2,7	30÷33	0,0036	300÷350
Żelazo (stal)	—	7,86	7	0,005	400÷1500

grafit	99,99..% C	2,1 - 2,2	0,025	-	-
złoto	99,99..% Au	19,3	45,5	-	-
srebro	99,99..% Ag	10,4	62,5	-	-

59

Porównanie parametrów najbardziej rozpowszechnionych materiałów przewodowych				
parametr	oznaczenie	jednostka	Al	Cu
konduktywność	σ	MS/m	34,5	55-56
gęstość	ρ	kg/m ³	2700	8930
wsp. rozszerzalności liniowej	α_L	1/K	$23 \cdot 10^{-6}$	$16,4 \cdot 10^{-6}$
wsp. rozszerzalności radialnej	α_R	1/K	$4 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-3}$
wytrzymałość na rozciąganie	R_R	MPa	150-170	250-500
przewodność cieplna	λ	W/mK	200	380
ciepło właściwe	c_W	J/kgK	930	380
temp. topnienia	T_{top}	K	660	1356

Należy pamiętać o zjawisku pełzania Al.
Pełzanie to wzrost odkształceń przy niezmiennych naprężeniach
Pełzanie prowadzi do obluźniania styku -> wzrost rezystancji przejścia -> silniejsze nagrzanie i intensywniejsze utlenianie powierzchni stykowych -> przerwa w obwodach małej mocy lub wytopienie styku w obwodach dużej mocy

konieczność stosowania stalowych podkładek sprężynujących

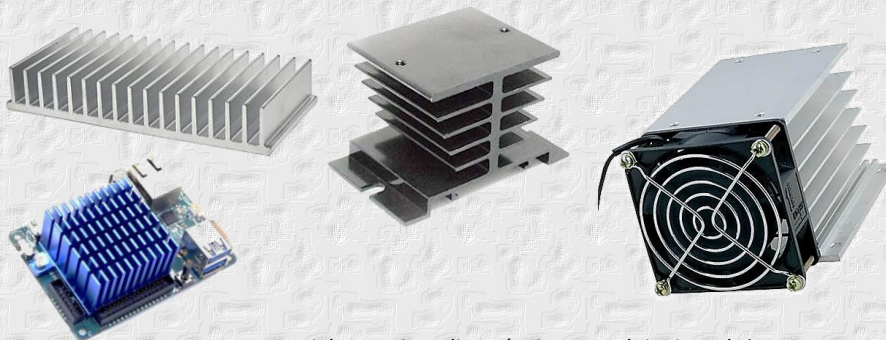
60

Radiatory

Radiator jest bryłą z materiału o wysokiej przewodności cieplnej i rozwiniętej powierzchni od strony zewnętrznej maksymalizującej oddawanie ciepła.

Radiatory wykonuje się najczęściej z aluminium lub miedzi.

Są konieczne jeśli duża ilość ciepła wydzielana jest na niewielkiej powierzchni elementu.



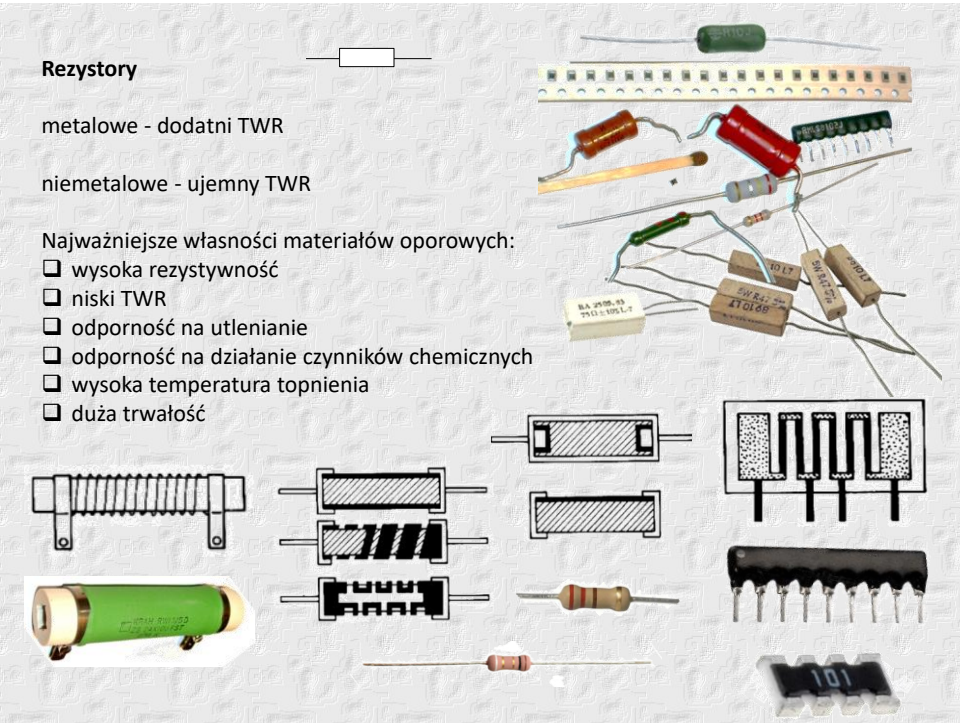
Projektowanie radiatorów jest zagadnieniem złożonym - zasadniczo może stanowić temat odrębnego wykładu

61

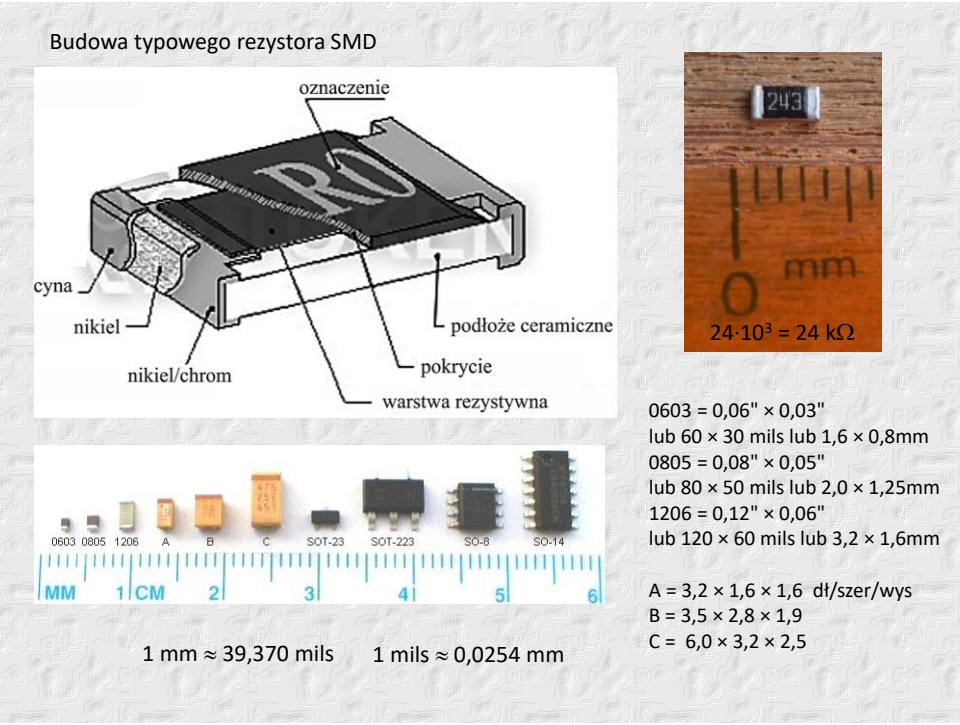
Anteny



62



63



64

Właściwości materiałów oporowych

		gęstość [g/cm³]	rezystywność temp . pok. [Ω m]	l. wsp. rozsz. [1/K]	temp. topn. [°C]
stopy Cu	konstantan	8,9	$0,5 \cdot 10^{-6}$	10^{-5}	1225-1300
	manganin 86Cu12Mg2Ni	8,4	$(0,43-0,48) \cdot 10^{-6}$	10^{-5}	960
	miedzionikle	8,9	$(0,19-0,5) \cdot 10^{-6}$	10^{-5}	-
stopy Ni	chromonikieliny	8,4	$(1,0-1,5) \cdot 10^{-6}$	$14 \cdot 10^{-6}$	1400
stopy Fe	kantale	7,1-7,9	$(1,04-1,45) \cdot 10^{-6}$	$(14-18) \cdot 10^{-6}$	~1450
ceramika	sylity (SiC+Si+gliceryna)	2,5-2,9	10^{-3}	$4,5 \cdot 10^{-6}$	~1800

65

Cewki indukcyjne

Gromadzą energię w postaci pole magnetyczne – zachowują się jak magnesy

Cewką nazywa się szereg pętli przewodzących.

Podstawowym parametrem cewki jest indukcyjność L czyli zdolność do wytwarzania strumienia magnetycznego Φ

$$\Phi = L \cdot i$$

Indukcyjność prostego przewodu:

$$L_{pp} \approx 0,0046 \cdot l \cdot \log \frac{1,47 \cdot l}{d}$$

Indukcyjność pojedynczej pętli:

$$L_{petli} \approx 0,0145 \cdot D \cdot \log \frac{1,08 \cdot D}{d}$$

66

Indukcyjność cewki powietrznej o stałym D :
$$L_{\text{cewki}} \approx 0,01 \frac{Dn^2}{\frac{l}{d} + 0,45}$$

Indukcyjność wyraża się w Henrach [H]

$$[H] = \left[\frac{\text{Wb}}{\text{A}} \right] = \left[\frac{\text{Vs}}{\text{A}} \right] = \left[\frac{\text{s}^2}{\text{F}} \right] = [\Omega \text{s}]$$

Chwilowe napięcie elektryczne u_L występujące na cewce o indukcyjności własnej L jest zależne od chwilowego prądu i płynącego przez tę cewkę:

$$u_L = L \frac{di}{dt}$$

Reaktancja $X_L = \omega L = 2\pi f L$



Jeśli prąd nie zmienia się w czasie to napięcie wynosi 0 (zwarcie).

Jeśli cewka ma blokować prądy wysokiej częstotliwości nazywana jest często dławikiem

67

Indukcyjność cewki można znacznie zwiększyć poprzez zastosowanie rdzeni o wysokiej przenikalności elektrycznej.

Dla jednowarstwowej cewki z rdzeniem otwartym:

$$L \approx \frac{S \mu n^2}{l}$$



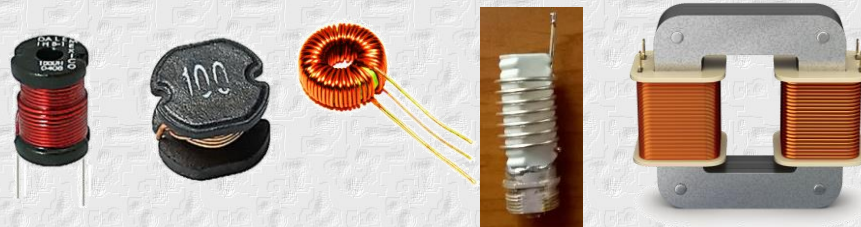
S - pole przekroju poprzecznego cewki

μ - bezwzględna przenikalność magnetyczna materiału rdzenia

n - liczba zwojów

l - długość cewki

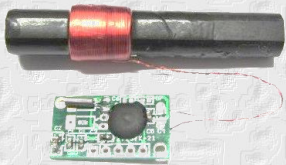
Cewki wielowarstwowe oraz z rdzeniem o bardziej złożonym kształcie wymagają indywidualnego podejścia.



68

Rdzenie ferrytowe

f (MHz)	0,1	1	10	100
ρ [Ωm] dla MnZn	≈ 2	≈ 0,5	≈ 0,1	≈ 0,01
ρ [Ωm] dla NiZn	≈ 10 ⁵	≈ 5·10 ⁴	≈ 10 ⁴	≈ 10 ³



f (MHz)	0,001	0,01	0,1	1	10	100
względna przenikalność elektryczna dla MnZn	-	-	≈ 2·10 ⁵	≈ 10 ⁵	≈ 5·10 ⁴	≈ 10 ⁴
względna przenikalność elektryczna dla NiZn	≈ 100	≈ 50	-	≈ 25	≈ 15	≈ 12

Względna przenikalność magnetyczna ferrytów zależy od pola magnetycznego i dochodzi do 10⁴
Ferryty znajdują liczne zastosowania – **więcej przy omawianiu materiałów ceramicznych**



69

Współczynnik AL pozwala obliczyć indukcję cewki z rdzeniem
Współczynnik ten jest podawany w nH



Cewka o indukcji 1 mH na rdzeniu AL 1000 będzie wymagała

$$N = \sqrt{\frac{1 \text{ [mH]}}{1000 \text{ [nH]}}} \sqrt{\frac{10^6 \text{ [nH]}}{10^3 \text{ [nH]}}} = \sqrt{10^3} = 31,6 \rightarrow 37 \text{ zwojów}$$

W niektórych katalogach zamiast wartości AL można znaleźć wartość analogicznego parametru α . Informuje on ile zwojów należy nawinąć na rdzeń, aby uzyskać indukcję równą 1 mH.

$$\alpha = \frac{N}{\sqrt{L}} = \frac{1000}{\sqrt{AL}}$$

Własności ferrytów omówione będą dokładniej w dalszej części wykładu

70

Kondensatory



Kondensator stanowią dwie odizolowane płyty przewodzące (okładki) gromadzące energię w postaci pola elektrycznego (gromadzące ładunki)

Kondensatory charakteryzuje się pojemnością C wyrażaną w faradach [F]. Jest to współczynnik proporcjonalności prądu chwilowego do zmian napięcia.

$$i_c = C \frac{du}{dt} \quad X_c = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

Jeśli napięcie nie zmienia się w czasie to prąd nie płynie – reaktancja jest nieskończenie wielka (rozwarcie)

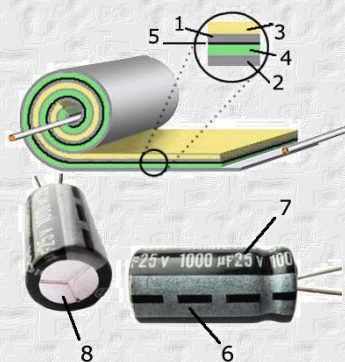
Pojemność kondensatora oblicza się z zależności: $C = \varepsilon \frac{S}{d}$

S - pole powierzchni okładki (wspólne z drugą okładką)
 ε – bezwzględna przenikalność elektryczna izolatora okładek
 d – odległość okładek

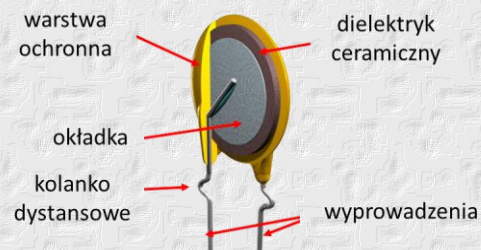
71

Jako materiały izolujące stosuje się:

- powietrze
- papier
- papier nasączony elektrolitem
- ceramikę ferroelektryczną



- 1,2 folia Al.
- 3 izolator (zwykle papier)
- 4 elektrolit
- 5 tlenek Al.
- 6 oznaczenie minusa (elektrolit!)
- 7 oznaczenie pojemności - napięcia znamionowego
- 8 obudowa z zabezpieczeniem



72

obudowa	dł x szer x wys (mm)
A	3,2 × 1,6 × 1,6
B	3,5 × 2,8 × 1,9
C	6,0 × 3,2 × 2,5
D	7,3 × 4,3 × 2,8
E	7,3 × 6,0 × 3,6

1, 2 – tantalowe; 3, 4 – elektrolityczne;
 5, 6, 7 - ceramiczne (rozm. Jak dla rezystorów);
 8 - porcelanowy RF (wysokie Q) RF;
 9 – trymer;
 (rezystor 0,125 W dla porównania rozmiarów)

Superkondensatory

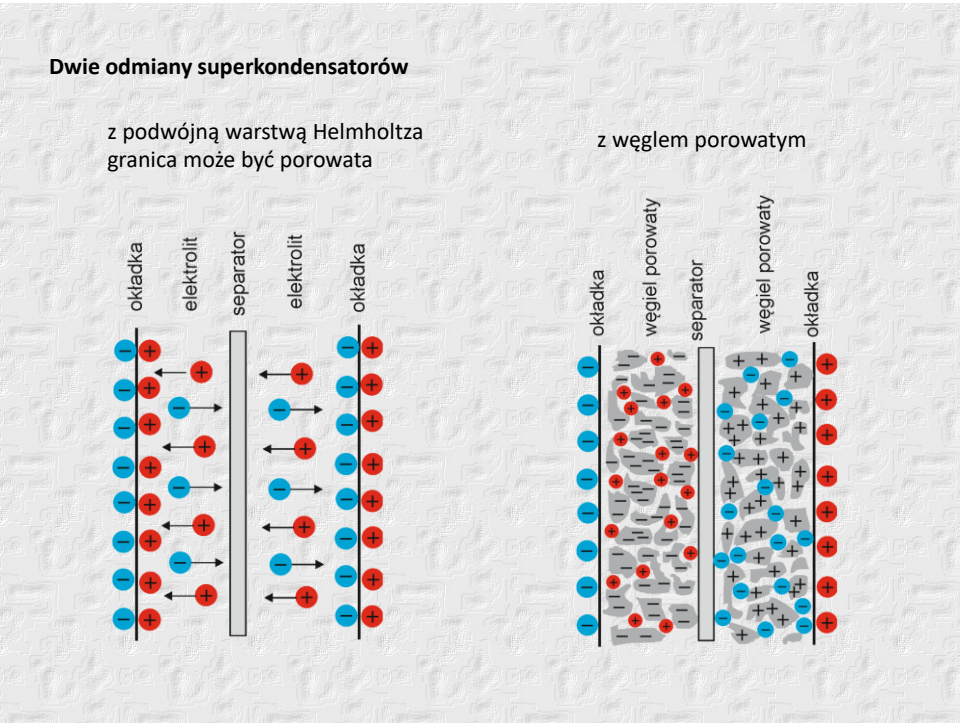
Zalety

- Bardzo duża szybkość ładowania
- Niewielka degradacja nawet do miliona cykli
- Wysoka sprawność nawet do 95%
- Szeroki zakres temperatur pracy
- od -40 °C do +60 °C
- Niski koszt magazynowania energii
- Bezobsługowość

Wady

- Ilość zgromadzonej energii na jednostkę masy rzędu pojedynczych Wh/kg) niższa niż dla źródeł chemicznych (kilkadziesiąt Wh/kg).
- Zmienna wartość napięcia na zaciskach
- Niskie dopuszczalne napięcie pracy 2-3 V
- Szybsze samorozładowanie w porównaniu do baterii

Wykres Ragone'a



75

Połączenie cewki i kondensatora

$$W_{L\max} = \frac{LI^2}{2}$$

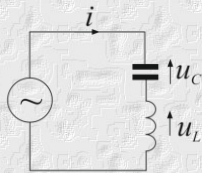
$$W_{C\max} = \frac{CU^2}{2}$$

Dla częstotliwości, dla której reaktancje indukcyjna i pojemnościowa są równe wymiana energii jest najbardziej efektywna tj. płynie największy prąd – następuje rezonans:

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \rightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \rightarrow f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

76

Dwa rodzaje obwodów rezonansowych – zależne od sposobu dołączenia źródła



szeregowy
w rezonansie

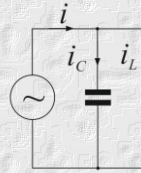
$$u_L + u_C = 0$$

rezonans napięć

$$i = \max$$

zwarcie

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$



równoległy
w rezonansie

$$i_L + i_C = 0$$

rezonans prądów

$$i = 0$$

rozwarcie

77

Bimetale

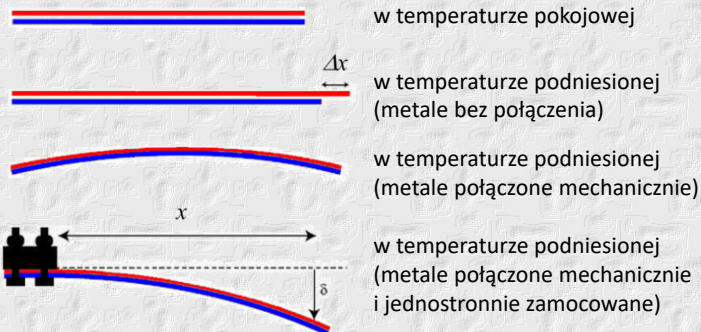
- trwałe mechaniczne połączenie dwóch metali lub stopów o możliwie najbardziej różnych rozszerzalnościach cieplnych.

Najczęściej wykorzystuje się stopy **żelaza i niklu**

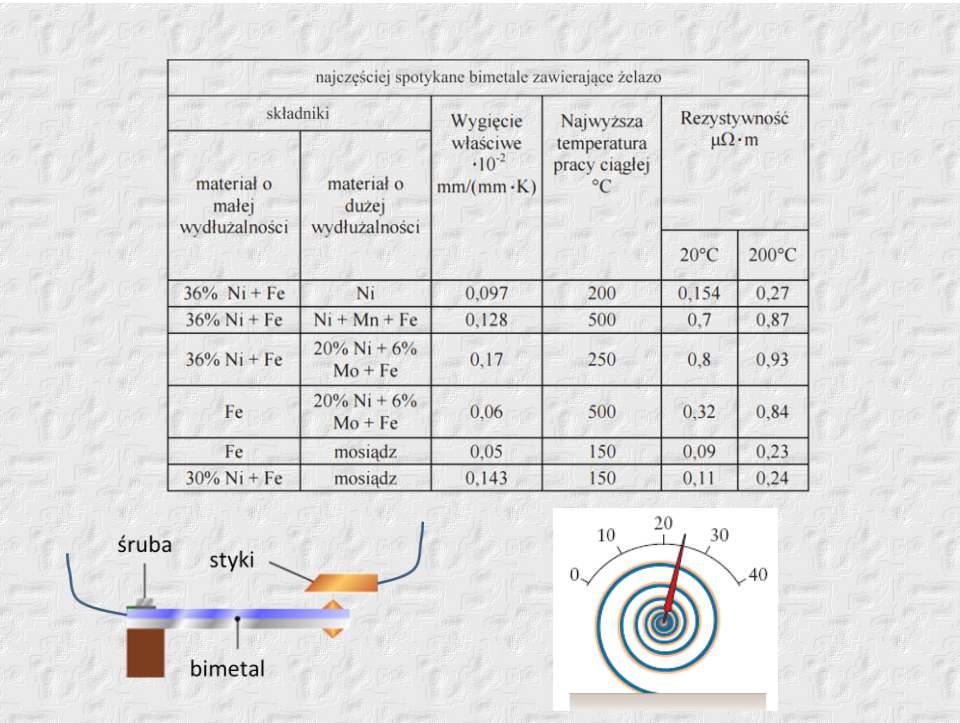
Powszechnie wykorzystywanym bimetalem nie zawierającym żelaza jest **kupał (Cu+AL)**

Zawiera on zwalcowane na gorąco warstwę aluminium i jedną lub dwie warstwy miedzi

Stosowany jest do budowy torów przewodowych wysokiej częstotliwości, radiatorów oraz na złącz przewodów elektrycznych wykonanych z tych metali (celem eliminacji korozji elektrochemicznej).



78



79

Termopary (termoogniwa, termoelementy, ogniwa termoelektryczne)

Zasada działania oparta jest na zjawisku Seebecka:

liczba elektronów swobodnych w metalu zależy od temperatury, a zatem na końcu zimniejszym koncentracja elektronów będzie wyższa - powstanie różnica potencjałów.

Łącząc dwa różne metale można to zjawisko wzmocnić, ponieważ istnieją przewodniki o ujemnym i dodatnim współczynniku Seebecka.

Termoparę stanowią dwa przewodniki połączone na końcach.

Napięcie na termoparze zależy od iloczynu różnicy współczynników Seebecka oraz różnicy temperatur.

$$V = (S_A - S_B)(T_B - T_A)$$

80

przewodnik	wsp. Seebecka [μV/K]
antymon	47
molibden	10
nikiel	-15
konstantan	-35
bismut	-72
miedź	1,2

termopara	wsp. Seebecka [μV/K]
chromel* - konstantan	60
żelazo - konstantan	51
miedź - konstantan	40
chromel – alumel**	40

* stop 90% Ni + 10% Cr)

** stop Ni + 2,5% Al + ~2% Mg + 2% Si
+ dodatki stopowe Fe, Co ...

Termopary wykorzystuje się jako czujniki temperatury do temperatur dochodzących nawet do 2300 °C, rzadziej jako źródło zasilania o bardzo niskim napięciu i relatywnie wysokim prądzie (niemal zwarcie).

Zalety:
wysoka temperatura pracy ciągłej
wysoka odporność na czynniki zewnętrzne
generatywność
niski TWR
stałość parametrów w czasie
prostota konstrukcji

Wady:
mechaniczna nietrwałość złącza
niskie wartości wsp. Seebecka
(w metalach – w półprzewodnikach mogą sięgać 2000)

81

Zjawisko Thomsona (Kelwina)

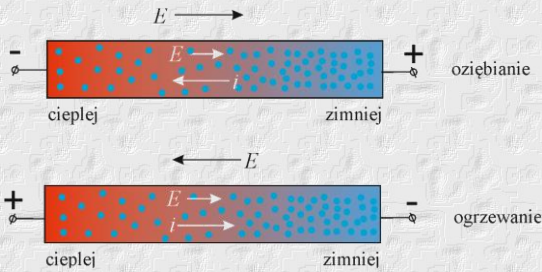
W przewodniku z gradientem temperatury, przez który płynie prąd wydziela się lub jest pochłaniane ciepło (niezależnie od ciepła Joule’a-Lentza).

Gradient temperatury wywołuje różnicę koncentracji nośników i odpowiadające jej wewnętrzne pole elektryczne. Jeżeli jego kierunek jest zgodny z polem wywołującym prąd (zewnętrznym), to pole wewnętrzne wspomaga dryft nośników kosztem ciepłej energii atomów przewodnika, co prowadzi do jego ochładzania.

Jeśli pola mają kierunek przeciwny, to pole wewnętrzne wykonuje dodatkową pracę, co wiąże się z wydzielaniem dodatkowego ciepła.

$$Q = -\kappa j \Delta T$$

κ – współczynnik Thomsona
 ΔT – zmiana temperatury
 j – gęstość prądu



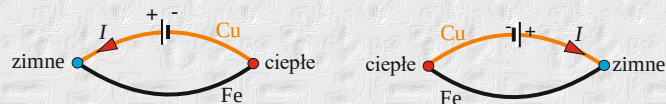
82

Efekt Peltiera

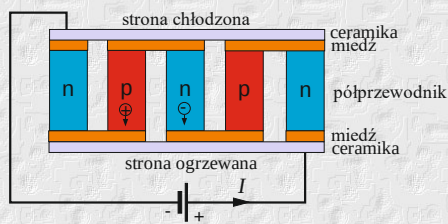
Efekt przeciwny do Seebecka - zachodzi na granicy dwóch różnych przewodników (półprzewodników) połączonych dwoma złączami.

Przewodniki są tak dobrane, że podczas przepływu prądu jedno ze złącz się ogrzewa, a drugie ochładza.

Po zmianie kierunku przepływu prądu na przeciwny, zjawisko ulega odwróceniu.



Efekt Peltiera na złączach półprzewodnikowych jest znacznie silniejszy niż na metalowych



83

Zjawiska termoelektryczne Seebecka, Thomsona i Peltiera łączy relacja Thomsona:

$$\kappa = \frac{d\Pi}{dT} - S \quad \kappa = T \frac{dS}{dT}$$

$$\Pi = TS$$

κ – współczynnik Thomsona

Π – współczynnik Peltiera

S – współczynnik Seebecka

T – temperatura

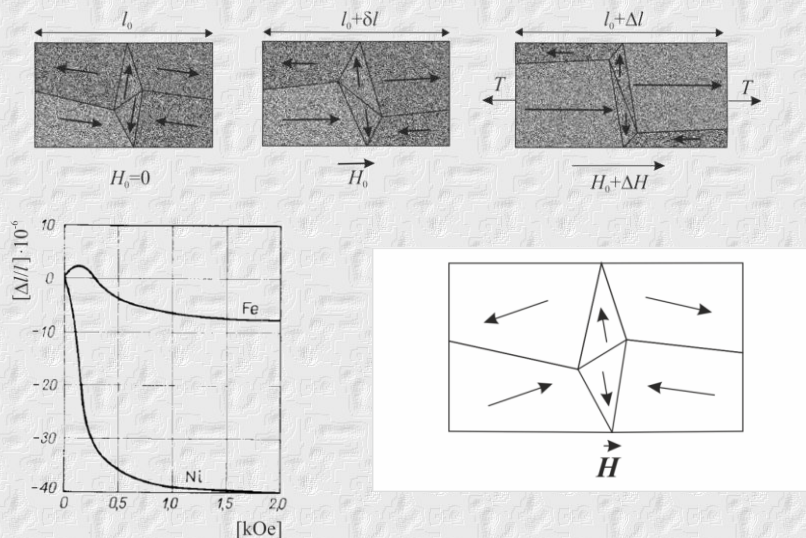
Zjawiska termoelektryczne są szczególnie silnie w półprzewodnikach.

Zjawisko Peltiera wykorzystywane jest w chłodziarkach termoelektrycznych.

84

Magnetostrykcja

Odkrycie Joule'a. Zmiana geometrii ferromagnetyków pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego.



85

W konkretnym kierunku magnetostrykcja opisywana jest równaniem macierzowym:

$$\begin{bmatrix} S \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C^H & d \\ d^* & \mu^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T \\ H \end{bmatrix}$$

$S = \Delta l/l$ wydłużenie względne elementu o długości l w wybranym kierunku

C^H współczynnik sprężystości w danym kierunku przy stałej wartości natężenia pola magnetycznego H działającego w tym kierunku

μ^T przenikalność magnetyczna materiału w wybranym kierunku przy stałym naprężeniu osiowym T

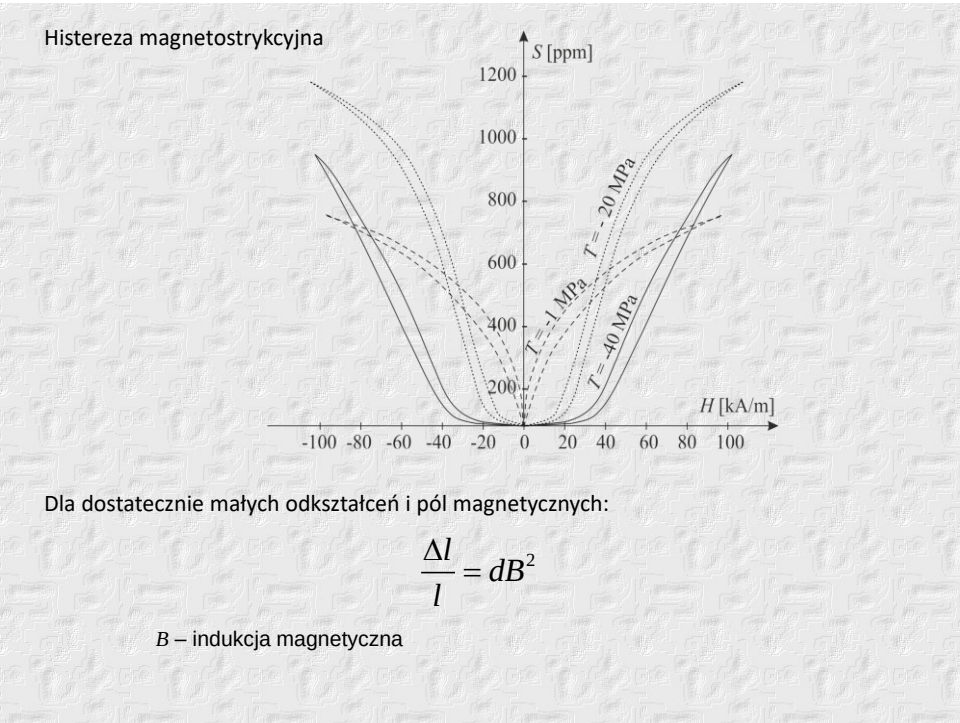
$d \approx d^*$ współczynniki magnetostrykcji w danym kierunku

Magnetostrykcję opisuje się też za pomocą współczynnika sprzężenia magnetomechanicznego.

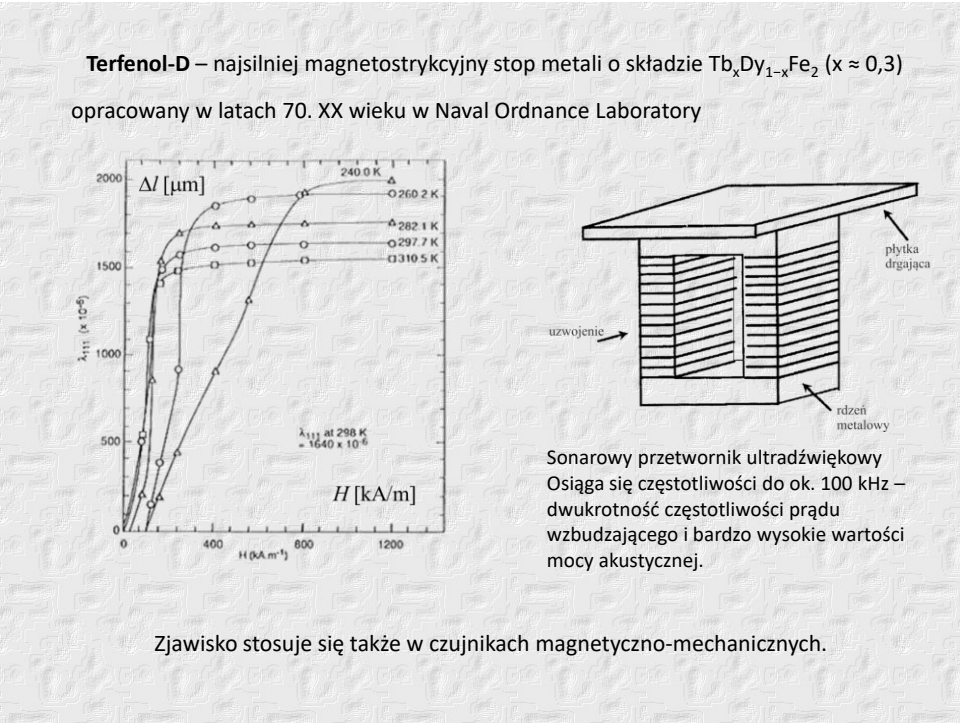
$$k = \frac{E_{mM}}{\sqrt{E_m E_M}} = \frac{d}{\sqrt{C^H \mu^T}}$$

E_{mM} jest wewnętrzną energią sprzężenia mechaniczno-magnetycznego, E_m energią mechaniczną, E_M energią magnetyczną. Wartość tego współczynnika waha się od 0,5 nawet do ok. 0,97 dla szkła metalicznych.

86



87

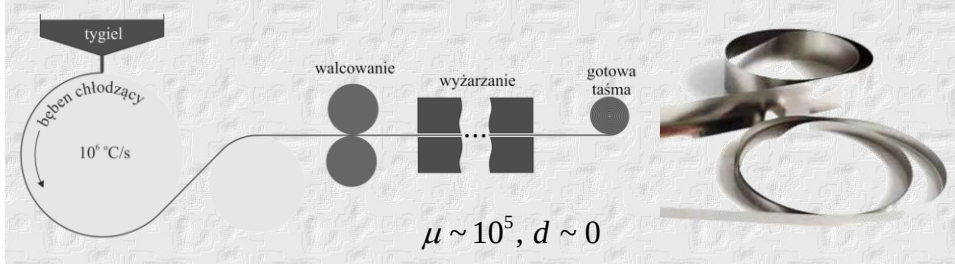


88

Magnetostrykcja wybranych materiałów

materiał	maksymalne osiągnięte wydłużenie względne · 10 ⁻⁶ [μ]
Fe	-7
Ni	-33
Co	-62
CoFeO ₄	-110
Galfenol Fe _{1-x} Ga _x x ≈ 0,12 – 0,33	400
SmFe ₂	-1560
TbFe ₂	1753
Terfeol-D Tb _x D _{1-x} Fe ₂ x ≈ 0,3	2400

Magnetostrykcja jest odpowiedzialna za brzęczenie transformatorów – poszukuje się zatem materiałów o zerowej magnetostrykcji i wysokiej przenikalności



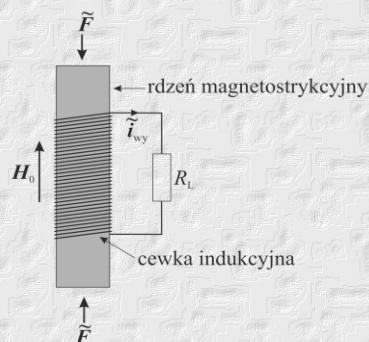
89

Efekt Villariego

Deformacja mechaniczna ferromagnetyka wywołana działaniem siły zewnętrznej skutkuje zmianą rozmiarów domen i podatności magnetycznej ferromagnetyka lub jego stanu namagnesowania.

Generator magnetostrykcyjny

Zmienna siła powoduje zmianę podatności magnetycznej rdzenia cewki i tym samym zmianę przechodzącego przezeń strumienia magnetycznego. Zmiana strumienia na zasadzie indukcji generuje prąd w cewce.



90

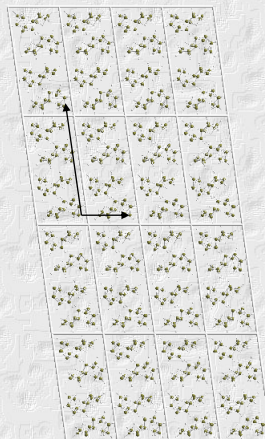
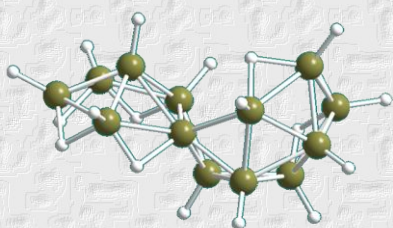
KRYSZTAŁY

91

κρύσταλλος - lód

Kryształ to stan skupienia materii, w którym cząsteczki, atomy lub jony zajmują ściśle określone miejsca w przestrzeni i mogą jedynie drgać tylko w obrębie tychże miejsc.

W odróżnieniu od ogólnie rozumianego ciała stałego (np. ciała amorficznego) kryształy posiadają określoną symetrię.



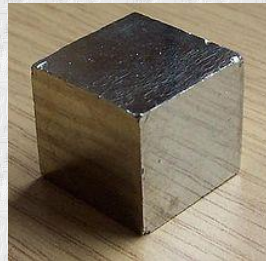
92

- Monokryształy (kryształy)
- Polikryształy

Naturalny kryształ pirytu



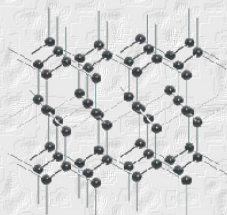
struktura polikrystaliczna



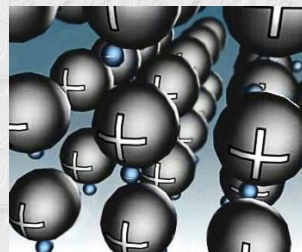
struktura monokrystaliczna

93

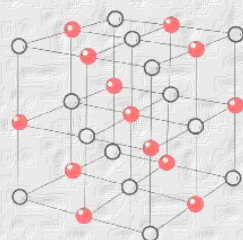
Rodzaje struktur krystalicznych



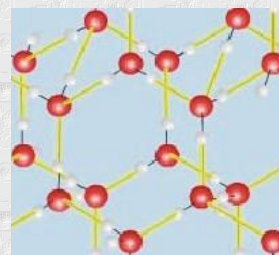
Struktura kowalencyjna (diament)
wiązania kowalencyjne



Struktura metaliczna
wiązania kowalencyjne kationów



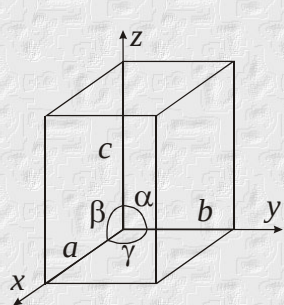
Struktura jonowa (sól kuchenna)
wiązania jonowe



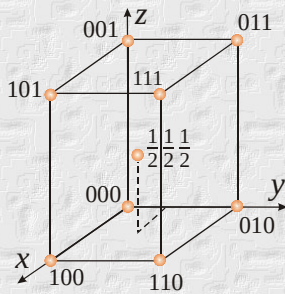
Struktura molekularna (lód)
wiązania wodorowe

94

Układ krystalograficzny opisuje się często za pomocą sieci Bravais’a wypełniając przestrzeń przez wielokrotne powtarzanie translacji tzw. komórki elementarnej. Sieci Bravais uzyskiwane są przez złożenie 7 systemów krystalograficznych i 4 sposobów centrowania. Spośród teoretycznie możliwych 28 (7x4) sposobów złożenia w naturze występuje tylko 14.

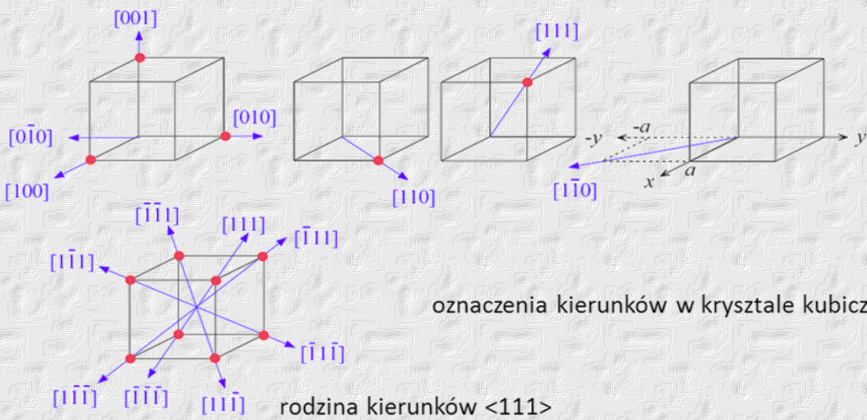


Komórka elementarna
osie krystalograficzne
stałe sieciowe



Sieć przestrzenna
wskaźniki węzłów sieci

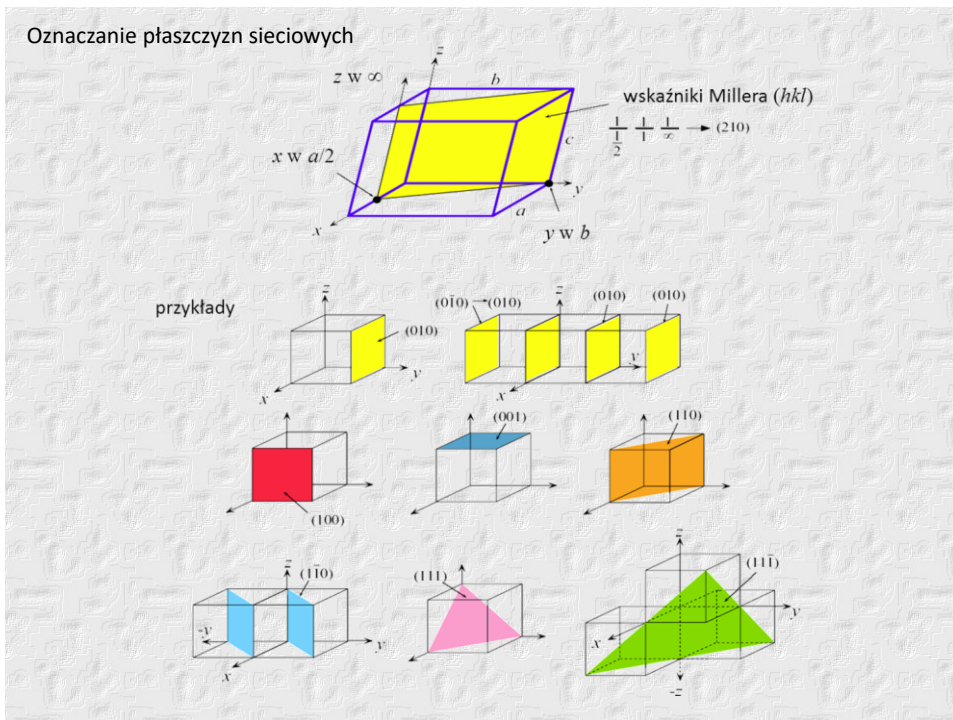
Wskaźniki Millera



oznaczenia kierunków w kryształe kubicznym

rodzina kierunków <111>

Oznaczanie płaszczyzn sieciowych



97

UKŁADY KRystalograficzne

układ regularny (sześcienny) $a = b = c$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ (sól kamienna, diament)

układ tetragonalny $a = b \neq c$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ (kasyteryt, cyrkon, wezuwian)

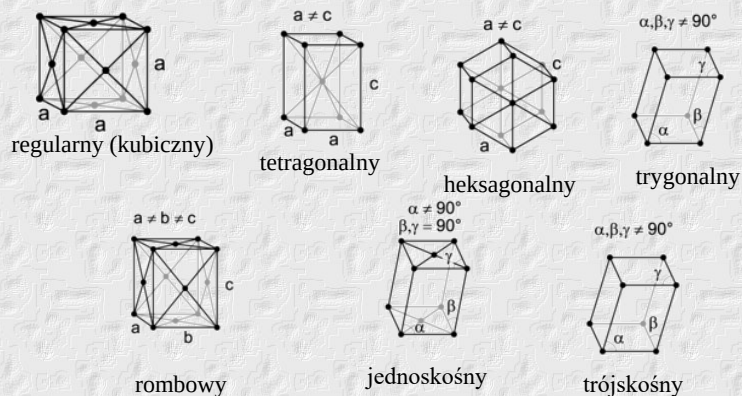
układ heksagonalny $a = b \neq c$, $\alpha = \beta = 90^\circ$, $\gamma = 120^\circ$ (beryl, apatyt, grafit)

układ trygonalny $a = b \neq c$, $\alpha = \beta = 90^\circ$, $\gamma = 120^\circ$ (kalcyt, korund, kwarc)

układ rombowski $a \neq b \neq c$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ (siarka, oliwin, struwit)

układ jednoskośny $a \neq b \neq c$, $\alpha = \gamma = 90^\circ$, $\beta \neq 90^\circ$ (gips, ortoklaz)

układ trójskośny $a \neq b \neq c$, $\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$ (cyanit, aksynit)

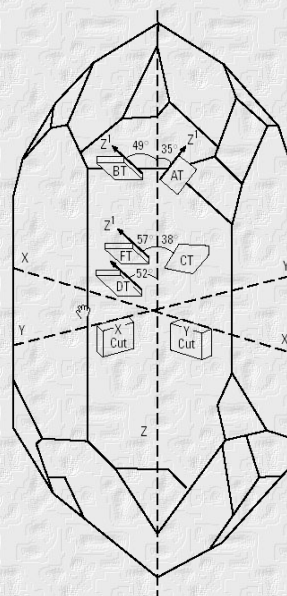


98

Monokryształy

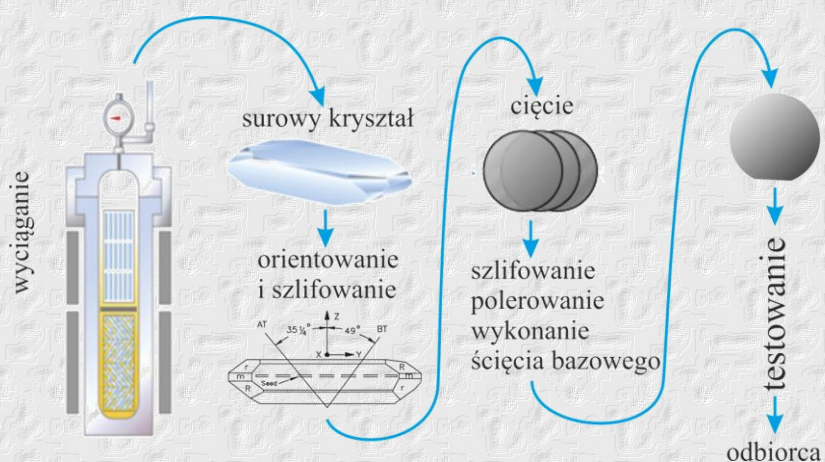


długość do 2 m
średnica: zazwyczaj
200mm (do 300mm;
rzadko 400mm)
masa: do 225 kg
orientacja
krystalograficzna (111)
lub (100)
czas: 3 dni

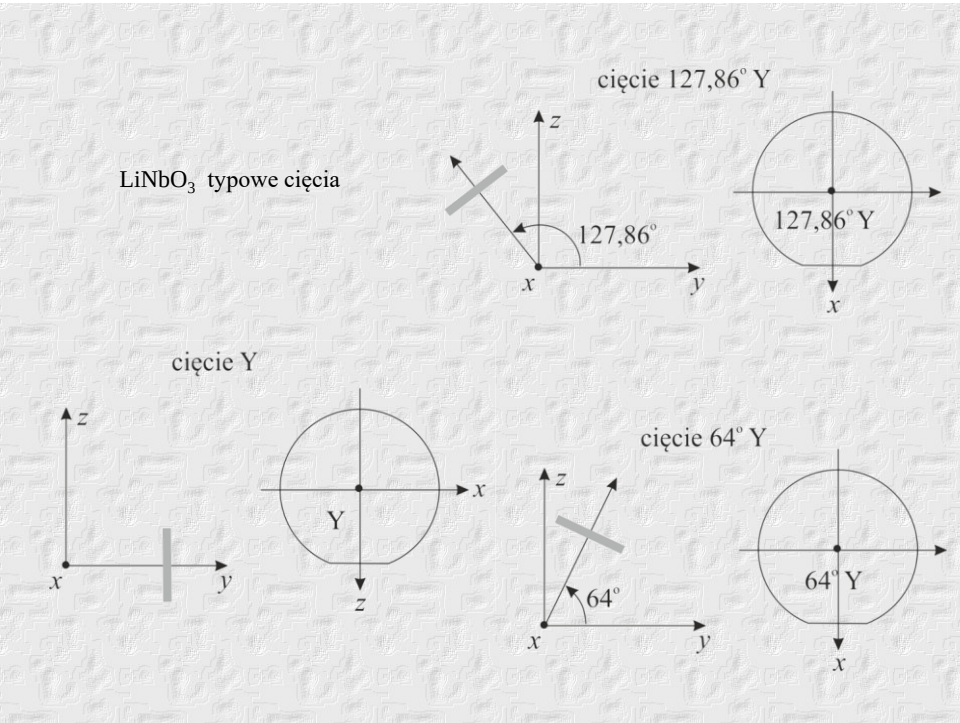


99

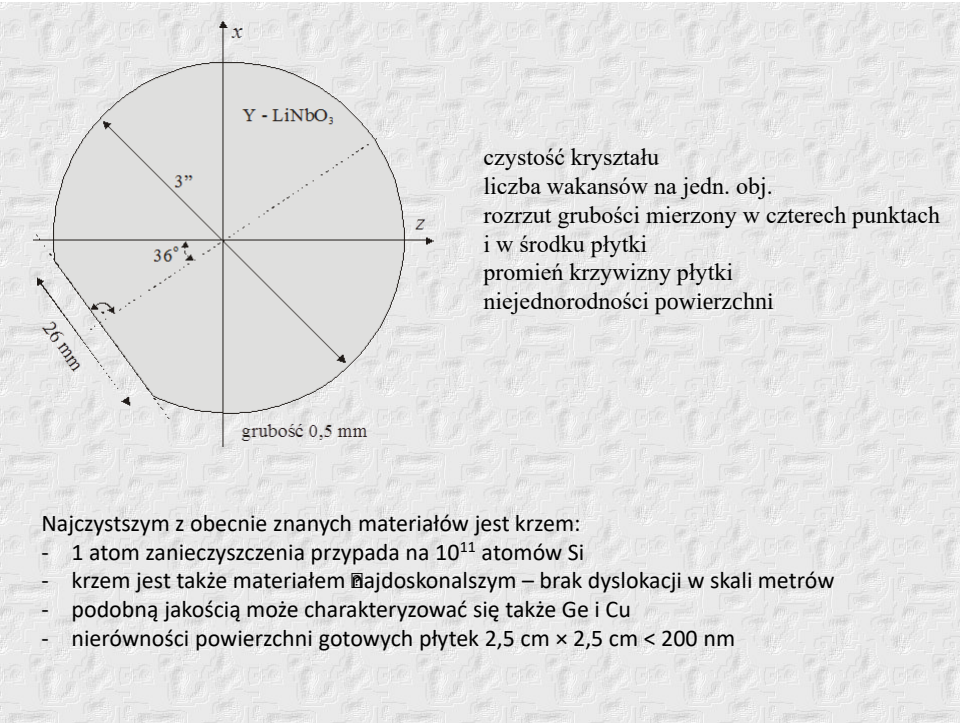
Technologia kryształów (schemat zgrubny)



100



101



102

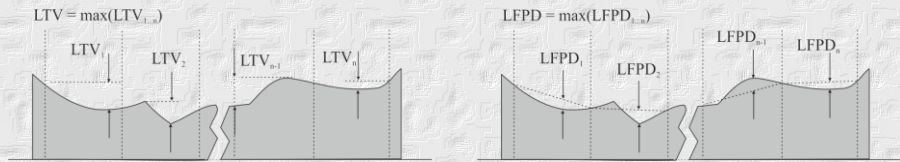
Podstawowe globalne parametry płytek

TTV Total Thickness Variation	Suma maksymalnych dodatnich i ujemnych odchytek względem równoległej płaszczyzny przylegania. Płytkę przysysaną próżniowo, nie uwzględnia się jej zwężenia.	$TTV= A + B $
TIR Total Indicated Reading	Jw. ale z uwzględnieniem zwężenia	$TIR= A + B $
Warp	Jw. ale bez przysysania	$WARP= A + B $
Bow	Odległość między powierzchnią najlepiej dopasowaną a środkiem płytki (bez przysysania)	

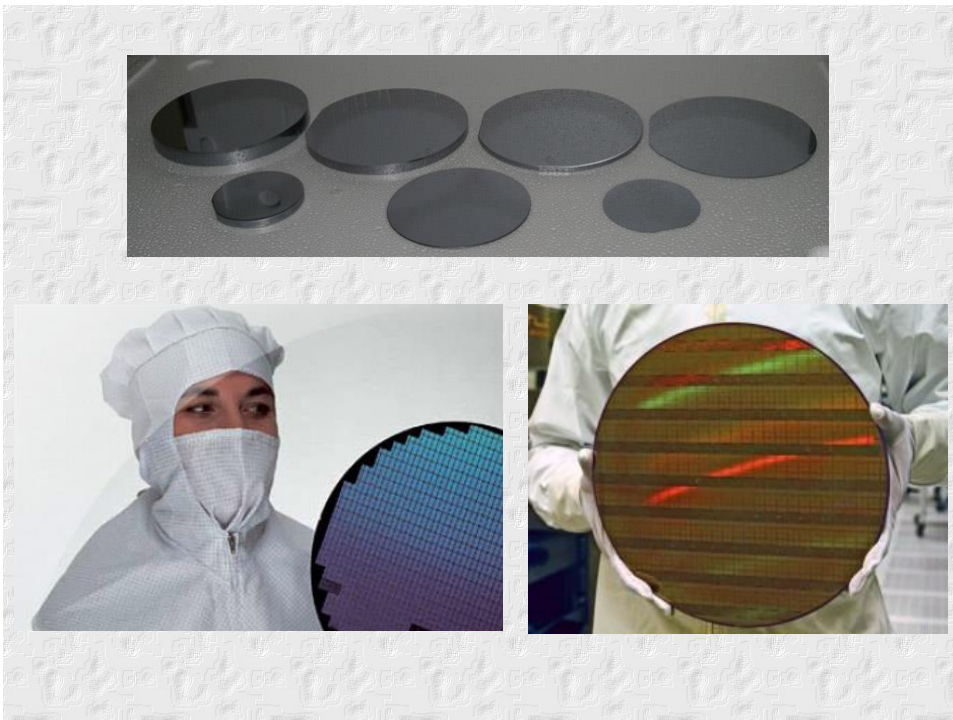
103

Podstawowe lokalne parametry płytek

LTV Local Thickness Variation	Maksymalna odległość pomiędzy najwyższym a najniższym punktem na określonym polu powierzchni (np. 10 × 10 mm ²). Płytkę przysysaną próżniowo, nie uwzględnia się jej lokalnego zwężenia.
LFPD Local Focal Plane Deviation	Jw. ale z uwzględnieniem lokalnego zwężenia.



104



105

Ciekłe kryształy

- stan przejściowy pomiędzy ciałem stałym a cieczą izotropową
- zdolność do płynięcia (cecha cieczy) połączona z daleko zasięgowym uporządkowaniem struktury (cecha kryształu)
- faza ciekłokrystaliczna – mezofaza
- generowanie faz ciekłokrystalicznych
 - termotropowe
 - liotropowe

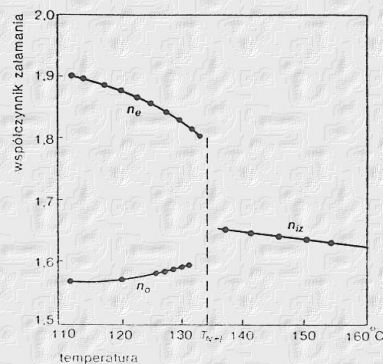


Cząsteczki termotropowego ciekłego kryształu mogą mieć kształt prętów bądź dysków

106

Materiały takie wykazują silną dwójłomność zarówno naturalną jak i wymuszoną. Zjawisko to polega na zdolności ośrodka do podwójnego załamania światła (rozdzielenia promienia świetlnego). Zachodzi ono dla ośrodków anizotropowych, w których współczynniki przenikalności elektrycznej ϵ (i co za tym idzie prędkość oraz współczynnik załamania światła) zależą od kierunku drgań wektora pola elektrycznego (polaryzacji fali).

W kryształach takim istnieje tzw. oś optyczna, tj. kierunek, w którym biegnące światło nie rozdziela się na dwa promienie. Kierunek tej osi nie zależy od kształtu kryształu. Istnieją kryształy jedno- i dwuosiowe.

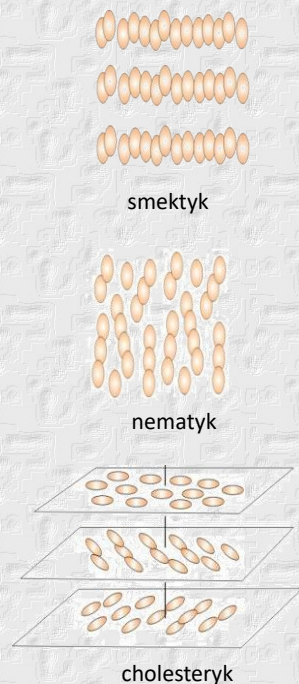


107

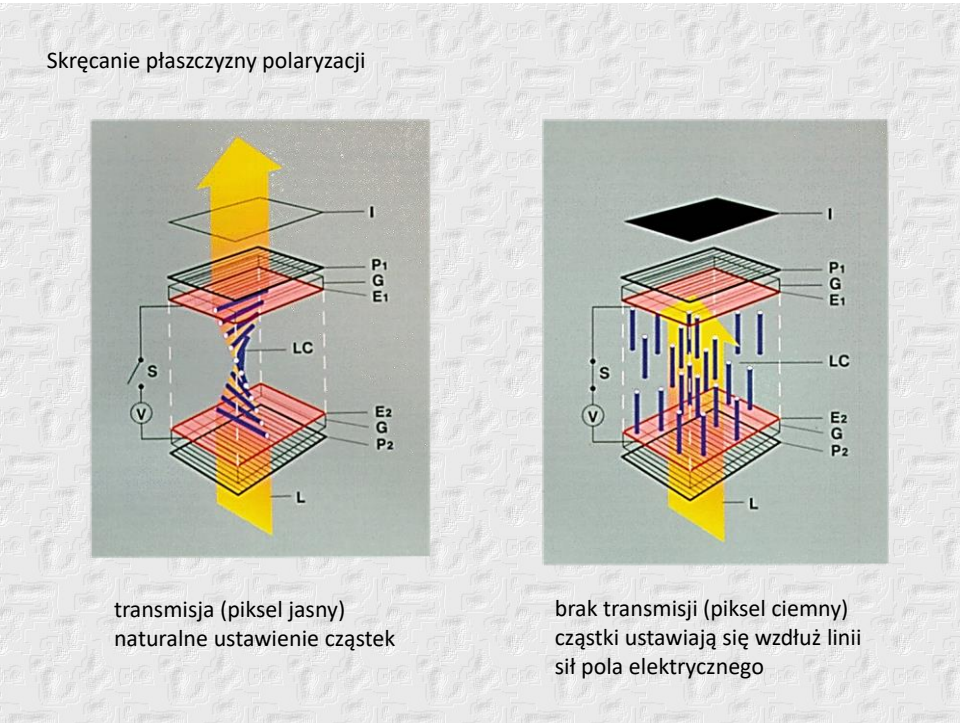
Fazy termotropowe

- **nematyczna N** - wszystkie molekuly są w przybliżeniu wzajemnie równoległe. Nematyk jest optycznie jednoosiowy, dodatni
- **cholesteryk N** - molekuly chiralne są ułożone warstwami jak karty, w każdej warstwie są wzajemnie równoległe a wektor kierunkowy w każdej kolejnej warstwie zmienia kierunek o tę samą wartość. Cholesteryk N jest jednoosiowy i aktywny optycznie
- fazy smektyczne $S_a, S_b, \dots, S_i$: molekuly są ułożone w warstwy, a osie molekuł tworzą z normalną do warstwy kąt $< 90^\circ$. Fazy te różnią się między sobą głównie sposobem uporządkowania

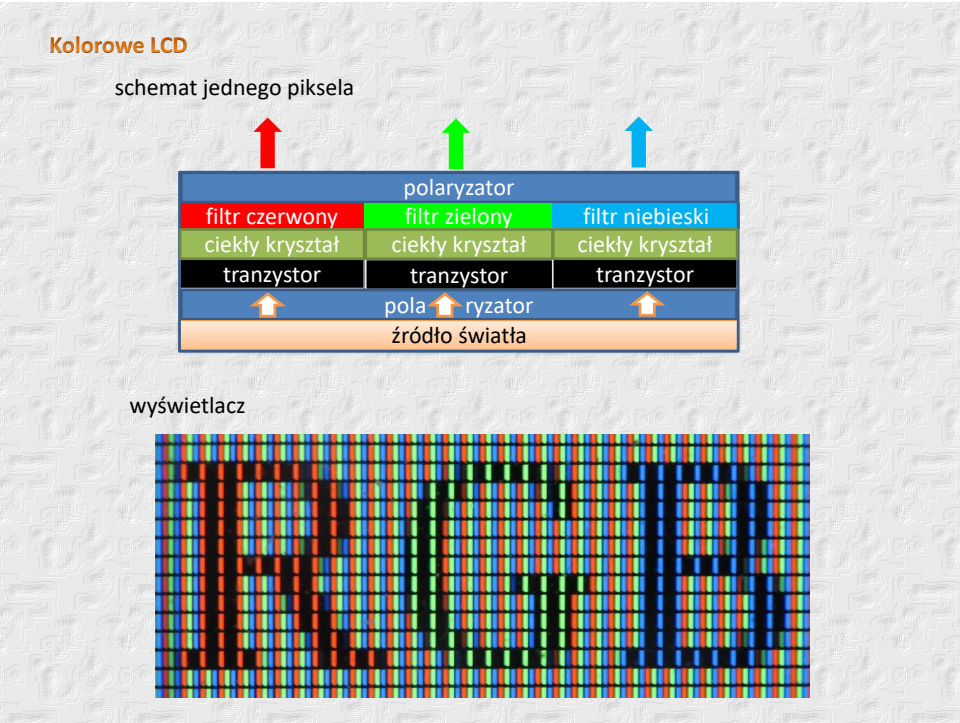
Miedzy fazą stałą a izomorficzną może występować jedna faza kryształu (monomorfizm), dwie (dimorfizm) aż do sześciu (heksamorfizm). Zjawisko to nazywane jest polimorfizmem



108



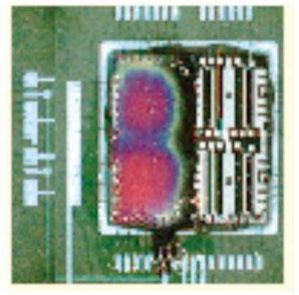
109



110

Inne zastosowania

- pamięci komputerowe
- termografia
 - medycyna
 - ciepłownictwo
- żaluzje ciekłokrystaliczne
- papier elektroniczny



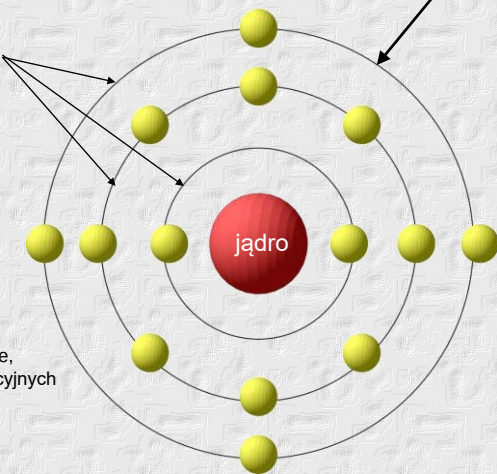
111

Model pasmowy przewodnictwa

Si - krzem 14 elektronów

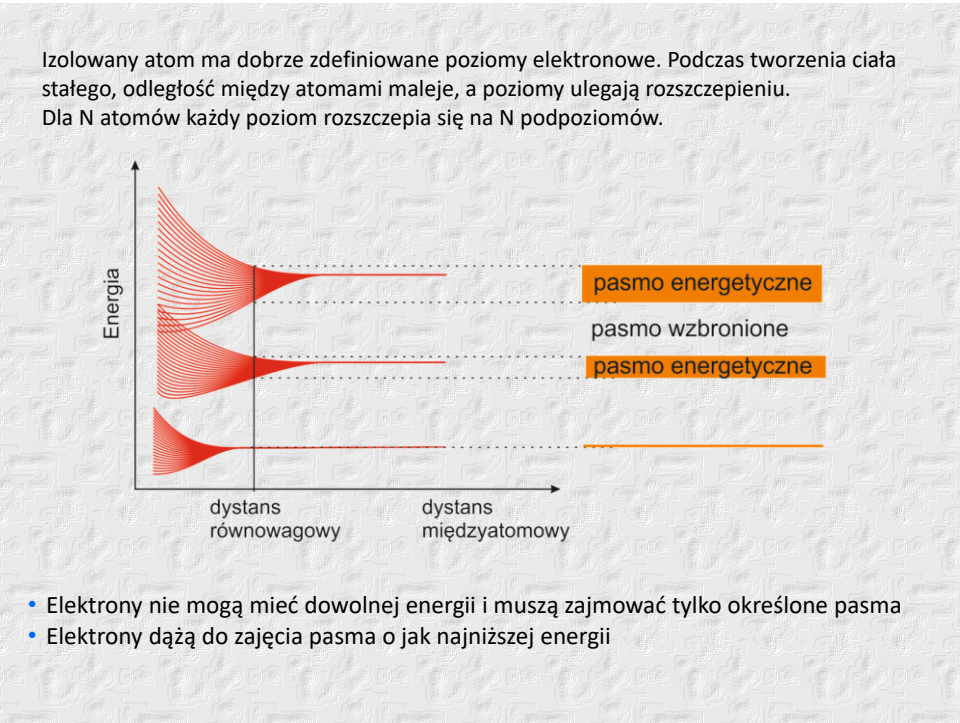
Powłoka walencyjna
- najwyższa energia elektronów dla $T=0\text{ K}$

Powłoki

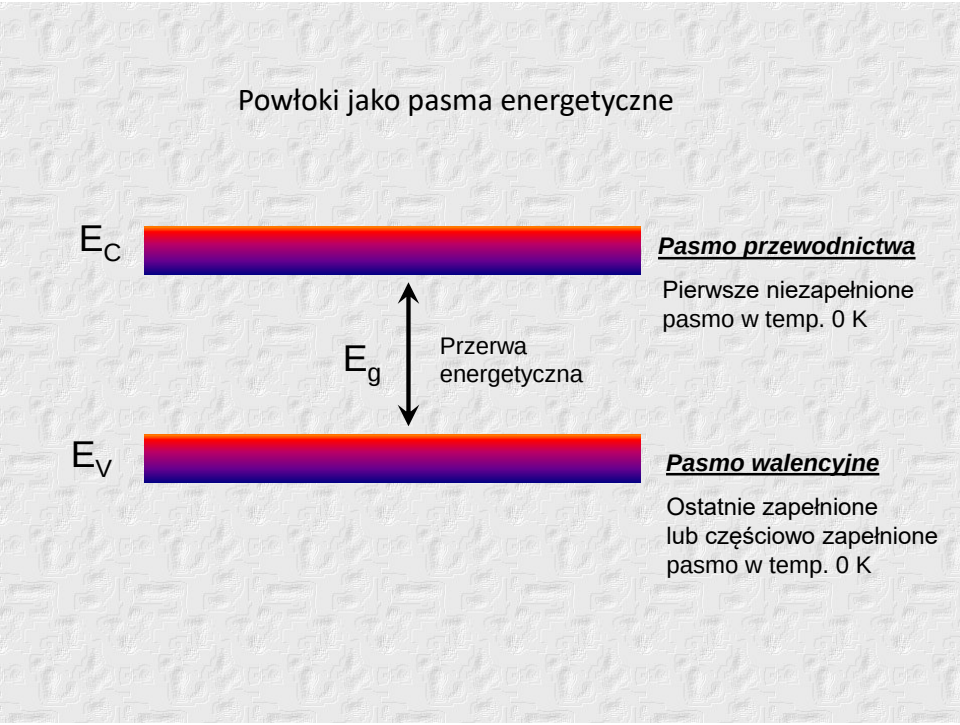


Si - 4 elektrony walencyjne,
Cu - 11 elektronów walencyjnych

112

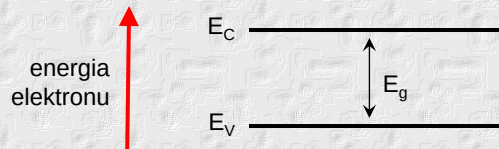


113



114

Diagram pasm



E_C → dolna krawędź pasma przewodnictwa = najniższa energia wolnego elektronu

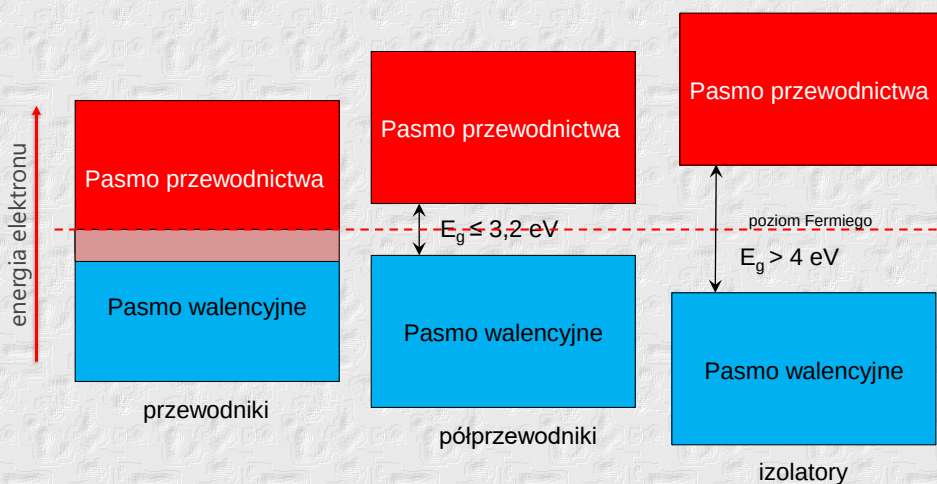
E_V → górna krawędź pasma walencyjnego = najwyższa energia elektronu pozostającego na zewnętrznej powłoce (związanego z atomem)

E_G → przerwa energetyczna (pasmo wzbronione) = zakres energii, której elektrony nie mogą mieć

Przewodzenie prądu jest możliwe tylko wtedy gdy energia elektronów będzie wyższa od E_C

115

Nadal rzecz się dzieje w temperaturze 0 K



3,2 eV jest energią jaką może dostarczyć światło słoneczne

116

Dla temperatur wyższych od 0 K drgania termiczne mogą nadać elektronom energię wystarczającą do przedostania się do pasma przewodnictwa

- **generacja** – powstanie pary wolny elektron - dziura (e^-) - (h^+)
dziura to atom pozbawiony elektronu będący jonem dodatnim
- **rekombinacja** – łączenie się elektronu z dziurą i ich zanik (anihilacja)
- Elektrony i dziury są nośnikami prądu (cząstkami naładowanymi elektrycznie)
- Półprzewodniki dla $T > 0K$ mogą przewodzić prąd jednak bardzo słabo;
w temp. pokojowej w czystym krzemie na każde $3 \cdot 10^{12}$ (trzy tryliony) atomów występuje tylko jeden elektron swobodny

117

W półprzewodniku samoistnym prąd płynie w obydwu kierunkach

118

domieszkowanie

domieszkowanie – dodawanie obcych atomów

Inaczej niż w metalach w półprzewodnikach domieszkowanie zwiększa liczbę nośników prądu - poprawia przewodnictwo

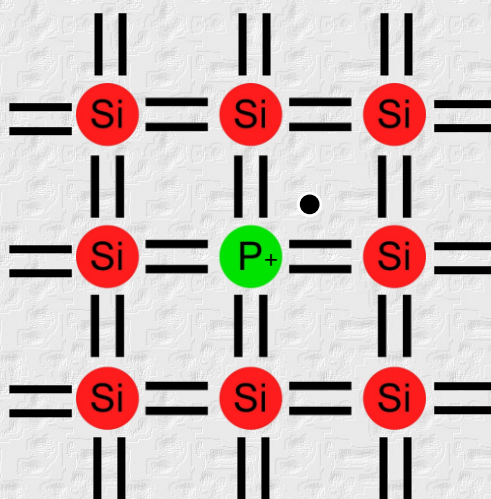
		Kolumna III 3 elektrony walencyjne		Kolumna IV 4 elektrony walencyjne		Kolumna V 5 elektronów walencyjnych			
		IIIA		IVA		VA		VIA	
5	10.811	6	12.01115	7	14.0067	8	15.9994		
	B		C		N		O		
	Boron		Carbon		Nitrogen		Oxygen		
13	26.9815	14	28.086	15	30.9738	16	32.064		
	Al		Si		P		S		
	Aluminum		Silicon		Phosphorus		Sulfur		
IIB									
30	65.37	31	69.72	32	72.59	33	74.922	34	78.96
	Zn		Ga		Ge		As		Se
	Zinc		Gallium		Germanium		Arsenic		Selenium
48	112.40	49	114.82	50	118.69	51	121.75	52	127.60
	Cd		In		Sn		Sb		Te
	Cadmium		Indium		Tin		Antimony		Tellurium
80	200.59	81	204.37	82	207.19	83	208.980	84	(210)
	Hg		Tl		Pb		Bi		Po
	Mercury		Thallium		Lead		Bismuth		Polonium

119

Półprzewodnik typu n (negatywny)

Domieszki donorowe

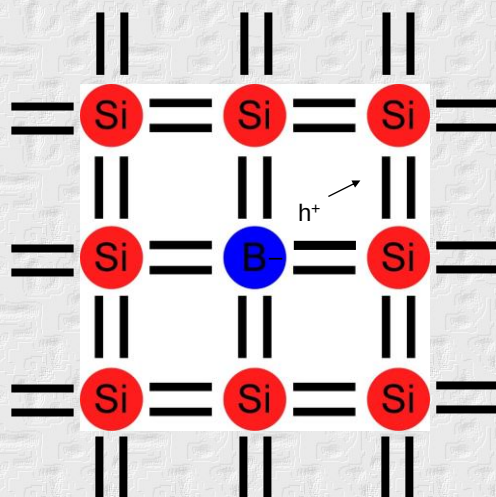
- atomy z 5 elektronami walencyjnymi
np. fosfor P
- dodają dodatkowy elektron
niezwiązany z siecią czyli swobodny
zwany nośnikiem **większościowym**
pozostawiając jeden nieruchomą
dziurę – nośnik **mniejszościowy**
- cały materiał pozostaje elektrycznie
neutralny
- typ n oznacza, że nośnikami prądu
są ładunki ujemne (elektrony)
- N_D = koncentracja donorów wynosi
zwykle $\sim 10^{15}$ - 10^{20} atomów/cm³
- e^- mają ruchliwość $\mu_n \approx 1350$ cm² / V



120

Półprzewodnik typu p (pozytywny)

Domieszki akceptorowe



- atomy z tylko trzema elektronami walencyjnymi np. bor B
- Akceptują (przechwytyują) elektrony i tworzą dodatkowe ruchome dziury pozostawiając nieruchome jony ujemne
- cały materiał pozostaje elektrycznie neutralny
- typ p oznacza, że nośnikami prądu są ładunki dodatnie (dziury)
- N_A = koncentracja akceptorów
- Ruch dziur wymaga zrywania wiązań zatem ich ruchliwość jest dość niska $\mu_p \approx 500 \text{ cm}^2/\text{V}$

121

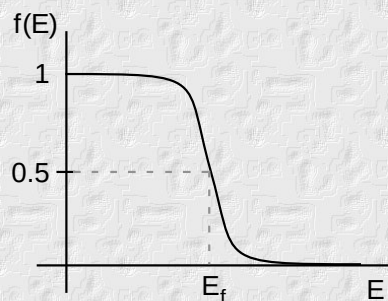
Funkcja Fermiego

Funkcja rozkładu prawdopodobieństwa obsadzenia dostępnych stanów przez elektron

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E - E_f)/kT}}$$

$E_f \rightarrow$ poziom Fermiego

$k \rightarrow$ stała Boltzmanna
 $= 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} = 8,617 \cdot 10^{-5} \text{ eV/K}$

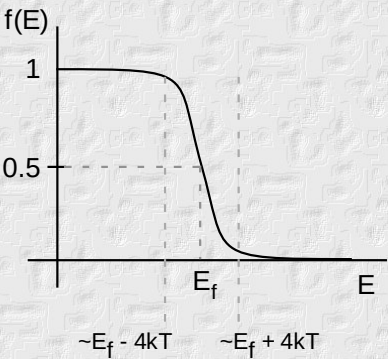


122

Rozkład Boltzmann

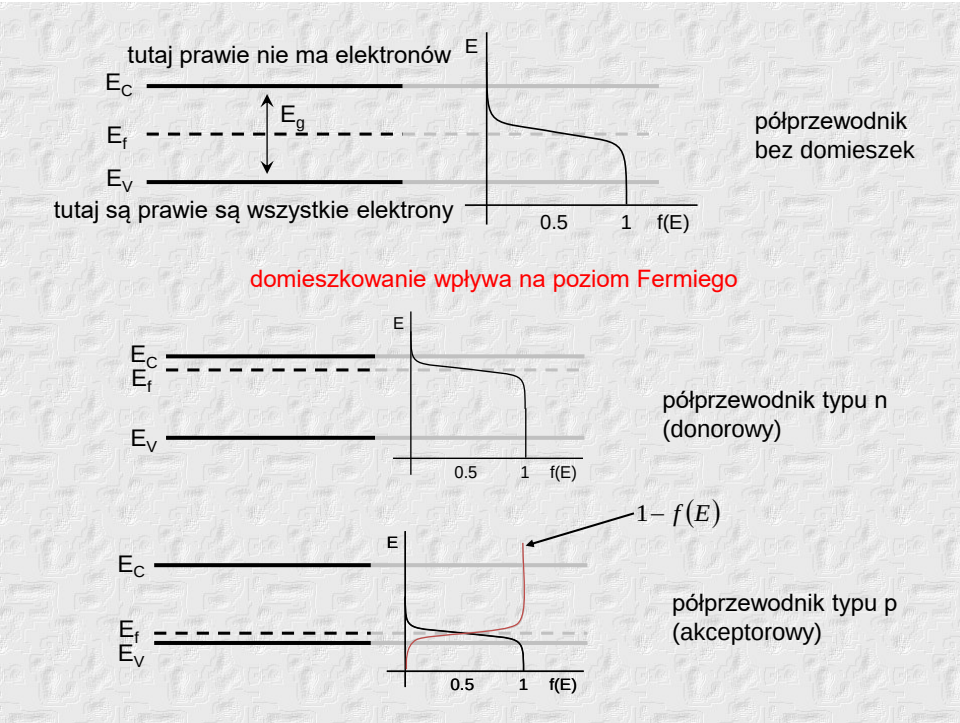
Jeśli $|E - E_f| \gg kT$

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E - E_f)/kT}} \approx \frac{1}{e^{(E - E_f)/kT}}$$



Rozkład Boltzmann opisuje eksponencjalny wzrost liczby nośników w warunkach równowagi termodynamicznej przy występowaniu gradientu potencjału

123



124

Równowaga koncentracji nośników

n - liczba elektronów swobodnych w materiale

p - liczba dziur w materiale

n_i - liczba elektronów swobodnych w materiale bez domieszek

Półprzewodnik jest prawie czysty – poziom Fermiego ma wartość E_f ulokowaną pomiędzy E_v i E_c (ale niezbyt blisko tych wartości)

$$n = n_i e^{(E_f - E_i)/kT}$$

$$p = n_i e^{(E_i - E_f)/kT}$$

$$np = n_i^2$$

125

Relacja neutralności elektrycznej

Dla jednorodnego domieszkowania całkowity ładunek wewnątrz materiału jest zerowy

$$p - n + N_D - N_A = 0$$

liczba nośników liczba nieruchomych jonów

126

Obliczanie koncentracji nośników

- N_A , N_D oraz n_i są konkretne dla danego materiału
- n , p mogą się zmieniać ale można obliczyć ich wartości równowagowe

$$n = \frac{N_D - N_A}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_D - N_A}{2}\right)^2 + n_i^2} = \frac{n_i^2}{p}$$

$$p = \frac{N_A - N_D}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_A - N_D}{2}\right)^2 + n_i^2} = \frac{n_i^2}{n}$$

127

Koncentracja nośników

W materiale niedomieszkowanym (czystym)

$$n = p = n_i$$

Podobnie jest przy domieszkowaniu symetrycznym gdzie liczba akceptorów i donorów jest zbliżona $n_i \gg |N_D - N_A|$

$$n \approx p \approx n_i$$

W materiale domieszkowanym asymetrycznie - donorowo

$$N_D \gg N_A, \quad N_D \gg n_i \quad n \approx N_D, \quad \text{a zatem } p \approx \frac{n_i^2}{N_D}$$

W materiale domieszkowanym asymetrycznie - akceptorowo

$$N_A \gg N_D, \quad N_A \gg n_i \quad p \approx N_A, \quad \text{a zatem } n \approx \frac{n_i^2}{N_A}$$

128

Poziom Fermiego

dla domieszkowania donorami $E_f - E_i = kT \ln \left(\frac{N_D}{n_i} \right)$

dla domieszkowania akceptorami $E_i - E_f = kT \ln \left(\frac{N_A}{n_i} \right)$

ponieważ $n \approx N_D$, a $p \approx N_A$

$$E_f - E_i = kT \ln \left(\frac{n}{n_i} \right) = -kT \ln \left(\frac{p}{n_i} \right) \quad [\text{eV}]$$

129

Dryf nośników w półprzewodnikach

Cząstki nie poruszają się jednak dowolnie z uwagi na oddziaływania z atomami sieci

Średnia prędkość

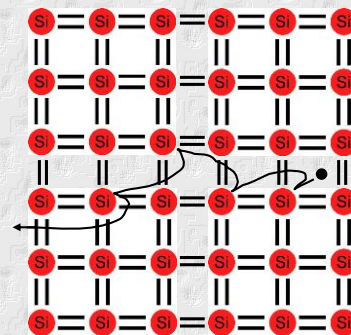
$$\langle v_x \rangle \approx -\mu_n E_x \quad \text{elektronu}$$

$$\langle v_x \rangle \approx \mu_p E_x \quad \text{dziury}$$

$\mu_n \rightarrow$ ruchliwość elektronów

$\mu_p \rightarrow$ ruchliwość dziur

$$\mu_n \approx 3\mu_p$$



Wraz ze wzrostem temperatury ruchliwość maleje

$E \rightarrow$

130

Gęstość prądu

elektronowego $J_{n,dryfu} = \mu_n q n E = \sigma_n E$

dziurowego $J_{p,dryfu} = \mu_p q p E = \sigma_p E$

$q = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ - ładunek elektronu

n = liczba elektronów

p = liczba dziur

σ = konduktywność

Całkowita gęstość prądu

$$J = J_n + J_p = \mu_n q n E = E(\sigma_n + \sigma_p) = \sigma E$$

131

Rezystywność półprzewodników

$$\rho = \frac{1}{q(\mu_n n + \mu_p p)}$$

Dla półprzewodnika typu n

$$\rho = \frac{1}{q \mu_n N_D}$$

Dla półprzewodnika typu p

$$\rho = \frac{1}{q \mu_p N_A}$$

- Wszystkie półprzewodniki są rezystorami (termistorami)
- Półprzewodniki typu p mają większą rezystywność niż typu n
- Pomiar rezystywności pozwala określić koncentrację domieszek

132

Dyfuzja nośników

Dyfuzja → ruch nośników prądu spowodowany gradientem koncentracji

- Nośniki poruszają się chaotycznie w kierunku koncentracji niższej

$$J_{n,dyf} = eD_n \nabla n \quad D - \text{współczynniki dyfuzji}$$

$$J_{p,dyf} = -eD_p \nabla p$$

Całkowity prąd w półprzewodniku należy uzupełnić o prąd dyfuzji:

$$J_n = J_{n,dryfu} + J_{n,dyf} = \mu_n e n E + e D_n \nabla n$$

$$J_p = J_{p,dryfu} + J_{p,dyf} = \mu_p e p E - e D_p \nabla p$$

$$J = J_n + J_p$$

133

Relacja Einsteina

$$\frac{D}{\mu} = \frac{kT}{q} = U_T$$

U_T → tzw. napięcie termiczne, w temp. pokojowej $\approx 25,86 \text{ mV}$

134

dielektryki czyli izolatory

Są to materiały bardzo słabo przewodzące prąd elektryczny z powodu niskiej koncentracji lub niskiej ruchliwości ładunków swobodnych. W dielektrykach rzeczywistych obydwie te cechy występują zwykle równocześnie.

1

Podział materiałów dielektrycznych stosowanych w elektrotechnice według Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC):

gazy szlachetne i nieszlachetne

dielektryki ciekłe

dielektryki stałe organiczne

łatwotopliwe

dielektryki wielkocząsteczkowe nieobrabialne cieplnie

termoplasty

duroplasty

dielektryki stałe nieorganiczne

nie topliwe

stapialne

wypalane

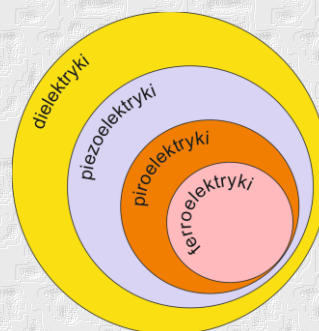
dielektryki stałe o polaryzowalności specjalnej

ferroelektryki

elektrety

piezoelektryki

piroelektryki



2

Podstawowe parametry techniczne charakteryzujące dielektryki

Parametry elektryczne:

polaryzowalność
 przenikalność elektryczna (in. stała dielektryczna)
 współczynnik strat (tangens kąta stratności)
 przewodnictwo właściwe (prąd upływu)
 czas relaksacji
 wytrzymałość na przebicie (wytrzymałość elektryczna)

Parametry magnetyczne

przenikalność magnetyczna
 Podatność magnetyczna

Parametry termiczne:

temperatura Curie
 temperatura topnienia

Parametry optyczne/mikrofalowe:

współczynnik transmisji/absorpcji
 dyspersja
 kolor
 indeks refrakcji

Parametry mechaniczne:

gęstość
 stała Poissona
 moduł sprężystości
 stała Poissona

3

Molekularny mechanizm polaryzacji elektrycznej

Każdy atom składa się z dodatniego jądra i ujemnie naładowanej chmury elektronów

Przy braku pola elektrycznego „środek ciężkości ładunków” obu znaków znajduje się w tym samym punkcie - atom na zewnątrz jest elektrycznie obojętny

W polu elektrycznym F układ ten ulega deformacji co powoduje powstawanie momentu dipolowego molekuly ustawionego w kierunku pola

$$\mu_e = \alpha_e F$$

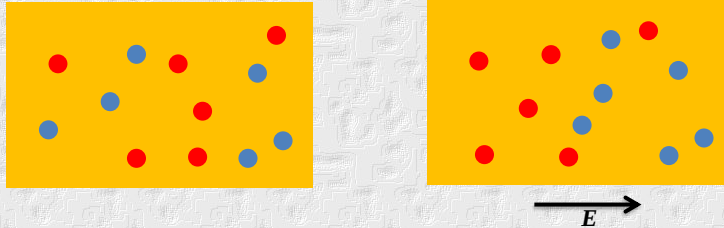
F - wewnętrzne pole sił działające na atom

α_e – polaryzowalność elektronowa

Istnieją molekuly, w których przy braku pola „środek ciężkości ładunków” obu znaków znajdują się w różnych punktach - na zewnątrz molekula taka nie jest obojętna elektrycznie (polaryzacja spontaniczna) jednak losowo ustawiony zespół takich molekul nie wykazuje polaryzacji makroskopowej

4

Od strony makroskopowej w dielektryku istnieją ładunki obydwu znaków. Przy braku pola elektrycznego środek ciężkości wszystkich ładunków obu znaków jest w tym samym punkcie i dielektryk nie wykazuje żadnych własności elektrycznych



W polu elektrycznym E układ ten ulega deformacji co powoduje powstawanie ustawionego w kierunku pola, makroskopowego **momentu dipolowego**

$$\mu_M = \alpha_M E$$

E – zewnętrzne pole elektryczne

α_M – polaryzowalność makroskopowa materiału

5

polaryzowalność mogą umożliwiać różne mechanizmy

polaryzowalność deformacyjna α_d

- elektronowa $\Rightarrow$ przesunięcie chmury elektronowej względem jądra
- atomowa $\Rightarrow$ zmiana położenia atomów w molekuale

polaryzowalność orientacyjna α_{dip}

- dipolowa $\Rightarrow$ zgodna orientacja trwałych dipoli molekularnych

polaryzowalność ładunków swobodnych α_{sc}

- przemieszczenie ładunków swobodnych w dielektryku

polaryzowalność materiału jest sumą polaryzowalności składowych

$$\alpha_M = \alpha_d + \alpha_{dip} + \alpha_{sc}$$

6

Wektorem polaryzacji $\mathbf{P}$ nazywa się wektorową sumę momentów dipolowych przypadających na jednostkę objętości:

$$\mathbf{P} = \frac{\mathbf{m}}{V} = \frac{N}{V} \langle \mathbf{m} \rangle_E$$

$\mathbf{m}$ - całkowity moment dipolowy molekuly

N - liczba molekuł w dielektryku

$\langle \mathbf{m} \rangle_E$ - rzut na kierunek pola $\mathbf{E}$

Całkowity wektor polaryzacji składa się z sumy wektorów polaryzacji deformacyjnej (elektronowej i atomowej) i orientacyjnej (dipolowej)

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}^{def} + \mathbf{P}^{or} = \mathbf{P}_e + \mathbf{P}_a + \mathbf{P}_d$$

W bardzo silnych polach elektrycznych praktycznie wszystkie dipole mają orientację zgodną z kierunkiem pola - dalsze zwiększanie natężenia pola elektrycznego nie może zwiększyć polaryzacji orientacyjnej. Stan taki nazywa się nasyceniem.

Polaryzacja deformacyjna nie doznaje nasycenia.

7

Indukcja elektryczna (przesunięcie elektryczne)

Opisuje pole elektryczne wewnątrz dielektryka zaindukowane przez zewnętrzne pole elektryczne

Pod wpływem pola zewnętrznego dochodzi w dielektryku do rozsunienia ładunków dodatnich i ujemnych (ładunek indukowany).

Wektor indukcji elektrycznej jest zgodny co do kierunku z wektorem pola zewnętrznego i co do długości równy stosunkowi ładunku indukowanego przez pole elektryczne na powierzchni ciała, do pola przekroju tej powierzchni.

Dla pola prostopadłego do powierzchni:

$$|\mathbf{D}| = \frac{q}{S}$$

Jeśli pole elektryczne z powierzchnią tworzy mniejszy kąt α wówczas:

$$|\mathbf{D}| = \frac{q}{S \cos \alpha}$$

8

Wektor indukcji elektrycznej jest sumą wektorów natężenia pola elektrycznego i polaryzacji

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

współczynnik ε nazywany jest przenikalnością elektryczną

Parametr ten charakteryzuje dielektryki

powietrze	1,0006
olej	2,0 – 2,4
papier	1,8 – 2,6
szkło	5,0 – 16
diament	12
alkohol etylowy	26
woda	81
tytanian baru	1 000 – 10 000

Stosunek polaryzowalności do przenikalności elektrycznej jest wielkością bezwymiarową zwaną podatnością elektryczną

$$\chi = \frac{\mu}{\varepsilon}$$

9

Po umieszczeniu dielektryka między okładkami kondensatora pole elektryczne w nim zawarte maleje ε razy

$$Q = C_0 U_0 = C \frac{U_0}{\varepsilon}$$

a więc

$$C = \varepsilon C_0 = \frac{\varepsilon S}{d}$$

kondensator z dielektrykiem

kondensator bez dielektryka

Wprowadzenie dielektryka do naładowanego określonym ładunkiem kondensatora obniża jego energię (ponieważ maleje natężenie pola) - dielektryk jest wciągany w pole kondensatora

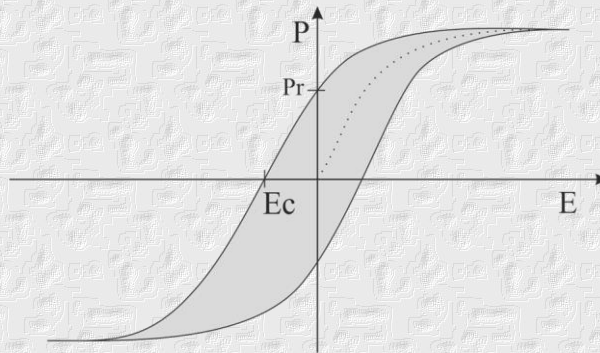
Dielektryki poprzeczne i podłużne

- w poprzecznych pole zewnętrzne ulega zmniejszeniu
- w podłużnych pozostaje bez zmian

10

Procesy polaryzacji dielektryków są dość wolne i w zmiennym polu elektrycznym może zdarzyć się, że polaryzacja dielektryka przestanie nadążać za zmianami pola

Zmiana polaryzacji wiąże się też ze stratami energii



11

Straty energii w dielektryku związane są z różnymi procesami

Aby je wyrazić liczbowo wprowadzono zespoloną postać przenikalności elektrycznej

$$\varepsilon = \varepsilon' - j\varepsilon''$$

Czasowa zależność przenikalności może być opisana następującym modelem

$$\varepsilon = \varepsilon_{\infty} + \int_0^{\infty} \beta(t) \exp(j\omega t) dt$$

ε_{∞} - przenikalność elektryczna przy wysokich częstotliwościach pola

$\beta(t)$ - współczynnik zaniku, określający opóźnienie zmian polaryzacji względem zmian pola elektrycznego

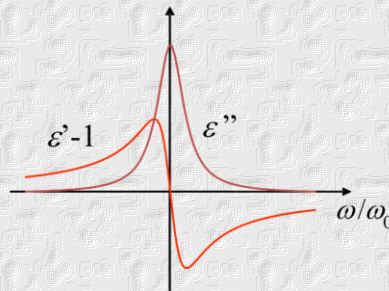
- Debye zaproponował wykładniczą formę współczynnika zaniku

$$\beta(t) = \beta(0) \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

τ - czas relaksacji

12

- przesunięcie przez pole elektryczne ładunków przeciwnych znaków, związanych ze sobą sprężystości, wywołuje polaryzację ośrodka,
- po usunięciu pola ładunki wracają do położenia równowagi wykonując drgania, które zanikają z szybkością określoną tłumieniem,
- gdy polaryzację deformacyjną wywołuje pole przemienne układ złożony z oscylatorów może przy pewnej charakterystycznej częstotliwości ω_0 absorbować energię
- jest to zjawisko analogiczne do rezonansu w obwodzie RLC



13

Model Debye'a

- polaryzacja dipolowa P_d jest w takim ujęciu przesunięta w fazie w stosunku do pola E

$$P_d(\omega) = \frac{\epsilon_s - \epsilon_\infty}{1 + j\omega\tau_D} \epsilon_0 E$$

ϵ_∞ - przenikalność elektryczna przy wysokich częstotliwościach pola E

ϵ_s - przenikalność elektryczna przy stałej wartości pola E

- polaryzacja przy wysokich częstotliwościach pola

$$P_\infty = (\epsilon_\infty - 1) \epsilon_0 E$$

- całkowita polaryzacja $P = P_\infty + P_d$

$$P(\omega) = P' - jP'' = (\epsilon_\infty - 1) \epsilon_0 E + \frac{\epsilon_s - \epsilon_\infty}{1 + j\omega\tau_D} \epsilon_0 E$$

14

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon' - j\varepsilon'' = 1 + \frac{P' - jP''}{\varepsilon_0 E} = \varepsilon_\infty + \frac{\varepsilon_s - \varepsilon_\infty}{1 + j\omega\tau_D}$$

$$\varepsilon(\omega) = \underbrace{\varepsilon_\infty + \frac{\varepsilon_s - \varepsilon_\infty}{1 + \omega^2\tau_D^2}}_{\substack{\text{dyspersja} \\ \varepsilon'}} - j \underbrace{\frac{(\varepsilon_s - \varepsilon_\infty)\omega\tau_D}{1 + \omega^2\tau_D^2}}_{\substack{\text{absorpcja} \\ \varepsilon''}}$$

- tangens kąta strat:

$$\operatorname{tg} \delta \equiv \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'} = \frac{\varepsilon_s - \varepsilon_\infty}{\varepsilon_s + \varepsilon_\infty} \frac{\omega\tau_D}{1 + \omega^2\tau_D^2}$$

15

Wytrzymałość elektryczna dielektryków

Jeśli pole elektryczne w dielektryku przekroczy pewną wartość krytyczną następuje tzw. przebicie elektryczne czyli nagły przepływ prądu

Wartość krytycznego pola elektrycznego nazywana jest odpornością na przebicie.

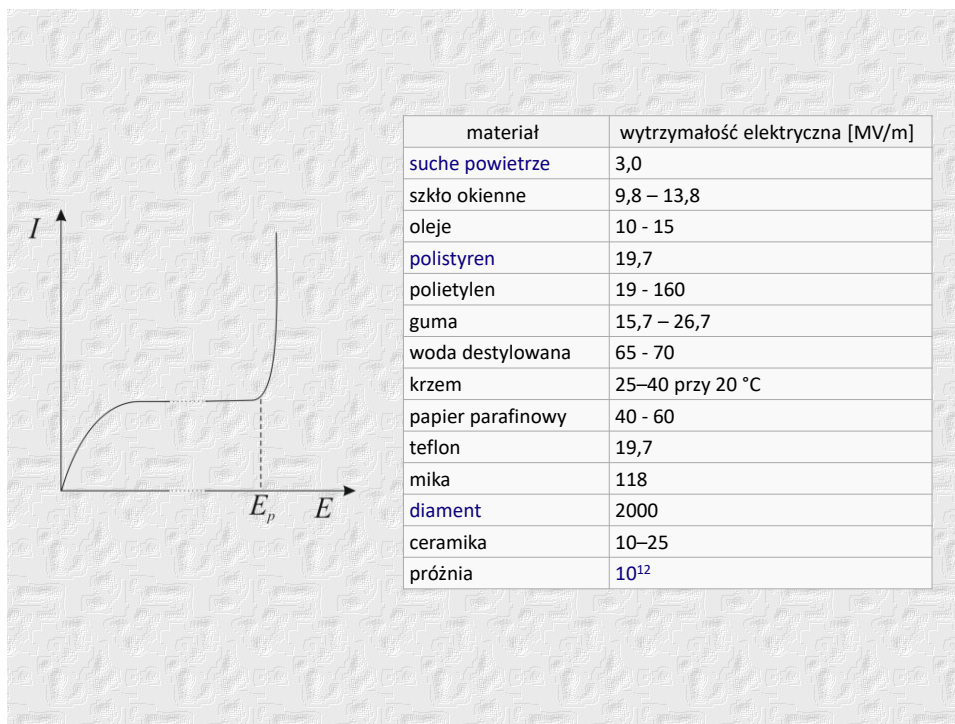
Parametr ten nie jest związany z innymi parametrami elektrycznymi dielektryka.

Jego wartość zależy od czystości, koncentracji defektów, ciśnienia, temperatury, wilgotności, geometrii dielektryka, rodzaju napięcia, kształtu elektrod i in.

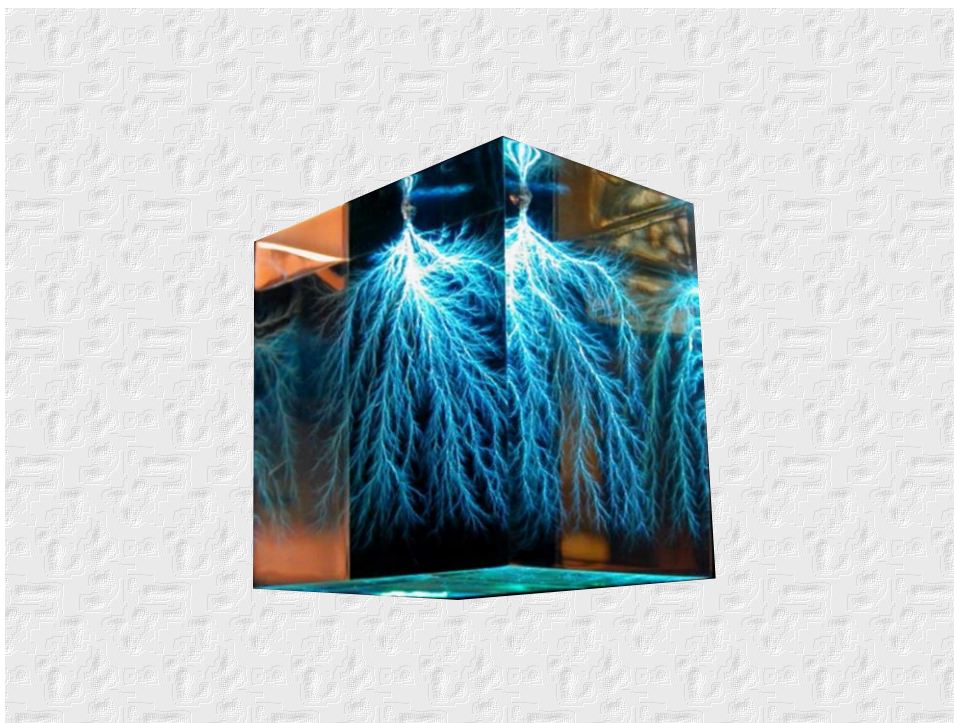
Istnieją cztery podstawowe mechanizmy przebicia:

- **termiczny** (ciepło => defekty => przewodnictwo => wzrost wydzielania ciepła...)
- **lawinowy** (przyspieszane nośniki => generacja nowych nośników => przyspieszane...)
- **wyładowczy** (łuk elektryczny w porach => erozja porów => powiększanie się łuku...)
- **elektrolityczny** (ścieżki przewodzenia utworzone na skutek przewodnictwa jonowego)

16



17

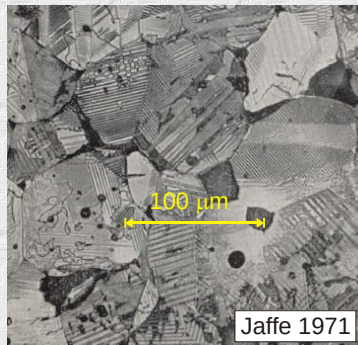


18

Dielektryki o własnościach specjalnych

19

Ferroelektryki (Seignetto-elektryki) charakteryzują się strukturą domenową, tj. posiadają obszary gdzie elementarne momenty dipolowe są ustawione zgodnie. Dlatego poniżej pewnej temperatury (tzw. temperatury Curie), gdy ruchy termiczne nie burzą tego uporządkowania, zachowują się one podobnie jak ferromagnetyki. Zjawisko to wykryto po raz pierwszy w soli Seignetta. Najbardziej rozpowszechnionym obecnie ferroelektrykiem jest BaTiO_3 .



Dla tytanianu baru ferroelektryczność zanika powyżej temperatury $T=485\text{ K}$, a $C=1,8 \cdot 10^5\text{ K}$. Ferroelektryki charakteryzują się bardzo dużą przenikalnością elektryczną nawet rzędu 10^4 .

20

Związek pomiędzy polaryzacją i natężeniem pola elektrycznego w ferroelektrykach ma postać:

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_0 + \chi \mathbf{E}$$

$\mathbf{P}_0$ - stały wektor polaryzacji spontanicznej

χ - podatność elektryczna

$\mathbf{E}$ - natężenie zewnętrznego pola elektrycznego

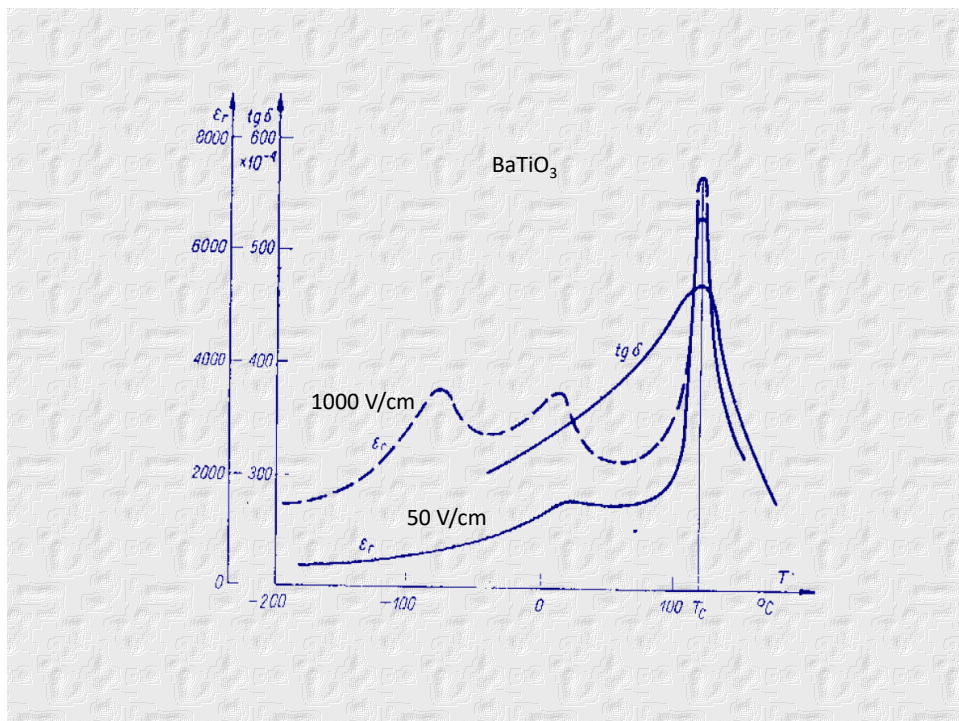
Zależność przenikalności elektrycznej od temperatury dla ferroelektryka:

$$\varepsilon - 1 = \frac{C}{T - T_C}$$

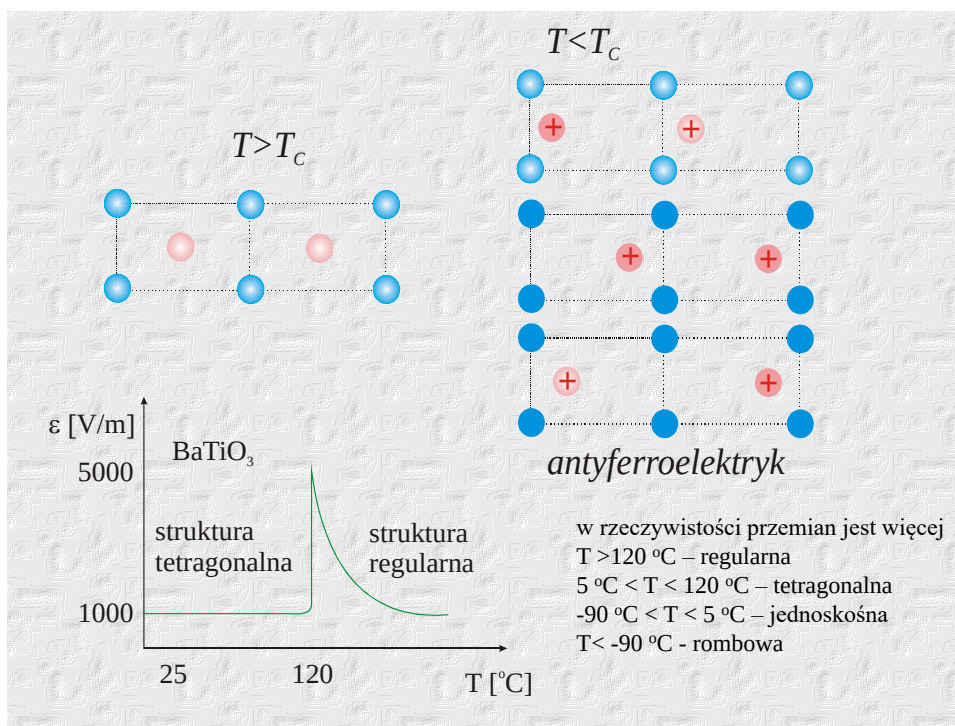
Zależność ta nosi nazwę prawa Curie-Weissa.

Od temperatury zależy też $\text{tg} \delta$ – najsilniejsza zależność występuje w pobliżu temperatury Curie

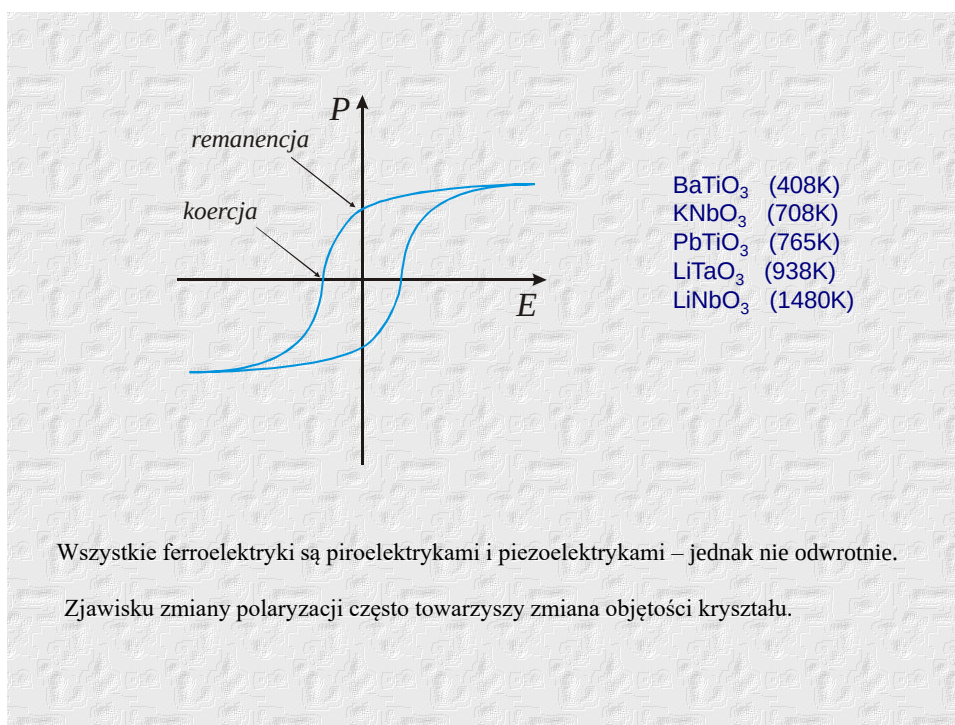
21



22



23

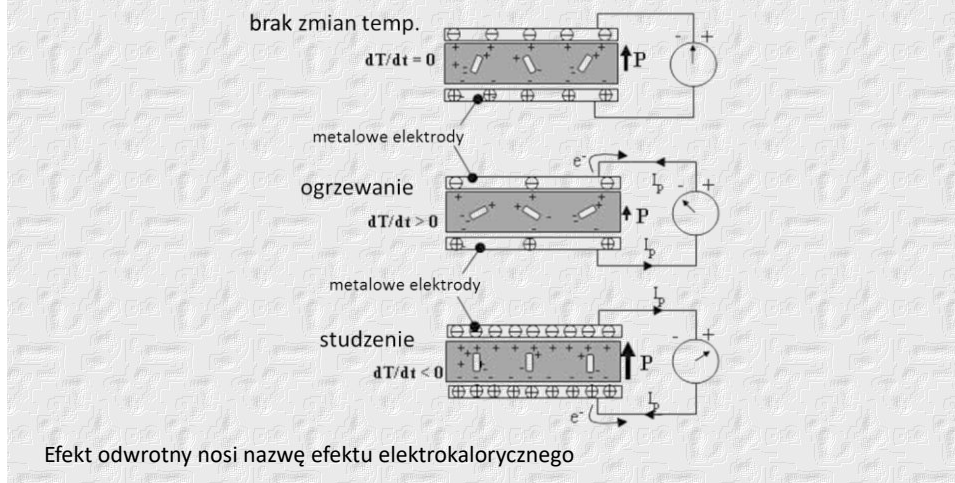


24

Efekt piroelektryczny polega na powstawaniu ładunków elektrycznych na powierzchni kryształów dielektrycznych pod wpływem zmiany ich temperatury. Gdy podczas ogrzewania jeden koniec próbki piroelektryka staje się dodatni, a drugi ujemny, to przy ochładzaniu zajdzie zjawisko odwrotne.

Zjawisko piroelektryczne zostało odkryte w 1756 roku przez Aepinusa.

Wartość ładunku piroelektrycznego zależy od szybkości zmian temperatury i zwykle wynosi ok. $10^{-15} \text{ C/cm}^2/^{\circ}\text{C}$).



25

Piroelektryk jest ferroelektrykiem o bardzo wysokiej temperaturze Curie - nie obserwuje się go w stanie paraelektrycznym (niespolaryzowanym) do zmiany jego polaryzacji niezbędne jest bardzo silne pole elektryczne lub wysoka temperatura.

Przy szybkiej zmianie temperatury kryształu o ΔT , jego spontaniczna polaryzacja zmienia się o wartość ΔP , a na powierzchni pojawia się dodatkowy ładunek o gęstości powierzchniowej:

$$\rho_p = p\Delta T = \Delta P$$

p - współczynnik piroelektryczny

Zastosowania: czujniki termiczne, czujniki ruchu, matryce termowizyjne

Materiał, który ma być wykorzystany jako detektor w temperaturze pokojowej, powinien się charakteryzować temperaturą Curie nieznacznie wyższą od pokojowej.

Bardzo istotną cechą charakterystyczną, odróżniającą detektory piroelektryczne od klasycznych detektorów termicznych (np. termoelektrycznych) jest bardzo krótki czas reakcji rzędu mikro- a nawet nanosekund

Detektory piroelektryczne mogą być budowane zarówno z monokryształów jak i polikrystalicznych materiałów piroelektrycznych

Najbardziej rozpowszechnione są monokryształy trójkwadratowe w postaci tiosiarczanów lub chromianów: $(\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COOH})_3\text{H}_2\text{SO}_4$ - (TGS), $(\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COOH})_3\text{H}_2\text{CrO}_4$ - (TGC).

26

Elektrostrykcja jest efektem polegającym na zmianie rozmiarów kryształu pod wpływem pola elektrycznego (elektryczny odpowiednik magnetostrykcji).

Odwrocenie kierunku pola nie skutkuje odwróceniem deformacji. Bez względu na kierunek pola kryształ powiększa lub pomniejsza swoją objętość.

Odwrocenie charakteru deformacji można jednak uzyskać poprzez wstępną polaryzację taki materiał nazywa się wtedy pseudo-piezoelektrykiem

Zmiana rozmiarów jest spowodowana reorientacją domen i jest zwykle niewielka. Przy 2 MV/m można osiągnąć liniową zmianę rozmiarów rzędu 0,1% dla specjalnych materiałów ceramicznych.

Efekt do ok. 0,3 MV/m jest proporcjonalny do E^2 , a powyżej tej wartości do E

Do najbardziej znanych materiałów elektrostrykcyjnych należą ceramiki:

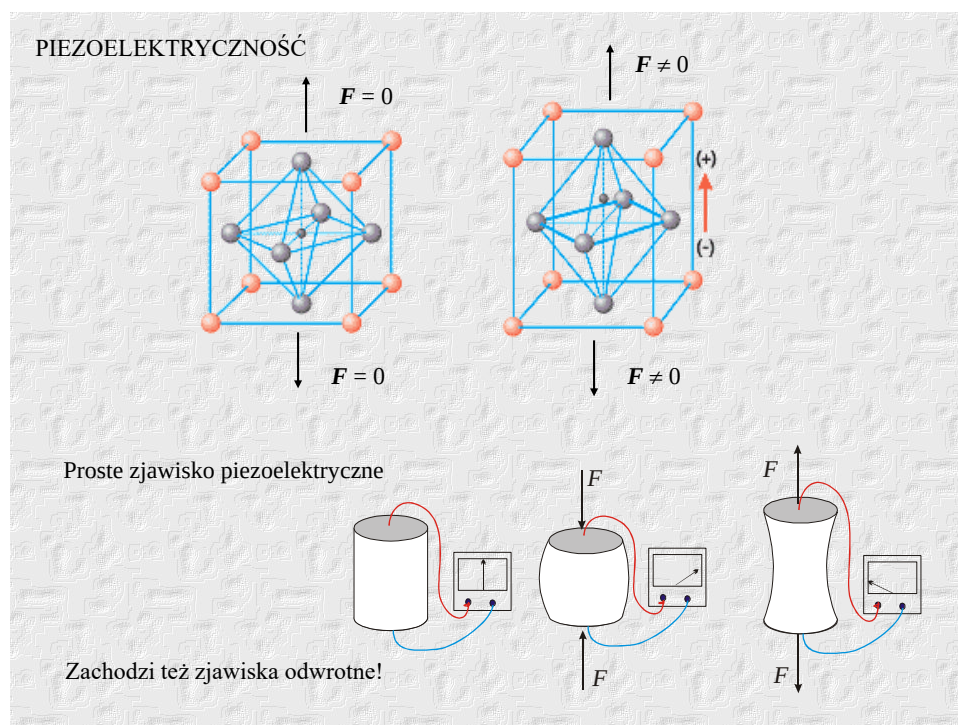
niobian ołowiowo magnezowy PMN

niobian ołowiowo magnezowy-tytaniań ołowi PMN-PT

tytaniań ołowiowo lantanowo-cyrkonowy PLZT

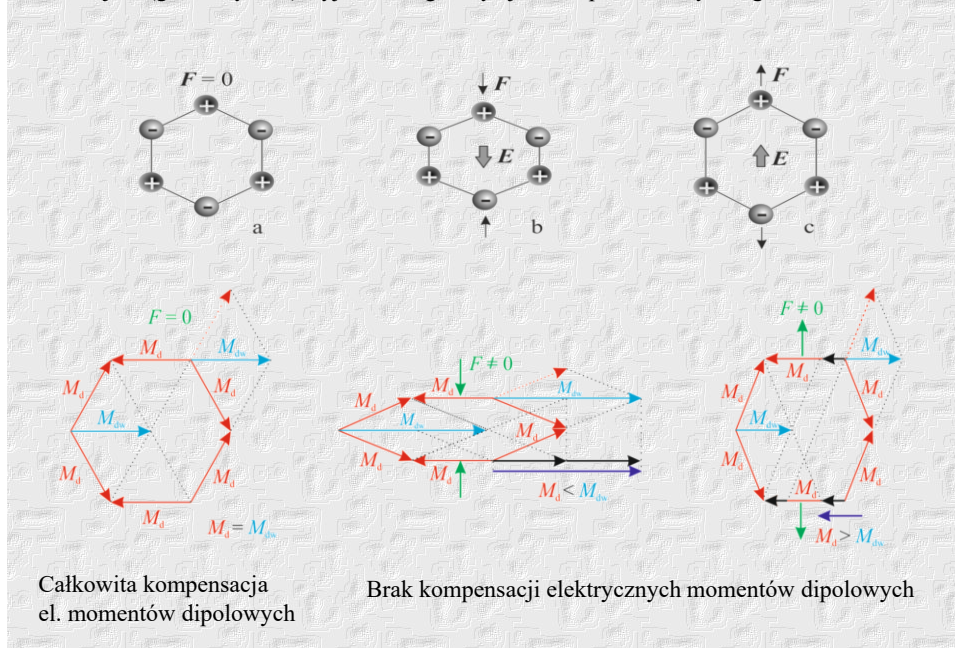
Efekt ten jest słaby i przez to jak dotąd stosunkowo rzadko wykorzystywany

27



28

Ścisłejsze (geometryczne) wyjaśnienie genezy zjawiska piezoelektrycznego



29

Ilościowo piezoelektryczność opisuje się układem tensorowych równań sprzężonych, łączących ze sobą wielkości mechaniczne i elektryczne:

$$S_{ij} = s_{ijkl} T_{kl} + d_{kij} E_k,$$

$$D_i = d_{ijk} T_{jk} + \varepsilon_{ij} E_j,$$

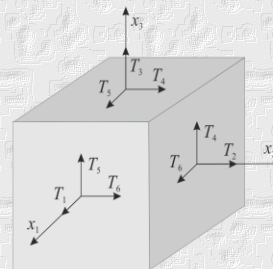
Korzystając z symetrii naprężeń: $T_{ij} = T_{ji}$

i stosując specjalne oznaczenia indeksów (notacja Voigta):
 $11 \rightarrow 1, 22 \rightarrow 2, 33 \rightarrow 3, 23, 32 \rightarrow 4, 13, 31 \rightarrow 5, 12, 21 \rightarrow 6$
 można zapisać deformacje i naprężenia jako wektory i zapisać układ równań tensorowych formie macierzowej:

$$\{S\} = [s^E] \{T\} + [d^T] \{E\},$$

$$\{D\} = [d] \{T\} + [\varepsilon^T] \{E\},$$

w której $[s^E]$ jest macierzą podatności mechanicznej przy stałym lub zerowym natężeniu pola elektrycznego, $[d^T]$ macierzą współczynników piezoelektryczności odwrotnej (indeks t oznacza transpozycję macierzy współczynników piezoelektryczności prostej $[d]$), zaś $[\varepsilon^T]$ macierzą przenikalności elektrycznej przy stałym lub zerowym naprężeniu



30

W formie rozwiniętej

$$\begin{bmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ S_4 \\ S_5 \\ S_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{11}^E & s_{12}^E & s_{13}^E & s_{14}^E & s_{15}^E & s_{16}^E \\ s_{21}^E & s_{22}^E & s_{23}^E & s_{24}^E & s_{25}^E & s_{26}^E \\ s_{31}^E & s_{32}^E & s_{33}^E & s_{34}^E & s_{35}^E & s_{36}^E \\ s_{41}^E & s_{42}^E & s_{43}^E & s_{44}^E & s_{45}^E & s_{46}^E \\ s_{51}^E & s_{52}^E & s_{53}^E & s_{54}^E & s_{55}^E & s_{56}^E \\ s_{61}^E & s_{62}^E & s_{63}^E & s_{64}^E & s_{65}^E & s_{66}^E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \\ T_6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_{11} & d_{21} & d_{13} \\ d_{12} & d_{22} & d_{32} \\ d_{13} & d_{23} & d_{33} \\ d_{14} & d_{24} & d_{34} \\ d_{15} & d_{25} & d_{35} \\ d_{16} & d_{26} & d_{36} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} D_1 \\ D_2 \\ D_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} & d_{14} & d_{15} & d_{16} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} & d_{24} & d_{25} & d_{26} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & d_{34} & d_{35} & d_{36} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \\ T_6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_2 \end{bmatrix}$$

31

SiO₂

$\rho=2651 \text{ kg/m}^3$

$$s_{ij}^E = 10^{-12} \cdot \begin{bmatrix} 12,77 & -1,79 & -1,22 & -4,5 & 0 & 0 \\ -1,79 & 12,77 & -1,22 & 4,5 & 0 & 0 \\ -1,22 & -1,22 & 9,6 & 0 & 0 & 0 \\ -4,5 & 4,5 & 0 & 20,04 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 20,04 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -9 & 29,12 \end{bmatrix} [\text{m}^2/\text{N}]$$

$$d_{ij} = 10^{-12} \cdot \begin{bmatrix} -2,3 & 0 & 0 \\ 2,3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -0,67 & 0 & 0 \\ 0 & 0,67 & 0 \\ 0 & 4,6 & 0 \end{bmatrix} [\text{C/N}]$$

$$\frac{\varepsilon_{ij}}{\varepsilon_0} = \begin{bmatrix} 4,52 & 0 & 0 \\ 0 & 4,52 & 0 \\ 0 & 0 & 4,68 \end{bmatrix}$$

32

BaTiO₃
 $\rho = 6020 \text{ kg/m}^3$

$$s_{ij}^E = 10^{-12} \cdot \begin{bmatrix} 8,05 & -2,35 & -5,24 & -1,02 & 0 & 0 \\ -2,35 & 8,05 & -5,24 & 1,02 & 0 & 0 \\ -5,24 & -5,24 & 15,7 & 0 & 0 & 0 \\ -1,02 & 1,02 & 0 & 18,4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 18,4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 8,84 \end{bmatrix} [\text{m}^2/\text{N}]$$

$$d_{ij} = 10^{-12} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & -34,5 \\ 0 & 0 & -34,5 \\ 0 & 0 & 85,6 \\ 0 & 392 & 0 \\ 392 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} [\text{C/N}]$$

$$\frac{\epsilon_{ij}}{\epsilon_0} = \begin{bmatrix} 2920 & 0 & 0 \\ 0 & 2920 & 0 \\ 0 & 0 & 168 \end{bmatrix}$$

33

Do opisu własności piezoelektrycznych materiałów używa się, obok modułów d , zwanych też modułami odkształceniowymi także ich odwrotności h oraz stałych napięciowych g i ich odwrotności e .

$$d_{ij} = \left(\frac{\partial D_i}{\partial T_j} \right)^E = \left(\frac{\partial S_j}{\partial E_i} \right)^T \left[\frac{\text{C}}{\text{N}} \right], \left[\frac{\text{m}}{\text{V}} \right]$$

$$h_{ij} = - \left(\frac{\partial E_i}{\partial S_j} \right)^D = - \left(\frac{\partial T_j}{\partial D_i} \right)^S \left[\frac{\text{N}}{\text{C}} \right], \left[\frac{\text{V}}{\text{m}} \right]$$

$$e_{ij} = \left(\frac{\partial D_i}{\partial S_j} \right)^E = - \left(\frac{\partial T_j}{\partial E_i} \right)^S \left[\frac{\text{Vm}}{\text{N}} \right], \left[\frac{\text{C}}{\text{m}^2} \right]$$

$$g_{ij} = - \left(\frac{\partial E_i}{\partial T_j} \right)^D = - \left(\frac{\partial S_j}{\partial D_i} \right)^T \left[\frac{\text{N}}{\text{Vm}} \right], \left[\frac{\text{m}^2}{\text{C}} \right]$$

34

układ równań dla sprzężenia elektromechanicznego może mieć kilka równoważnych form

$$\{E\} = [\beta^T] \{D\} - [g] \{T\},$$

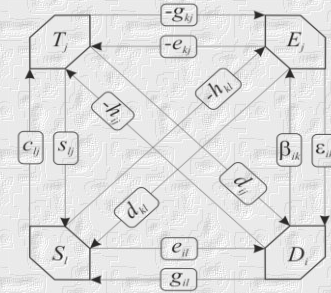
$$\{S\} = [s^D] \{T\} + [g^t] \{D\},$$

$$\{D\} = [\epsilon^S] \{E\} + [e] \{S\},$$

$$\{T\} = [c^E] \{S\} + [e^t] \{E\},$$

$$\{E\} = [\beta^S] \{D\} - [h] \{S\},$$

$$\{T\} = [c^D] \{S\} - [h^t] \{D\},$$



indeks górny t oznacza transpozycję, c^D są odwrotnościami s^D , β^S odwrotnościami ϵ^S

35

Efekty piezoelektryczne prosty i odwrotny są ze sobą ściśle powiązane.

Obserwacja efektu nie daje możliwości rozróżnienia przyczyny od skutku

Powiązanie to sprawia, że z praktycznego punktu widzenia przydatna okazuje się jeszcze jedna wielkość opisująca własności piezoelektryka nazywana współczynnikiem sprzężenia elektromechanicznego k

$$k = \sqrt{\frac{E_e}{E_m}}$$

E_e energia elektryczna zmagazynowana w piezoelektryku

E_m energia mechaniczna zmagazynowana w piezoelektryku

W katalogach zamiast k często podawane jest k^2 .

W przypadku anizotropii w każdym kierunku będzie inaczej

$$k_{31} = \frac{d_{31}}{\sqrt{s_{33}^T s_{11}^E}} \quad \text{wszystkie naprężenia zerowe oprócz } T_1$$

$$k_{33} = \frac{d_{33}}{\sqrt{s_{33}^T s_{33}^E}} \quad \text{wszystkie naprężenia zerowe oprócz } T_3$$

$$k_{33} = \frac{e_{33}}{\sqrt{s_{33}^S s_{33}^D}} \quad \text{wszystkie deformacje zerowe oprócz } S_3$$

	k_{33} [%]
SiO ₂	10
LiNbO ₃	17
BaTiO ₃	52
PZT	60

36

Często w zastosowaniach technicznych pole elektryczne, odkształcenie bądź naprężenie mają tylko jedną składową różną od zera i wtedy równania sprzężeniowe przechodzą w proste związki skalarne

Efekt piezoelektryczny podłużny - wektory S i E mają zgodne kierunki i zwroty
Dla przykładu w kierunku x_3

$$d_{33} = \frac{S_3}{E_3} = \frac{D_3}{T_3}$$

Efekt piezoelektryczny poprzeczny - wektory S i E są do siebie prostopadłe
W kierunkach x_1 oraz x_3 :

$$d_{31} = \frac{S_1}{E_3} = \frac{D_3}{T_1}$$

Efekt piezoelektryczny skośny – wektor E jest prostopadły do płaszczyzny ścinania
Przykładowo dla sił ścinających działających wzdłuż płaszczyzny równoległej do x_1 , x_2 lub x_2 , x_3 i pola elektrycznego w kierunku x_1 otrzyma się:

$$d_{15} = \frac{S_5}{E_1} = \frac{D_1}{T_5}$$

37

Wszystkie podane zależności zakładają niezmienność temperatury
Współczynniki podawane są dla 20 °C

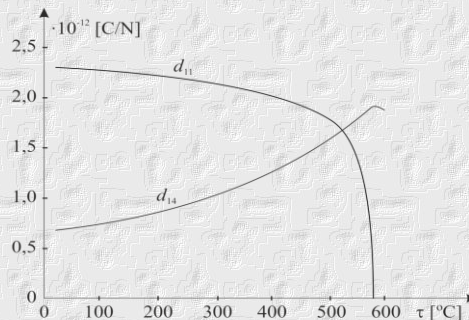
Temperaturowy współczynnik d_{ij} definiuje się następująco:

$$\text{TW}d_{ik} = \frac{1}{d_{ik}} \frac{\partial d_{ik}}{\partial \tau}$$

Dla kwarcu

$$\text{TW}d_{11} = -2,15 \cdot 10^{-4} [\text{K}^{-1}] \quad \text{TW}d_{14} = 12,9 \cdot 10^{-4} [\text{K}^{-1}]$$

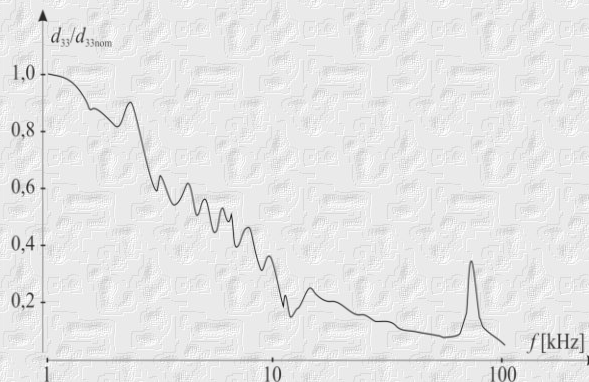
Wartości współczynników temperaturowych nie są wysokie, a ich liniowe przybliżenie może być stosowane z dala od temperatury Curie (dla kwarcu poniżej ok. 400 °C).



38

Wartości modułów maleją z częstotliwością

częstotliwościowa degradacja współczynnika d_{33} w PZT



Degradacja procesem dość złożonym.

Na krzywą spadku nakładają się liczne rezonanse elektromechaniczne związane z ziarnistą strukturą materiału.

Najwolniejszy spadek wartości współczynników piezoelektrycznych obserwowany jest w monokryształach

39

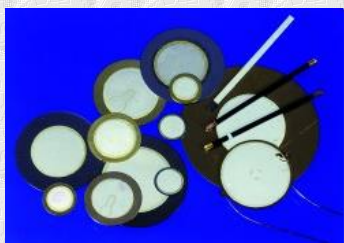
Piezoelektryki są szeroko wykorzystywane do budowy:

- układów akustoelektronicznych
- przetworników akustycznych
- układów zapłonowych
- iskrowników
- siłowników (serwomechanizmów)
- i in.

materiał	cięcie	wsp. sprzężenia [%]	ϵ_r
SiO ₂	ST (42,75° Y)	0,16	4,5
SiO ₂	- 75° Y	0,11	4,5
LiNbO ₃	Y	4,82	36,7
LiNbO ₃	128° Y	5,56	39,1
LiTaO ₃	X	0,64	44
Li ₂ B ₄ O ₇	145° X	1,0	9,6
ZnO na szkle	-	1,4	10,8
ZnO na szafirze	-	3,4	10
Pb(Sn _{1/2} Sb _{1/2})O ₃ +PbTiO ₃ +PbZrO ₃	-	2,4	270
0,1Pb(Mn _{1/3} Nb _{2/3})O ₃ +0,9Pb(Zr _{0,74} Ti _{0,26})O ₃	-	2,9	460

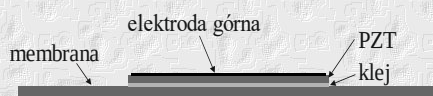
40

Materiały piezoceramiczne mogą być dowolnie kształtowane



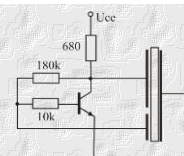
41

membrany metalowe sztywno połączone z piezoelektrykiem
zalicza się do unimorfów



stosuje się ceramikę PZT rzadziej warstwę kwarcu lub BaTiO_3 .

górne elektrody są napyłane stopem srebra rzadziej jest to glin



$$\alpha = 0,412$$



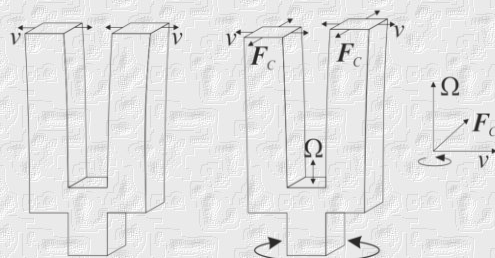
$$\alpha = 0,233$$



$$\alpha = 0,172$$

42

żyroskopy piezoelektryczne



$$F_C = m a_C = -2m \Omega \times v$$

wektor prędkości liniowej końcówek widetek cyklicznie zmienia zwrot

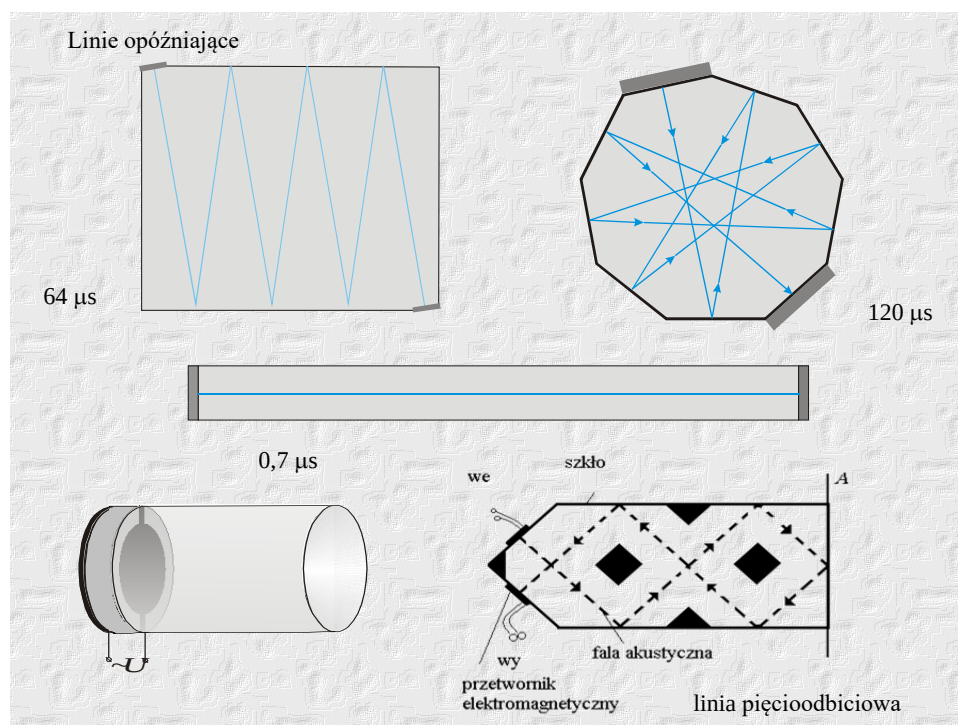
generowana siła Coriolisa także zmienia zwrot

w efekcie generowane są drgania w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu drgającego

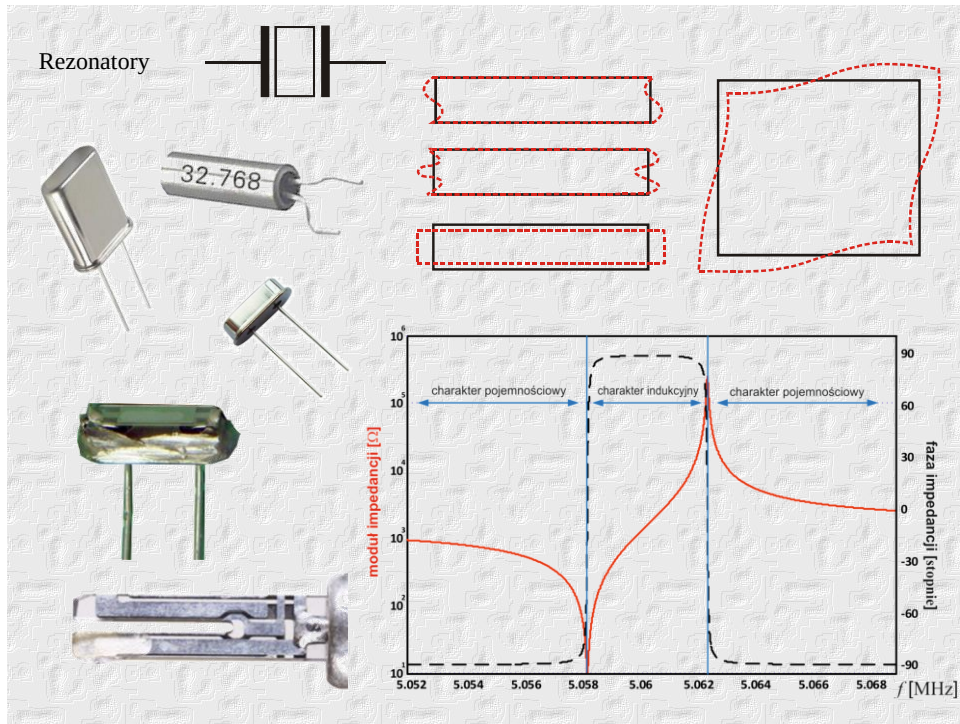
amplituda tych drgań jest proporcjonalna do prędkości ruchu obrotowego widetek

drgania w obydwu płaszczyznach separuje się częstotliwościowo odpowiednio dobierając przekrój widetek

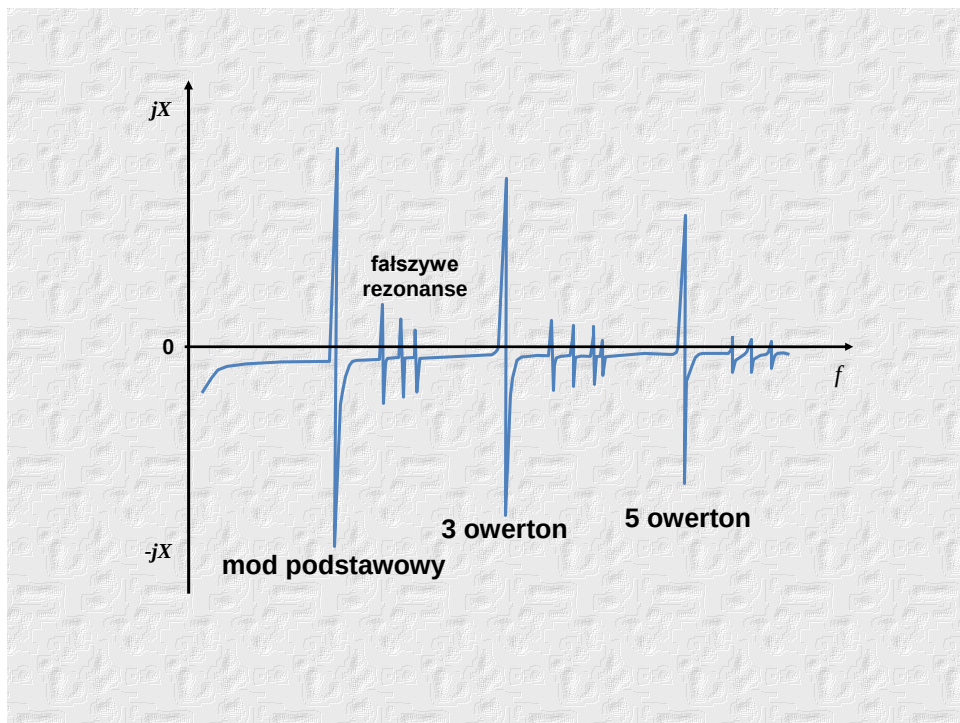
43



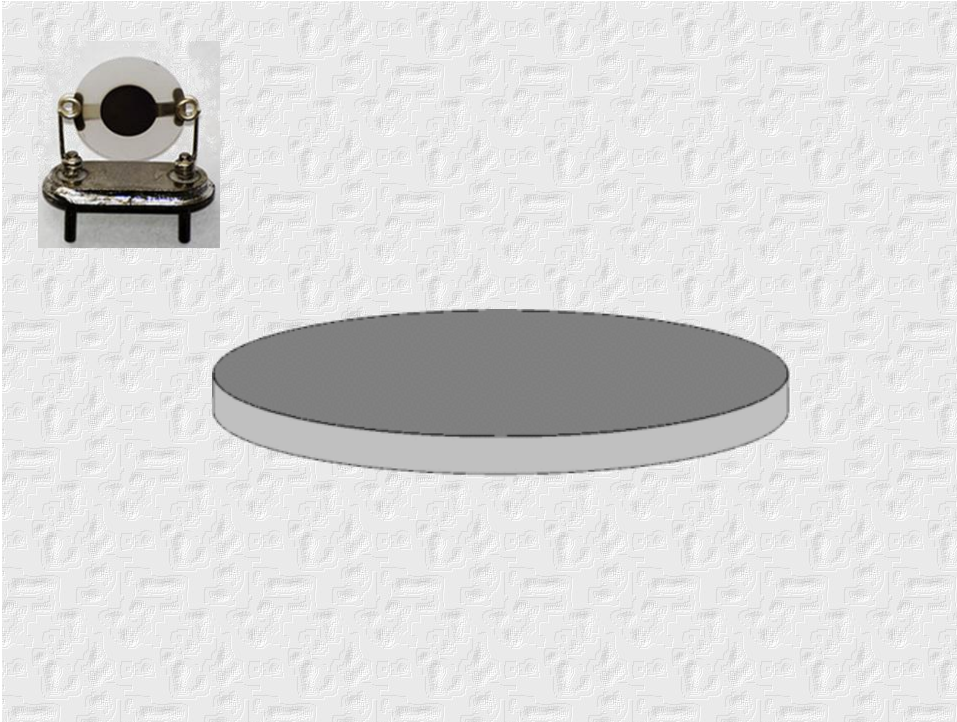
44



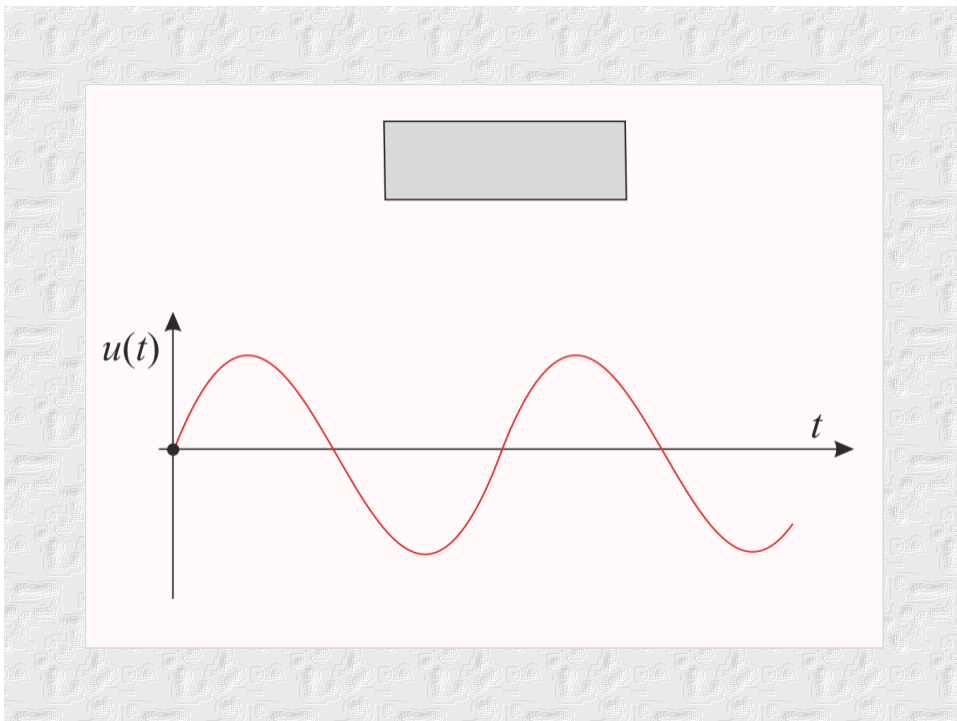
45



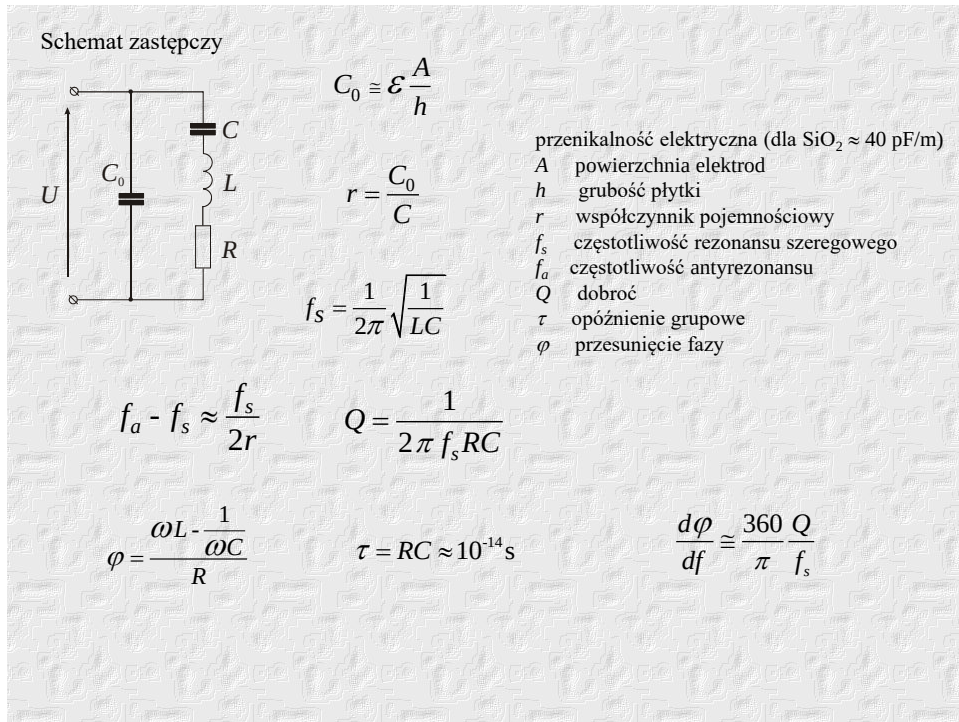
46



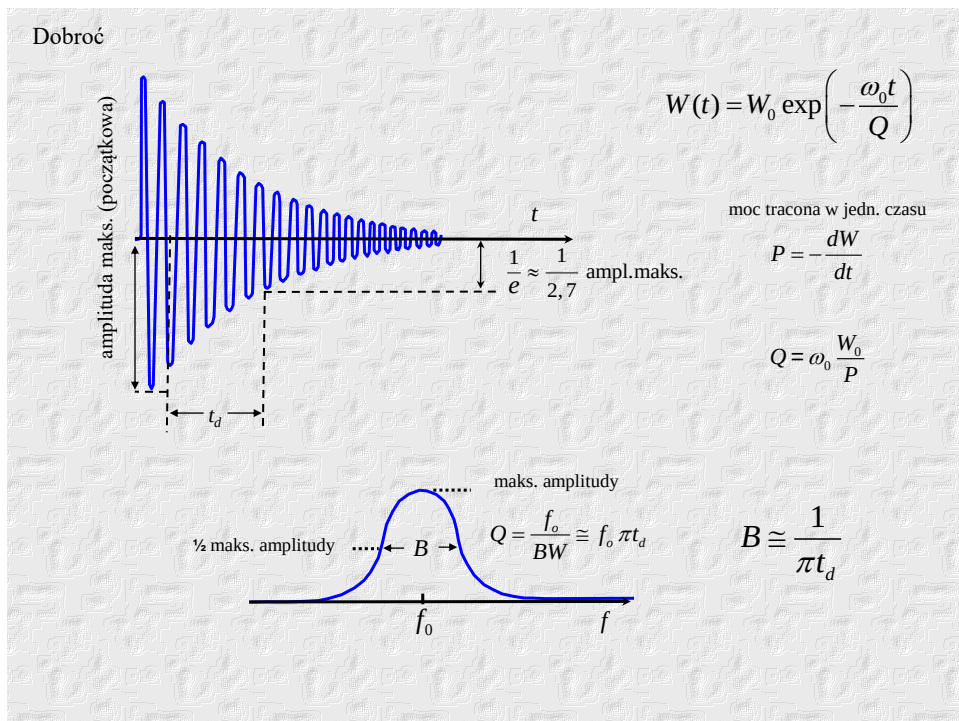
47



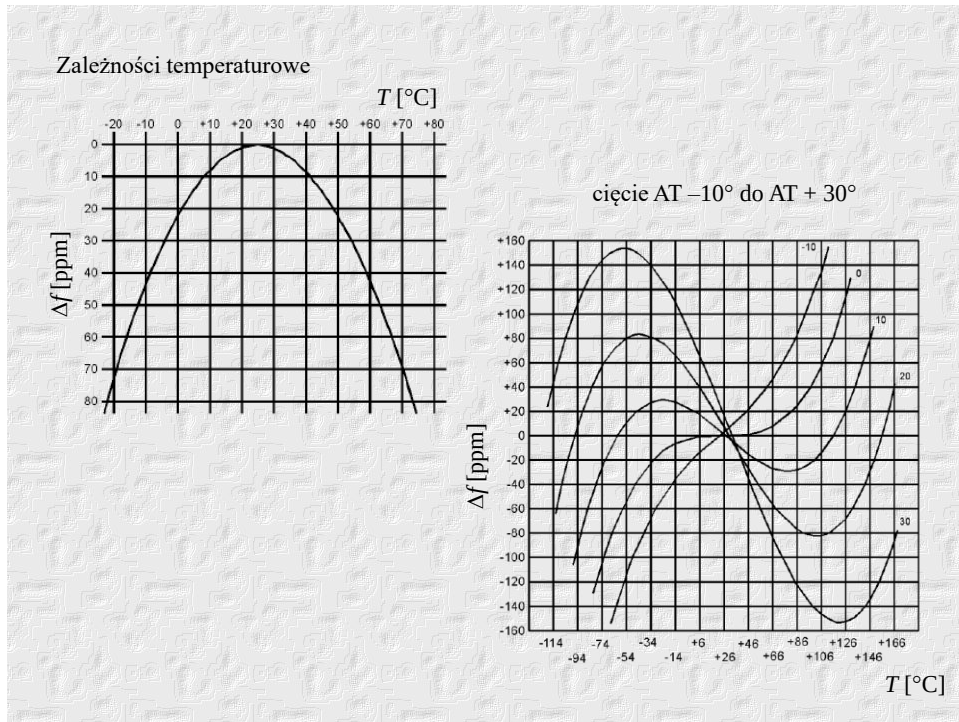
48



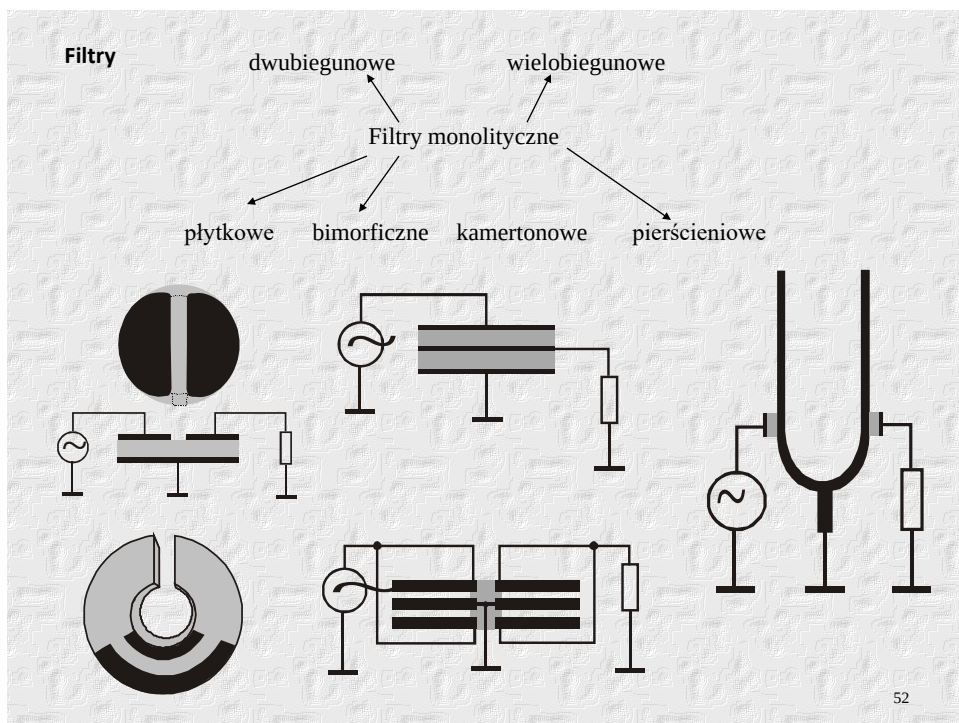
49



50

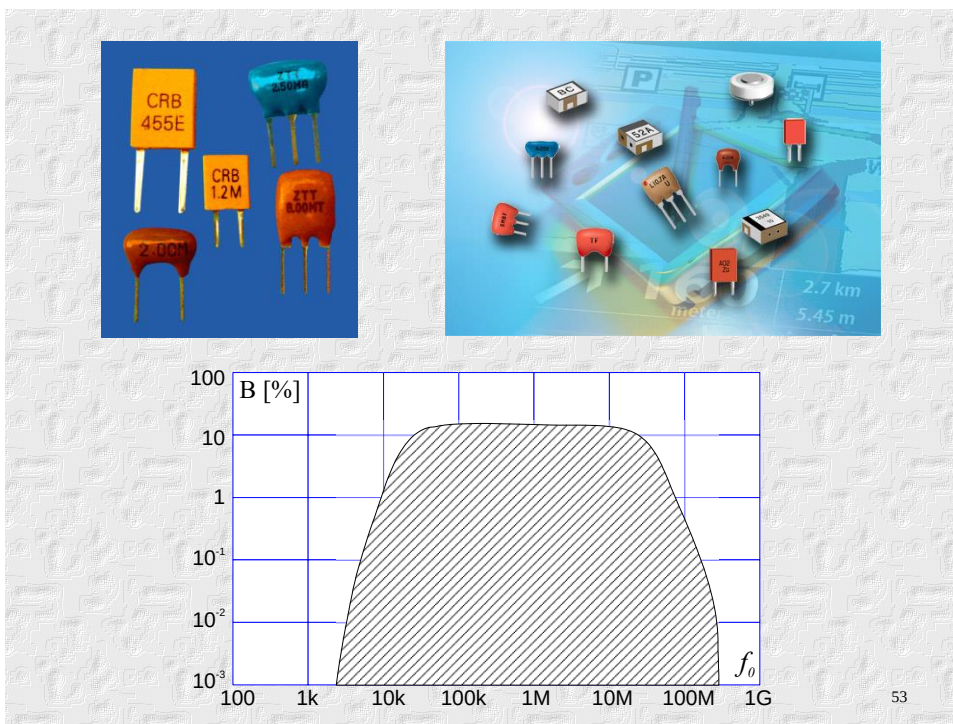


51

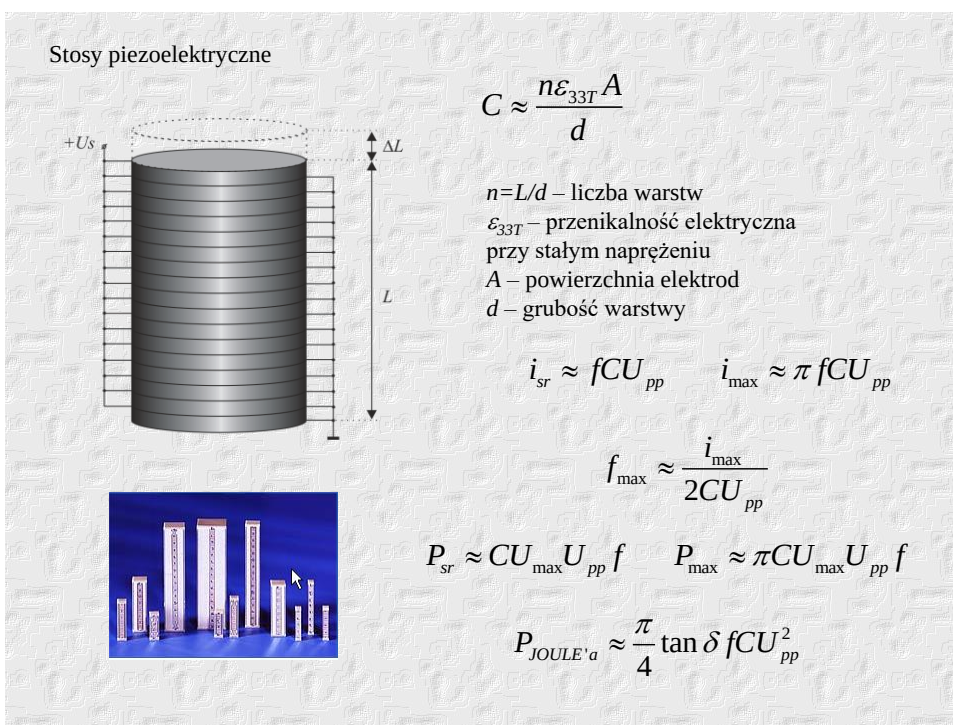


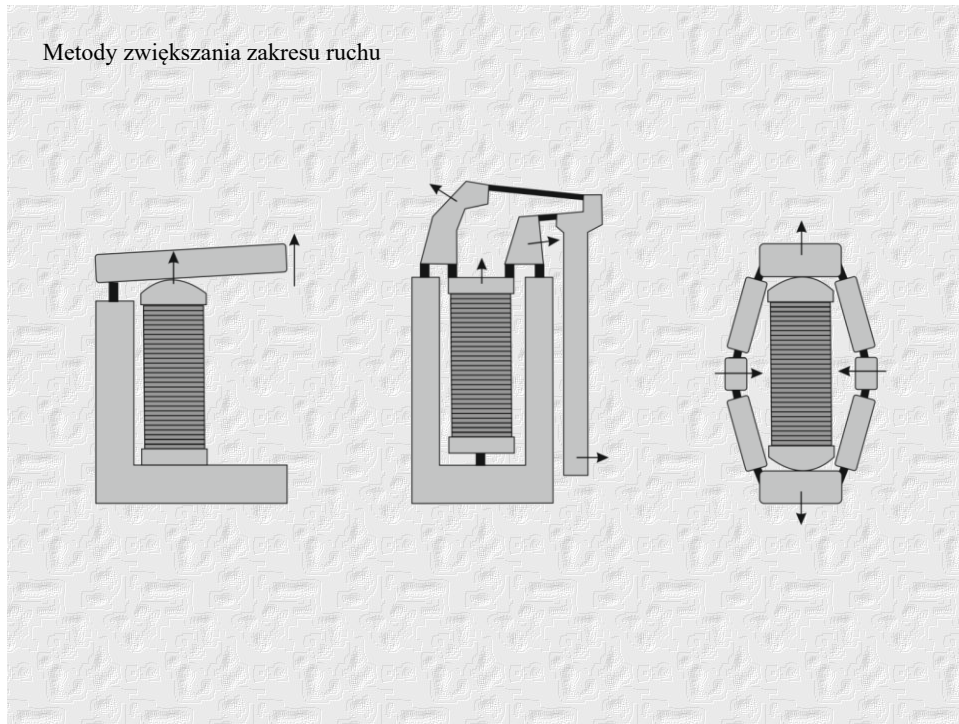
52

52



53





55

Bimorfy

Przemieszczenie końcówki bimorfu opisuje zależność $\Delta L \approx \frac{3}{4} \left(\frac{l}{g} \right)^2 d_{31} E$

l – długość bimorfu, g – grubość jednego piezoelektryka, d_{31} – składową tensora podatności piezoelektrycznej (modułem piezoelektrycznym), E amplitudą pola elektrycznego

Generowana siła

$$F = \frac{2ga}{l} \frac{d_{31}}{\epsilon_{11}^E} E$$

a – szerokość bimorfu

częstotliwość rezonansowa $f_0 \approx 0,161 \frac{2g}{l^2} \sqrt{\frac{1}{\rho \epsilon_{11}^E}}$

56

Moc – Energy harvesting

Liczba ładunków na jednostkę powierzchni:

$$D_3 = \epsilon \epsilon_0 E_3 + Y d_{31} S_1$$

Po scałkowaniu po grubości (S_1 , D_3 i $d_{31} = \text{const}$) otrzymamy:

$$D_3 h = \epsilon \epsilon_0 U + Y d_{31} S_1 h$$

Zakładając, że D_3 , V , S są jednakowo zmienne oraz $\epsilon \epsilon_0 \approx \epsilon$ prąd wyniesie

$$-i = j\omega A \left(\epsilon \frac{U}{h} + Y d_{31} S_1 \right)$$

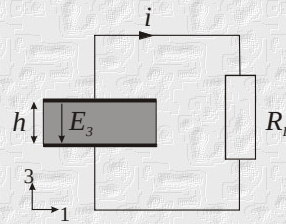
Z prawa Ohma:

$$U = \frac{-Y d_{31} A S_1 j\omega}{\frac{1}{R} - j\omega C} \quad C = \frac{\epsilon A}{h}$$

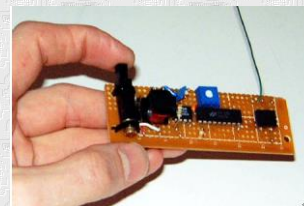
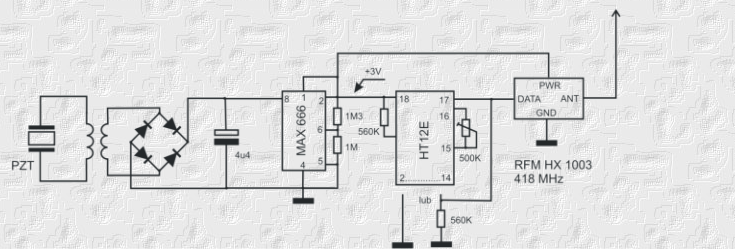
Z tego:

$$|U| = \frac{Y d_{31} A S_1 \omega R}{\sqrt{1 + \omega^2 C^2 R^2}} \quad P_p = \frac{|U|^2}{R} = \frac{(Y d_{31} A S_1 \omega)^2 R}{1 + \omega^2 C^2 R^2}$$

~ pojedyncze mW



57



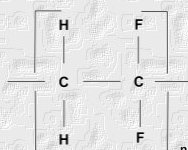
58

Polifluorek winylidenu (PVDF - Polyvinylidene fluoride)

polimer fluorowy o wysokim stopniu krystalizacji
 należy do grupy ciągliwie-sprężystych, termoplastycznych tworzyw fluorowych
 biały lub czarny (z 8% dodatkiem włókien węglowych lub sadzy przewodzi prąd)

należy no najlepszych piezoelektryków polimerowych

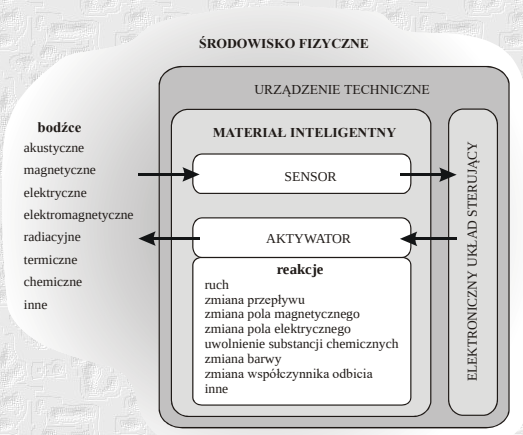
dobre własności cieplne i elektryczne
 wysoka wytrzymałość mechaniczna - wytrzymałość na ściskanie
 wysoka dopuszczalna temperatura pracy (150°C)
 zwiększona odporność na ścieranie
 wysoka odporność chemiczna
 obojętność fizjologiczna
 niska palność
 wyjątkowa odporność na działanie UV oraz czynników atmosferycznych
 dobra skrawalność oraz sprężystość zwrotna



59

Materiały inteligentne (ang. smart materials)

Są to struktury łączące własności czujnika i aktywatora



60

Zjawiska sprzężone

odpowiedź w postaci zmiany	wymuszenie			
	siła	ciepło	E statyczne	H statyczne
rozmiaru lub kształtu	sprężystość	rozszerzalność cieplna	piezoelektryczność odwrotna	piezomagnetyzm odwrotny
			elektrostrykcja (odwrotność piroelektryczności)	magnetostrykcja (odwrotność magnetosprężystości)
temperatury	piezokaloryczność	pojemność cieplna	elektrokaloryczność (odwrotność piroelektryczności)	magnetokaloryczność (odwrotność piromagnetyzmu)
polaryzacji elektrycznej	piezoelektryczność prosta	piroelektryczność (odwrotność elektrokaloryczności)	polaryzacja elektryczna	nie obserwowany
	elektrosprężystość (odwrotność elektrostrykcji)			
namagnesowania	piezomagnetyzm prosty	piromagnetyzm (odwrotność magnetokaloryczności)	nie obserwowany	namagnesowanie
	magnetosprężystość (odwrotność magnetostrykcji)			

61

Elektrety

Materiały z „zamrożoną” uporządkowaną strukturą dipolową

W 1919 r. M. Eguchi uzyskał pierwszy elektret wykorzystując twardy wosk z liści kopernicji tzw. wosk karnauba

Obecnie elektrety produkowane są z polimerów poprzez poddawanie ich działaniu silnych pól elektrycznych, bombardowanie naładowanymi cząstkami, naświetlanie i in.

W zależności od konstrukcji i sposobu wytwarzania wyróżnia się:

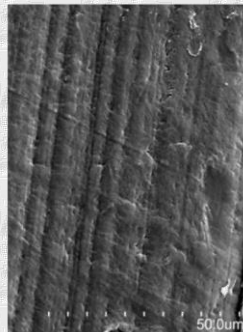
- termoelektrety
- fotoelektrety
- radioelektrety

Osobną kategorię stanowią elektrety foliowe gdzie struktura domenowa porządkowana jest poprzez wstrzykiwanie ładunków z zewnątrz. Osiągane różnice potencjałów między powierzchniami są ograniczone tylko wytrzymałością elektryczną folii i mogą przekraczać wartość 1 kV.

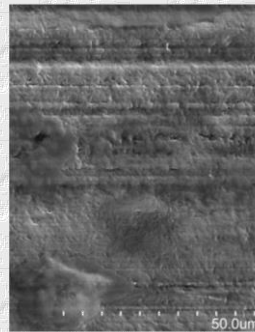
62

Do najważniejszych materiałów elektretowych zaliczane jest tworzywo fluoropochodne – politetrafluoroetylen (PTFE). Tworzywo to jest jednym z najlepszych znanych izolatorów i charakteryzuje się:

- praktycznie całkowitą odpornością na działanie związków chemicznych,
- wysoką wytrzymałością cieplną,
- bardzo niską stratność ($\tan\delta \approx 10^{-4}$, aż do 10 GHz),
- wysoką rezystywnością ($\rho \approx 10^{16} \Omega\text{m}$),
- wysoką wytrzymałością elektryczną



przed polaryzacją



po polaryzacji

63

stała czasowa elektretu - czas, po którym gęstość ładunku powierzchniowego spada e - krotnie

$$\rho = \rho_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \tau = \frac{\epsilon_r}{\sigma}$$

ϵ_r – bezwzględna przenikalność elektryczna elektretu

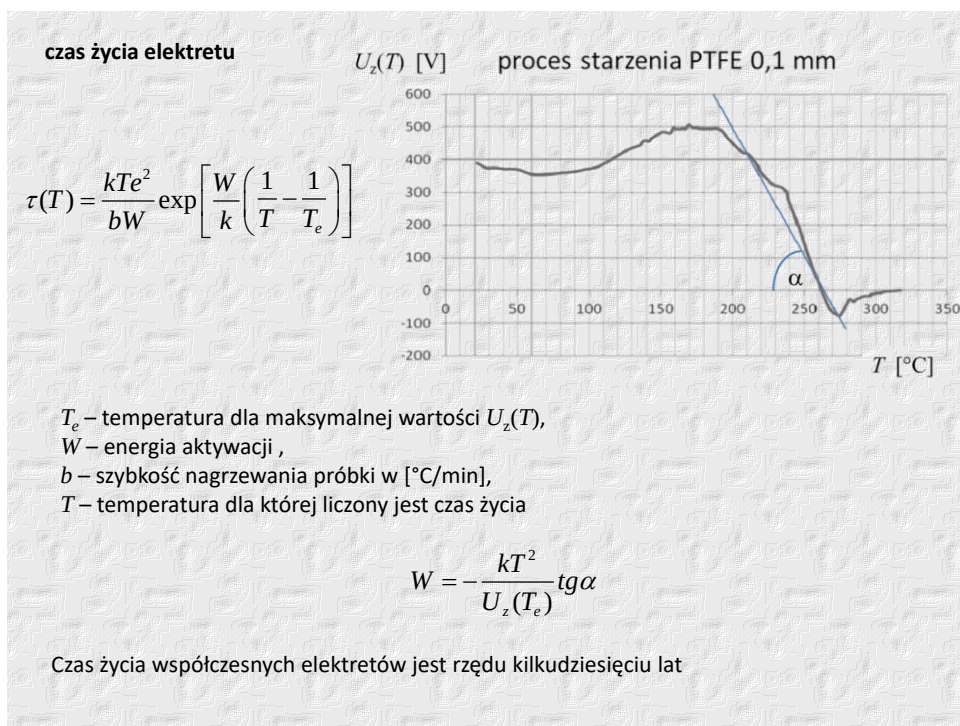
σ – konduktywność elektretu

Ładunek zgromadzony blisko powierzchni dielektryka można wprowadzić w jego głąb za pomocą tzw. procesu starzenia. Polega on na wygrzaniu elektretu w podwyższonej temperaturze.

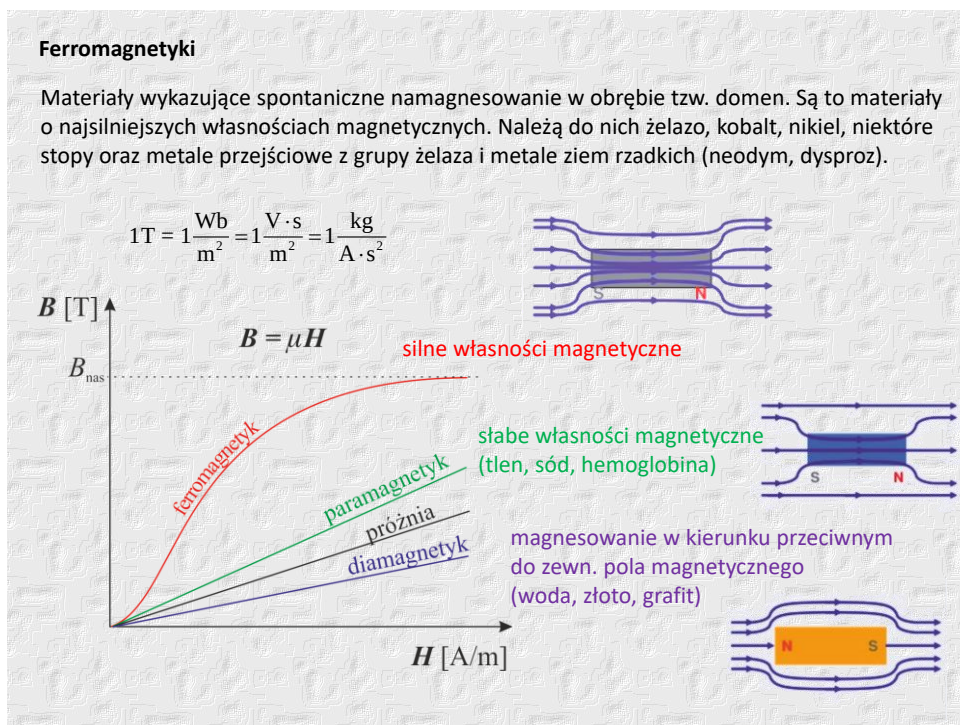
Dzięki temu procesowi zmniejsza się efektywna gęstość powierzchniowa ładunku; pozostały ładunek wykazuje większą stabilność czasową.

Elektrety niestarzone mają napięcie rzędu 1 kV, zaś do zastosowań praktycznych potrzebne są napięcia rzędu 100 V.

64



65



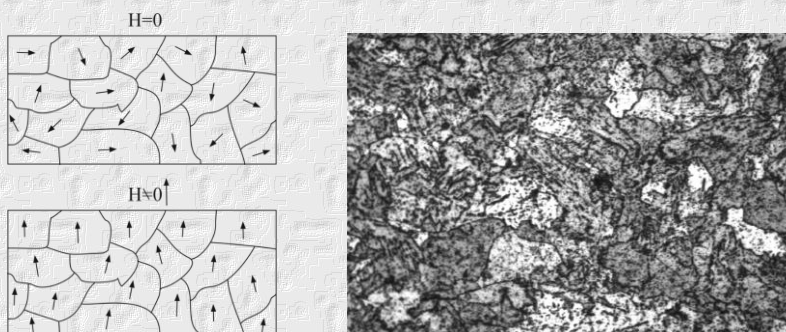
66

Materiały ferrytowe

Ferryt – międzywęzłowy roztwór stały węgla w żelazie o odmianie alotropowej α (α -Fe)
Najczęściej jest to spiek tlenku żelaza Fe_2O_3 z tlenkami Zn, Ni, Mn, Mg lub metali ziem rzadkich.

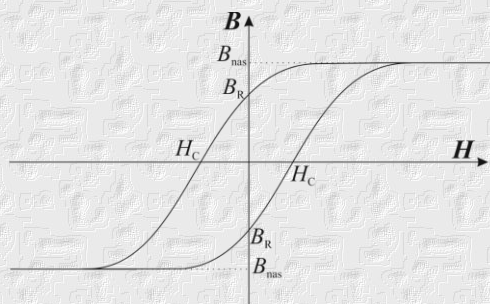
Zawartość węgla w roztworze waha się od 0,008 w temp. pokojowej do ok. 0,02 w temperaturze 723 °C, w której przechodzi on w paramagnetyczny austenit.

Ferryty są tzw. ferromagnetykami i charakteryzują się strukturą domenową z lokalnie uporządkowanymi dipolami magnetycznymi, które dość łatwo można uporządkować globalnie za pomocą zewnętrznego pola magnetycznego



67

Historia magnesowania = histereza

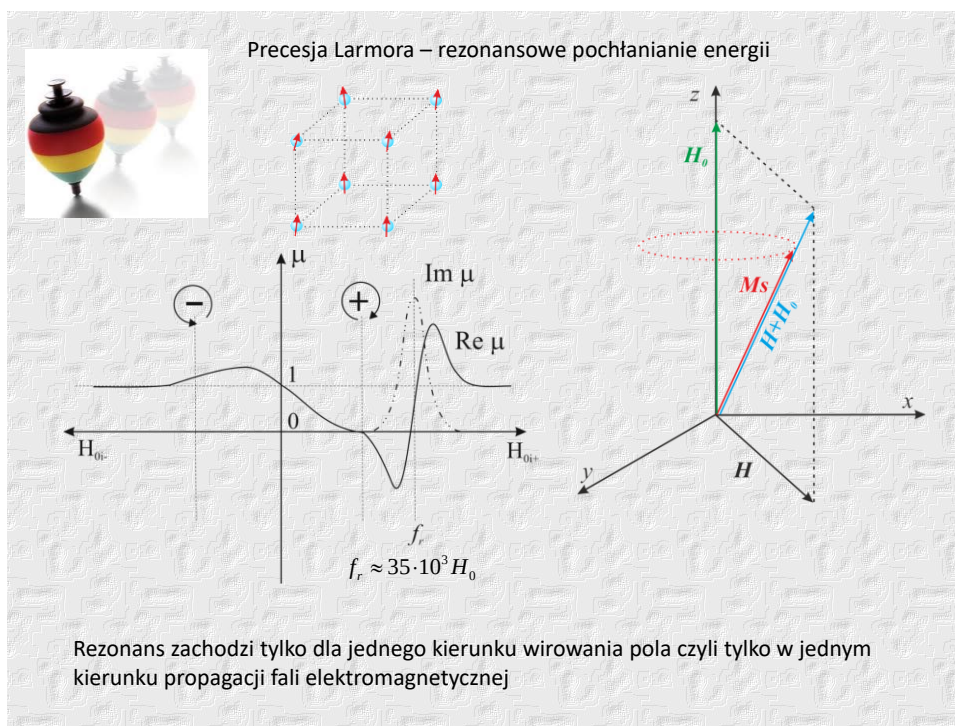


Remanencja (pozostałość magnetyczna) – wielkość namagnesowania po zaniku pola magnesującego

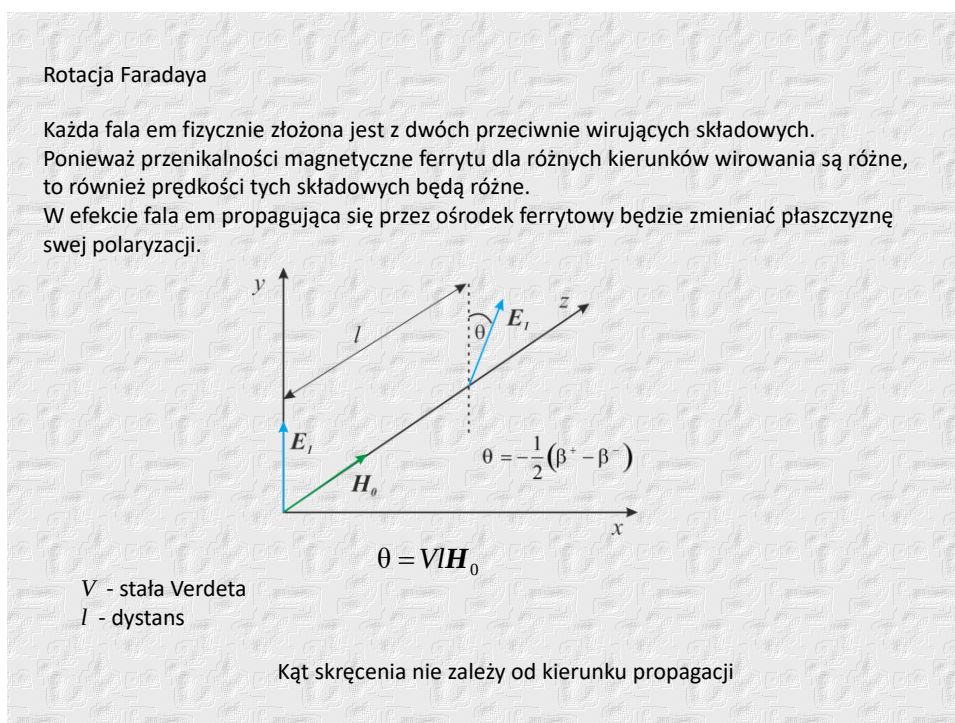
Koercja – wartość pola magnetycznego potrzebna do całkowitego zaniku namagnesowania
poniżej 1000 A/m mówi się o materiałach magnetycznie miękkich

Temperatura Curie – wartość temperatury, powyżej której zanikają własności ferromagnetyczne

68

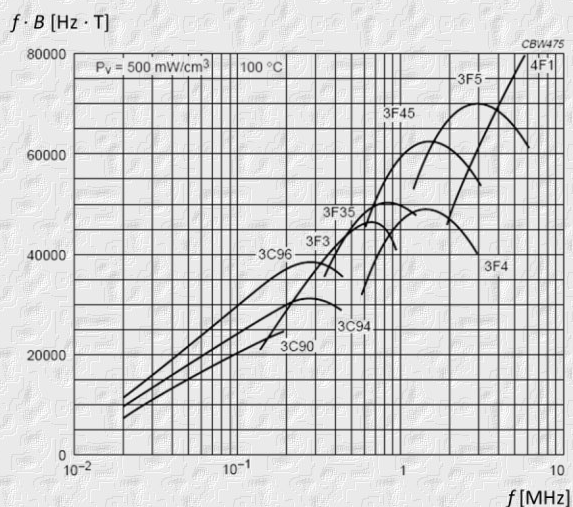


69



70

Współczynnik wydajności w funkcji częstotliwości dla różnych typów ferrytów
przy mocy właściwej 500 mW/cm³ i temperaturze 100 °C



71

Materiały te można dowolnie kształtować

Studzenie lub spiekanie w silnym polu magnetycznym „zamraża” dipole magnetyczne pozwalając uzyskać magnesy stałe o wysokich wartościach pola magnetycznego

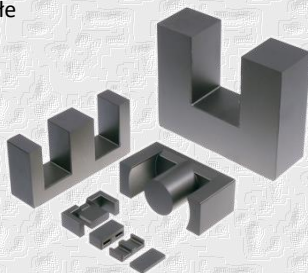


magnesy	SmCo ₅	Sm ₂ (CoFeCuZr) ₁₇	AlNiCo	twardy ferryt
indukcyjność remanencji [T]	0,85-1,0	0,95-1,15	1,25	0,3-0,45
natężenie koercji [kA/m]	>1600	800-2000	55	240-320
gęstość energii [kJ/m ³]	145-200	180-250	50	20-40
temp. wsp. remanencji [%/°C] od 20 do 100 °C	-0,04	-0,03	-0,02	-0,2
maks. temp. pracy [°C]	250	300-350	450-500	150-200

72

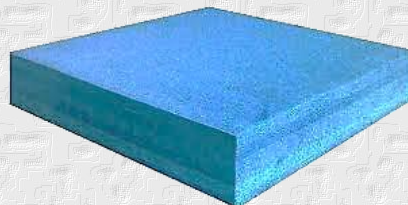
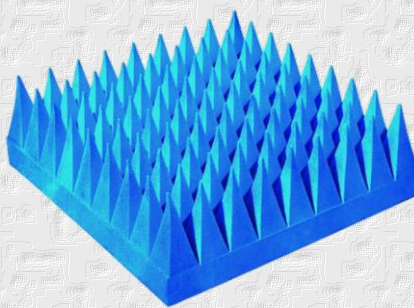
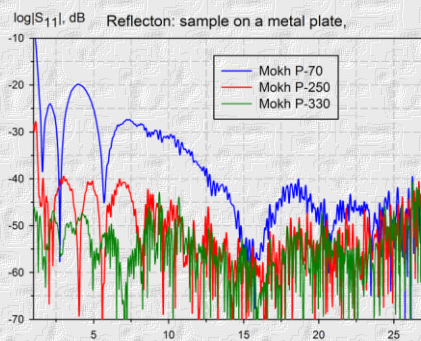
Materiały ferrytowe

- materiały o wysokiej mocy właściwej charakteryzujące się niskimi stratami w szerokim zakresie częstotliwości
zastosowania: transformatory, dławiki dużej mocy
- materiały do konstrukcji filtrów charakteryzujące się niskimi stratami w szerokim zakresie częstotliwości,
wysoką stabilnością temperaturową i wysoką dobrocią
zastosowania: anteny obwody rezonansowe transformatory szerokopasmowe, dławiki i cewki
- materiały o wysokiej przenikalności magnetycznej
zastosowania: cewki o bardzo wysokiej indukcyjności, transformatory symetryzująco-dopasowujące, magnesy stałe

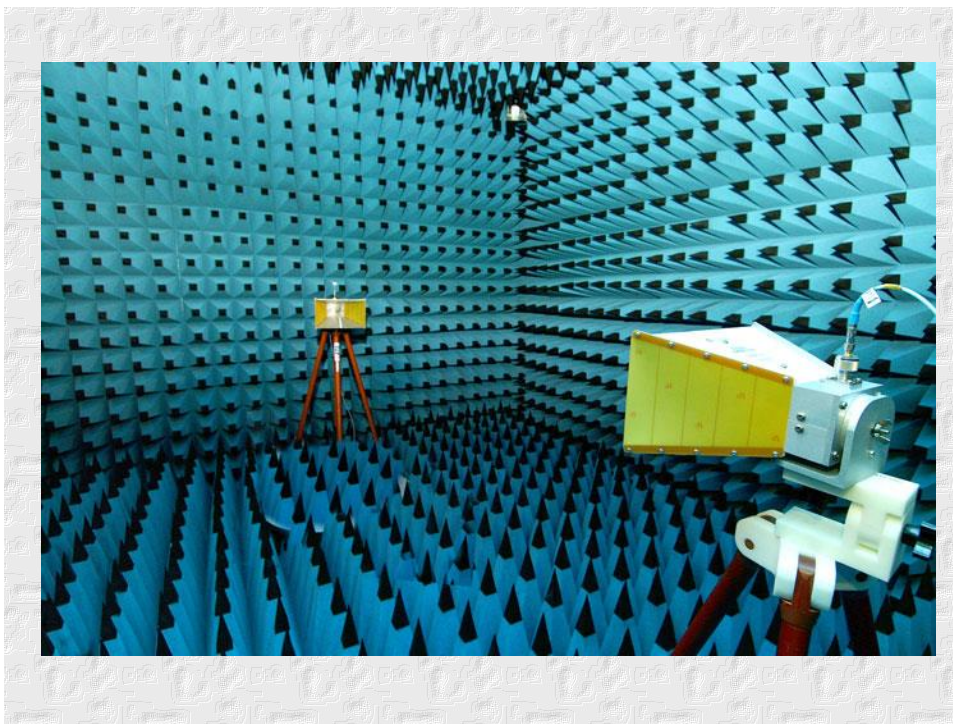


73

Proszki ferromagnetyczne



74



75

Ceramiki

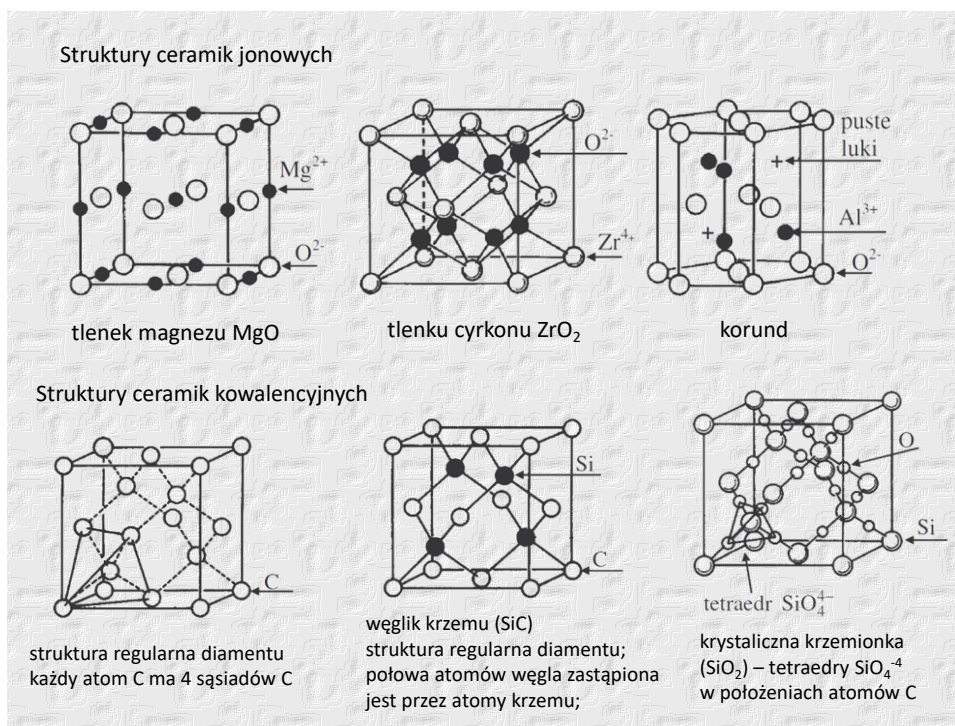
Są to nieorganiczne materiały niemetaliczne (zarówno krystaliczne jak i amorficzne), złożone głównie ze związków metali i niemetalu Al, Si, Ti, C, O, N, tworzących formy przestrzenne o jonowych, kowalencyjnych bądź mieszanych wiązaniach międzyatomowych.

Surowcem do ich wytwarzania są:

- skaleń ($K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$)
- glina (uwodnione glinokrzemiany, takie jak: $Al_2(Si_2O_5)(OH)_4$, zmieszane z innymi minerałami obojętnymi chemicznie)
- kwarc (SiO_2)
- kaolinit ($Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$)
- krzemiany
- tlenki (np. MgO , Al_2O_3)
- azotki (np. TiN , Si_3N_4)
- węgliki (np. SiC , TiC)
- borki (np. TaB_2)



76



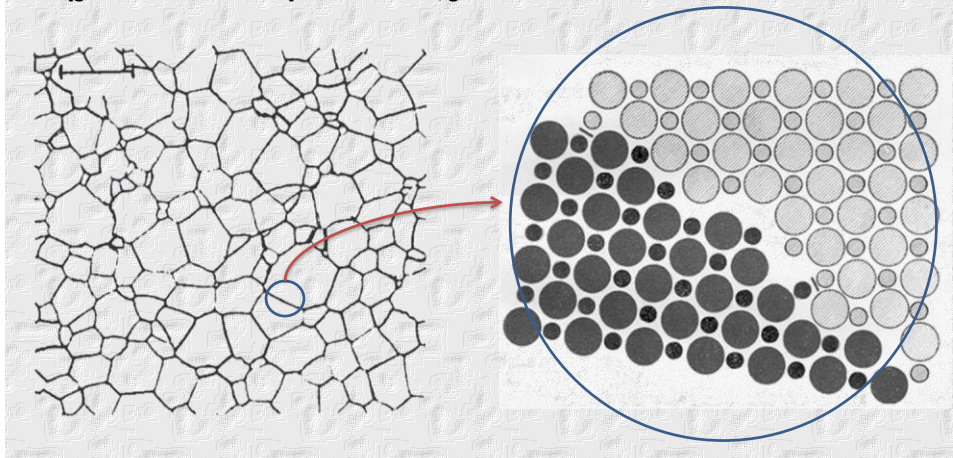
77

Ziarnista mikrostruktura ceramiki – granica ziarna

W stanie stałym są to materiały polikrystaliczne o silnym rozdrobnieniu struktury.

Wielkość ziaren jest często mniejsza od $1\ \mu\text{m}$, co powoduje, że ceramiki odznaczają się **dużą powierzchnią właściwą** (= łączna powierzchnia ziaren zawartych w 1 g masy)

Realne wartości dla przeciętnej ceramiki inżynierskiej wynoszą kilka m^2/g ale mogą osiągać wartości nawet rzędu $250\text{--}280\ \text{m}^2/\text{g}$



78

Współczesne materiały ceramiczne można podzielić na kilka grup różniących się techniką wytwarzania, mikrostrukturą i właściwościami:

- ceramika inżynierska (specjalna)
- ceramika funkcjonalna
- ceramika wielofazowa (porcelana, cegła, cement)
- szkła
- ceramika szklana (dewitryfikat)
- ceramika naturalna (skały, minerały, w tym również lód)

Materiały te charakteryzuje:

- wysoka wytrzymałość na ściskanie - znacznie większa od wytrzymałości na rozciąganie
- wysoki moduł Younga
- wysoka twardość i duża odporność na ścieranie
- wysoka kruchość
- gęstość mniejsza od metali
- mała odporność na szybkie zmiany temperatury (szoki cieplne)
- bardzo wysoka temperatura topnienia (2000-4000°C) i związana z tym odporność na działanie wysokich stałych temperatur
- wysoka odporność chemiczna
- niska przewodność cieplna i elektryczna
- duża stabilność cieplna (odporność na pękanie)

79

Ceramika inżynierska

jest wytwarzana poprzez spiekanie w wysokich temperaturach bardzo czystych związków, takich jak tlenki, azotki, węgliki, diament – bez lub z niewielkim udziałem fazy szklistej

W zależności od typu związku ceramikę inżynierską dzieli się na:

- tlenkową – opartą na tlenkach, np. Al_2O_3 , SiO_2 , ZrO_2 , MgO
- azotkową – np. Si_3N_4 ; TiN , BN ,
- węglkową – np. SiC , TiC , BC , VC , WC ,
- borkową – np. TiB_2 , ZrB_2 , TaB_2

Ceramika	Temperatura topnienia [°C]	Gęstość [Mg/m ³]
Al_2O_3	2050	3,98
ZrO_2	2700	6,27
Si_3N_4	2170	3,26
TiB_2	2900	6,08

Ceramika	Temperatura topnienia [°C]	Gęstość [Mg/m ³]
SiC	2430	3,17
WC	2530	15,7
VC	2560	5,4
TiC	2800	4,25

80

Porowatość ceramiki

Mianem porowatości określa się względne odchylenie gęstości od wartości dla materiału litego

$$\text{porowatość} = \frac{\rho_{cl} - \rho_{cp}}{\rho_{cl}} 100\% \quad \text{gdzie} \quad \rho_{cp} = \frac{m_{cs}}{m_{cpow} - m_{cwod}}$$

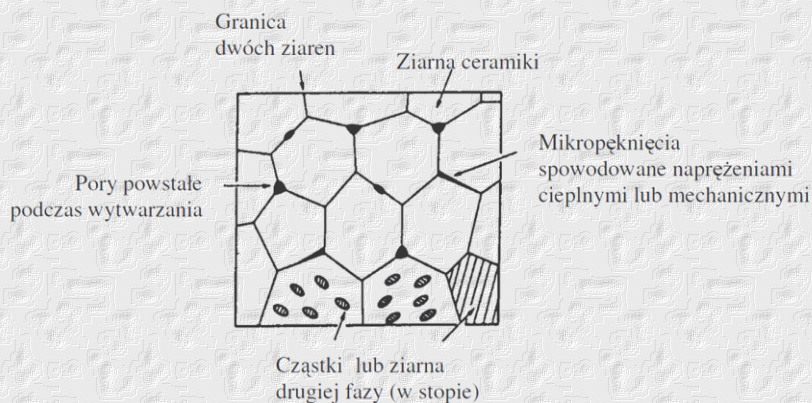
ρ_{cl} – gęstość ceramiki litej

ρ_{cp} – gęstość ceramiki porowatej

m_{cs} – masa próbki suchej

m_{cpow} – masa próbki w powietrzu

m_{cwod} – masa próbki w wodzie



81

Porównanie własności wybranych ceramik

parametr w warunkach norm.	Al ₂ O ₃	ZrO ₂	SiC	Si ₃ N ₄
gęstość [t/m ₃]	3,98	5,91	3,2	2,75
Moduł Younga [GPa]	360	205	206-308	180-310
przewodnictwo cieplne [W/mK]	10-20	1-25	23-100	15-30
maksymalna temp. użytkowania [K]	2070	1770	1620	1570
wsp. rozszerzalności liniowej [μm/m·K]	8,1	10,6	4,3-4,8	2,8-3,2
wytrzymałość na rozciąganie [MPa]	210	455	175	560
wytrzymałość na ściskanie [GPa]	10	1,89	3,92	3,5
wytrzymałość na zginanie [MPa]	440	1,02	125-700	280-800
odporność na pękanie [MPa·m ^{1/2}]	5,5	9-10	4,4	6-9

82

Zastosowania typowe dla elektroniki



83

Zastosowania typowe dla elektrotechniki



84

Szkła

Jest to odmiana materiałów ceramicznych, pomimo przewagi struktury bezpostaciowej nad krystaliczną. Wg normy ASTM-162 (1983), szkło zdefiniowane jest jako nieorganiczny materiał, który został schłodzony do stanu stałego bez krystalizacji.

Materiały te ze stanu ciekłego w stan stały przechodzą w sposób ciągły. Nie są więc przechłodzoną cieczą, ale występują w osobliwym stanie materii nazywanym stanem szklistym. Szkła mają strukturę pośrednią między cieczami, a materiałami krystalicznymi, nie będąc w zasadzie ani jednym ani drugim z tych materiałów.

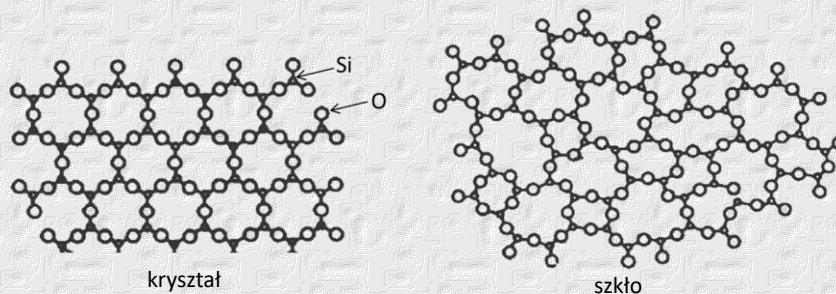
Głównymi składnikami są SiO_2 , B_2O_3 i P_2O_5 , zaś dodatkami tlenki arsenu i germanu oraz siarka, selen i tlenek ołowiu.

typowe szkła	typowy skład [% wagowe]	własności i zastosowanie
szkło krzemionkowe	100% SiO_2	odporność na szoki cieplne wysokotemp. tygle, okna pieców, elementy aparatury elektropróżniowej i chemicznej
szkło sodowo-wapniowe	75% SiO_2 15% Na_2O 10% CaO	szkła łatwe do formowania szyby, butelki, przepusty, obudowy, itp.
szkło borokrzemianowe	80% SiO_2 15% B_2O_3 10% Na_2O	Odporność na wysokie temperatury, mały współczynnik rozszerzalności cieplnej, dobra odporność na szoki cieplne; szkło laboratoryjne, obudowy lamp

85

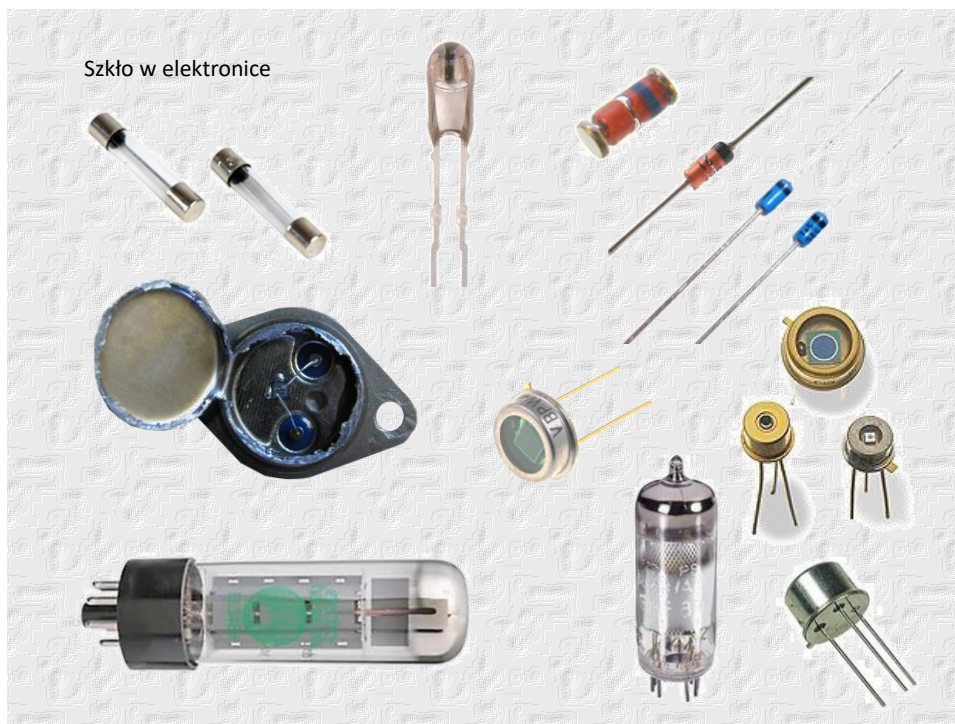
Najszerze zastosowanie znalazły **szkła krzemianowe**

W ich strukturze, podobnie jak w strukturze krzemionki krystalicznej, wszystkie naroża czworościanów SiO_4^{4-} mają wspólne naroża, jednak utworzona sieć jest nieregularna.



Czysta krzemionka w stanie szklistym ma wysoką temperaturę mięknienia, dużą wytrzymałość i stabilność oraz małą rozszerzalność cieplną.

86



87

Cermetale

Są to materiały będące **spiekami wysokotopliwych i twardych węglików, tlenków i borków z metalami**. Łączą one właściwości metali (dobre wł. mech. w temp. otoczenia, odporność na udary cieplne) z właściwościami ceramiki (niewielka zmiana własności mechanicznych pod wpływem temperatury, żarowytrzymałość i odporność na korozję).

Przykłady zastosowań cermetali:

- spieki metalowo-diaamentowe, w których ziarna diamentu znajdują się w osnowie stopów metali na bazie Fe, Cu, Mo, W lub węglików WC, TiC stosuje się na okładziny metalowo-diaamentowych ściernic lub narzędzi stalowych; umożliwiają one obróbkę najtwardszych materiałów - węglików spiekanych, ściernic korundowych. Okładziny są też stosowane na korony narzędzi wiertniczych w górnictwie i pracach geologicznych.
- spieki proszków Cu i Fe, z dodatkami Sn, Pb, grafitu oraz SiO_2 i Al_2O_3 — materiały cierne, nakładki hamulców i tarcz sprzęgieł ciernych.
- spieki z proszku metalu i Al_2O_3 oraz węglików i borków — materiały żarowytrzymałe, stosowane są na elementy silników odrzutowych

88

Tworzywa sztuczne

Są to materiały składające się z polimerów naturalnych (np. drewno) lub syntetycznych oraz dodatków modyfikujących takich jak wypełniacze, stabilizatory, plastyfikatory, uniepalniacze, środki antystatyczne, środki spieniające, barwniki itp.

Tworzywa polimerowe - głównym składnikiem jest polimer

Zalety tworzyw sztucznych: mała gęstość, odporność na czynniki zewnętrzne, wysoka trwałość, włókna z niektórych tworzyw polimerowych mogą wykazywać wysoką wytrzymałość na rozciąganie (powyżej 3500 MPa - np. aromatyczne poliamidy – Kevlar), niskie koszty wytwarzania, obróbki oraz przetwórstwa.

Wady: niska odporność na wysokie temperatury, niska twardość i podatność na pękanie, bardzo długi czas rozkładu – zanieczyszczanie środowiska

Światowa roczna produkcja sięga obecnie 300 mln ton

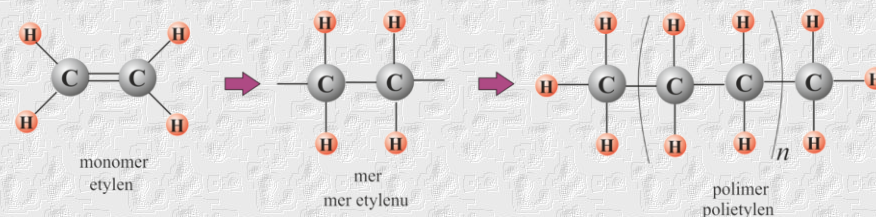
89

Tworzywem polimerowym nazywa się mieszaninę substancji wielkocząsteczkowej z dodatkami wypełniacza i barwnika. Substancjami wielkocząsteczkowymi (polimerami) nazywa się substancje o bardzo dużym ciężarze cząsteczkowym (powyżej 10^3 a.j.m).

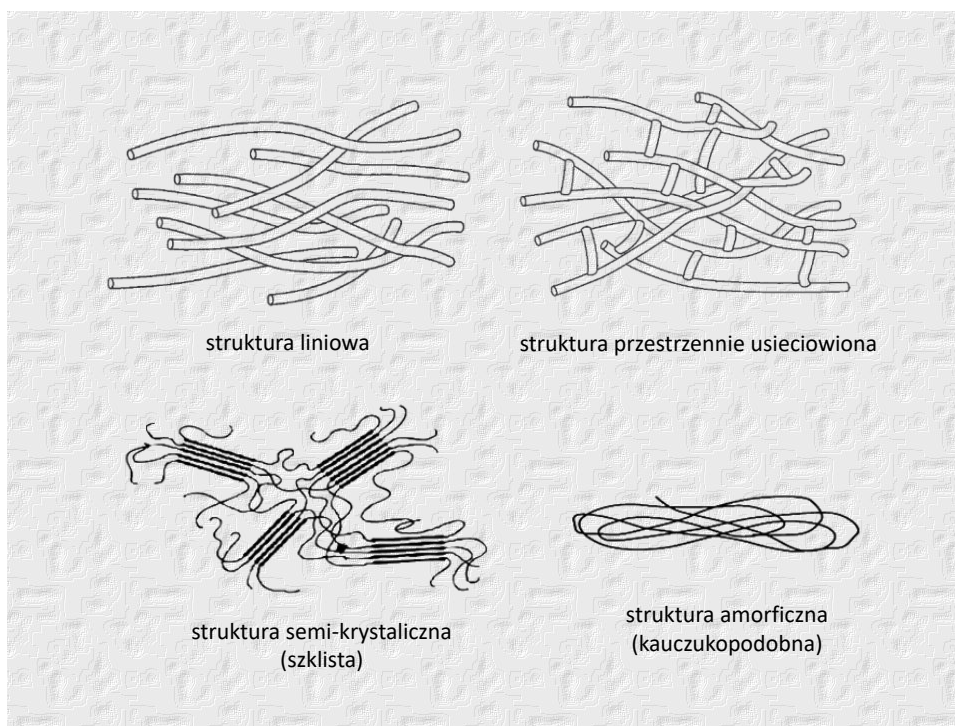
Podstawowe właściwości polimerów zależą głównie od ciężaru cząsteczkowego. Polimery o niskim ciężarze cząsteczkowym są płynne, oleiste, zaś o wielkim ciężarze cząsteczkowym są ciałami stałymi.

W skład polimeru wchodzi bardzo duża liczba dużych cząsteczek zwanych makrocząsteczkami tworzącymi określoną strukturę przestrzenną.

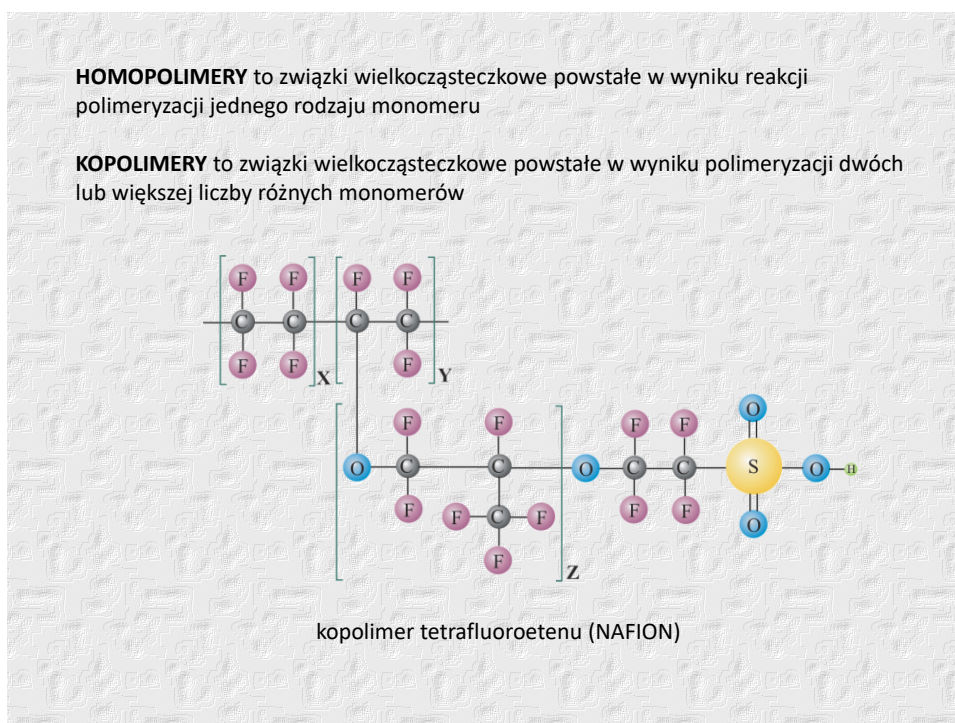
Każda makrocząsteczka składa się z elementów podstawowych zwanych merami (monomerami). Proces łączenia się merów w substancję wielkocząsteczkową nazywa się polimeryzacją, a uzyskany produkt polimerem. Proces odwrotny nosi nazwę depolimeryzacji



90



91



92

Klasyfikacja tworzyw sztucznych

Ze względu na metodę otrzymywania:

- produkty przemiany,
- produkty polikondensacji,
- produkty polimeryzacji,
- produkty poliaddycji,
- poliestry,
- żywice silikonowe.

Przykłady tworzyw sztucznych będących produktami przemian:

- fibra wulkanizowana - wynik chemicznej przemiany celulozy za pomocą ZnCl_2 lub H_2SO_4 -> przekładki elektrotechniczne, uszczelki
- celuloza regenerowana (celofan, tofoman) - modyfikacja celulozy przez działanie NaOH i CS_2 -> przekładki elektrotechniczne, opakowania foliowe, osłonki wędlin, jedwab wiskozowy
- azotan celulozy (celuloid) - wynik estryfikacji celulozy w obecności H_2SO_4 -> lakiery nitro, artykuły AGD
- octan celulozy (cellon, cellit) - modyfikacja celulozy mieszaniną kwasu octowego i bezwodnika kwasu octowego -> niepalne błony filmowe, opakowania, lakiery
- ester celulozy (Trolit) - estryfikacja celulozy różnymi alkoholami -> masy wtryskowe do produkcji artykułów elektrotechnicznych (dobre własności dielektryczne), lakiernictwo, kleje
- sztuczny róg (Galalit) - otrzymuje się przez modyfikację kazeiny formaldehydem -> zabawki, okładziny, sprzączki, guziki, itp.

93

Przykłady tworzyw sztucznych będących produktami polikondensacji (duropłastów):

- żywice szlachetne fenolowe (Dekovit) - otrzymuje się z fenolu i formaldehydu -> piankowe żywice fenolowe, wyroby galanteryjne, ozdobne
- tłoczywa fenolowe i krezolowe (Plastadur, Bakelit) - otrzymuje się z fenolu lub krezolu, formaldehydu i napęniaczy (proszki mineralne, włókna, ścinki tekstylne, włókno szklane, itp). -> elektrotechniczne materiały izolacyjne
- laminaty fenolowe i krezolowe (Plastacart, Prestofol) - otrzymuje się z fenolu i krezolu, formaldehydu i materiałów warstwowych, np. arkuszy papieru, forniru, tkanin tekstylnych i szklanych -> płyty budowlane i dekoracyjne, materiały izolacyjne w elektrotechnice, panewki łożysk i koła zębate, itp. części maszyn.
- żywice karbamidowe (mocznikowe i melaminowe) - otrzymuje się je z mocznika i formaldehydu -> są fizjologicznie obojętne, kleje i lakiery, materiały piankowe (Piatherm) do izolacji cieplnej i akustycznej
- tłoczywa karbamidowe (Meladur) - otrzymuje się z mocznika lub melaminy, formaldehydu i wypełniaczy -> , przekładki izolacyjne, art. AGD
- laminaty karbamidowe (Sprelacart, Resopal) - otrzymuje się z mocznika lub melaminy, formaldehydu i materiałów warstwowych -> płyty dekoracyjne ścian, mebli, materiały grawerskie

94

Przykłady tworzyw sztucznych będących produktami polimeryzacji (termoplastów):

- polichlorek winylu (PVC, Ekadur, Owilit, Tarnavinyl S, PCW) - otrzymuje się z acetyleny i chlorowodoru. Jest tworzywem produkowanym w największych ilościach -> folie, płyty, rury i inne wyroby profilowe oraz pasty, itp.
- polietylen (PEw, Politen, Lupolen) - otrzymuje się w procesie polimeryzacji etylenu. Zależnie od masy cząsteczkowej rozróżnia się polietylen miękki (wysokociśnieniowy) i polietylen twardy (niskociśnieniowy) - > opakowania, kształtki, i in. zastosowania bardzo szerokie we wszystkich dziedzinach techniki
- polipropylen (Malen PJ-400, Pimalen) - otrzymuje się w procesie polimeryzacji propylenu. Wysoki stopień krystaliczności tworzywa wpływa na jego wysokie właściwości mechaniczne i termiczne. Temperatura mięknienia (170 - 200°C) jest wyższa, niż większości innych termoplastów -> wyroby o wysokich wymaganiach termicznych, rury, narzędzia, aparatura
- poliizobutylen - otrzymuje się w procesie polimeryzacji produktów ropy naftowej. Zależnie od stopnia polimeryzacji może mieć postać lepkiego oleju lub twardej gumy -> dodatek uszlachetniający do smarów i klejów, folie, płyty, rurki elastyczne
- poliamid (Perlon, Dederon, Nylon, Miramid, Perfol) - otrzymuje się z pochodnych węgla, gazu ziemnego lub ropy naftowej -> niełamliwe artykuły codziennego użytku, artykuły techniczne o wysokich właściwościach wytrzymałościowych, włókna, lekkie tkaniny, itp.

95

- polistyren (Trolitul, Styroflex) - otrzymuje się z etylenu i benzenu -> nakrętki, tuby, przedmioty galanteryjne, materiały piankowe, itp.
- polimetakrylan metylu (Pleksiglas, Piacryl) - otrzymuje się z acetonu i cyjanowodoru -> światłowodów, okna samolotów, artykuły codziennego użytku o dużej przezroczystości, itp.
- polioctan winylu - otrzymuje się z acetyleny, ropy naftowej i gazu ziemnego. Zależnie od stopnia polimeryzacji otrzymuje się substancje oleiste, kleiste lub twarde żywice -> roztwory dyspersyjne, mieszanki do powlekania, przemysł lakierniczy, tekstylny, itp.
- poliakrylonitryl (Wolpryla, Orion) - otrzymuje się z acetyleny i chlorowodoru. Tworzywo produkowane jest jako półprodukt w postaci włókien i przędzy -> tkaniny odporne na działanie czynników atmosferycznych, światła i chemikaliów, o bardzo dużej wytrzymałości i dużej zdolności ocieplającej, itp.
- policzterofluoroetylen (PTFE – Teflon, Algoflon, Soreflon) Posiada nadzwyczaj dużą odporność na ścieranie, niską chłonność wilgoci, wysoką odporność termiczną -> aparatura termoodporna, zawory, uszczelki, łożyska ślizgowe, itp.
- poliwęglan (Makrolon) - otrzymuje się z fozgenu i dianu. Półwyroby wytwarza się w postaci włókien, folii, rur. Charakteryzuje się bardzo dobrymi własnościami mechanicznymi i dielektrycznymi -> przemysł elektroniczny, medycyna, części maszyn o dużych wymaganiach technicznych oraz przedmioty codziennego użytku.

96

Przykładem tworzywa będącego produktem poliaddycji (polimeryzacji kondensacyjnej) jest poliuretan (Ułazian, Utagen, Moltopren) - otrzymuje się z acetyleny -> produkcja artykułów piankowych, technika klejów, lakierów, itp.

Do tworzyw poliestrowych zalicza się tworzywa chemoutwardzalne takie jak:

- żywice poliestrowe,
- żywice epoksydowe,

Żywice poliestrowe zwykle w postaci ciekłej po zastosowaniu wypełniaczy (np. włókna szklanego) służą do wytwarzania elementów o dużej wytrzymałości takich jak kadłuby łodzi, karoserie samochodów, wanny, itp.

Żywice epoksydowe (Epidian, Araldid) w postaci cieczy lub past (szpachlówek) znajdują zastosowanie jako żywice lane, adhezyjne i impregnacyjne. Na nich oparta jest technika klejenia metali

Żywice silikonowe stanowią odrębną kategorię. Są one zaliczane do związków krzemooorganicznych z wbudowanymi na miejscu atomów węgla, atomami krzemu. Otrzymuje się je z piasku kwarcowego, węgla, chloru poprzez czterochlorek krzemu. Oznaczają się dużą odpornością na skrajne temperatury (od -60 do 300 °C). W handlu spotyka się silikony w postaci oleistych cieczy i ciał stałych. Znajdują one zastosowania w przemyśle lakierów, materiałów polerskich, w elektrotechnice, technice próżniowej, w przemyśle skórzanym, w budownictwie itd.

97

Podział tworzyw sztucznych ze względu na właściwości mechaniczne i termiczne:

- tworzywa termoplastyczne,
- tworzywa termoutwardzalne,
- tworzywa wulkanizujące

oraz

- elastomery (w. temp. pokojowej mogą być wydłużane o ponad 100% nawet do 1000%),
- plastomery (w. temp. pokojowej możliwe wydłużenie nie przekracza 100%).

Do najważniejszych polimerów termoutwardzalnych należą: tworzywa mocznikowe (UF), fenolowe (PF), melaminowe (MF).

Do polimerów chemoutwardzalnych należy zaliczyć poliestry nienasycone (UP), epoksydy (EP).

Do elastomerów zalicza się tworzywa wulkanizowane, np. kauczuk naturalny, silikony (SI), oraz tworzywa niewulkanizujące, np. zmięczony polichlorek winylu (PVC), elastomery poliuretanowe.

Do plastomerów zalicza się termoplasty i duroplasty (termo- lub chemoutwardzalne).

Termoplasty przy ogrzewaniu mięknią, a po ostygnięciu twardnieją, duroplasty przy ogrzewaniu początkowo mięknią, lecz przy dalszym dostarczaniu ciepła twardnieją (tworzywa termoutwardzalne).

Duroplasty chemoutwardzalne, po wprowadzeniu do nich odpowiedniego związku chemicznego, utwardzają się.

98

Duroplasty chemoutwardzalne z odpowiednimi dodatkami stosowane są na obudowy dyskretnych przyrządów elektronicznych oraz układów scalonych



99

Podstawowe właściwości wybranych tworzyw termoplastycznych

Nazwa	Symbol	Gęstość [kg/m ³]	R _m [MPa]	E [MPa]	T _m [°C]
Polichlorek winylu	PVC PCW	1380	55	2500	75
Polietylen wysokociśnieniowy	PEw	920	12	-	80
Polipropylen	PP	910	40	1300	151
Poliamid - 6	PA	1128	54	1900	189
Polistyren	PS	1040	30	2940	91

100

Zgrubna identyfikacja tworzyw na podstawie pomiaru gęstości

Gęstość [g/cm ³]	Rodzaj tworzywa
< 0,3	tworzywa porowate
0,9 ÷ 1,0	polietylen, polipropylen, polizobutylen, kopolimery styrenu z butadienem, z akrylonitrylem
1,0 ÷ 1,2	polistyren, poliamidy, polimetakrylan metylu, polioctan winylu, poliestry nienasycone lane, poliwęglany
1,2 ÷ 1,3	poliuretany, octan celulozy, polialkohol winylowy, polichlorek winylu plastyfikowany, epoksydy lane
1,3 ÷ 1,4	azotan celulozy, fenoplasty lane (ewentualnie z napelniaczem org.), fenoplasty warstwowe tkaninowe, polichlorek winylu, chlorowany polieter (penton), poliestry kwasu tereftalowego (typu elany)
1,4 ÷ 1,7	aminoplasty z napelniaczami org., poliformaldehyd, fenoplasty warstwowe papierowe, polichlorek winylu z napelniaczem mineralnym, chlorokauczuk
1,7 ÷ 2,0	polichlorek winyldenu, tworzywa wzmacniane włóknem szklanym (poliestrowe, epoksydowe i in.)
> 2	policzterofluoroetylen, polichlorotrójfluoroetylen, niektóre laminaty o dużej zawartości włókna szklanego, tworzywa z ciężkimi napelniaczami nieorganicznymi

101

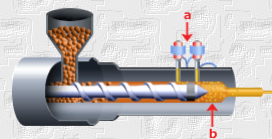
Tworzywa porowate

Tworzywa sztuczne zawierające w strukturze puste przestrzenie

dzielą się na:

tworzywa gąbczaste - pory otwarte i połączone wzajemnie

tworzywa piankowe - pory zamknięte

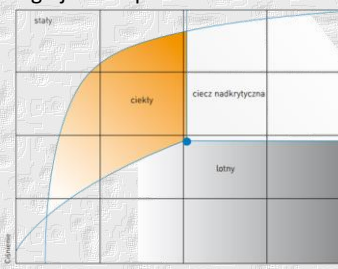


Tworzywa porowate wytwarza się w wyniku zwiększania objętości litej masy tworzywa (spienianie chemiczne lub fizyczne) lub bez jej zwiększania (wyfukiwanie)

Przy spienianiu chemicznym do tworzywa sztucznego dodaje się granulat spieniający. Spienianie następuje w wyniku reakcji chemicznej.

Przy spienianiu fizycznym do roztopionego tworzywa sztucznego jest bezpośrednio wprowadzany gaz (najczęściej azot w postaci cieczy nadkrytycznej).

Obydwie metody umożliwiają zmniejszenie gęstości i wyeliminowanie fazy docisku, ze wszystkimi związanymi z tym zaletami: krótszy czas wtrysku, mniejsze zużycie materiału, lepsza stabilność wymiarowa i in.



102

Technologia spieniania wykorzystywana jest do produkcji szerokiej gamy detali w licznych branżach przy użyciu niemal wszystkich tworzyw termoplastycznych.

W postaci tworzyw porowatych produkuje się detale polistyrenowe, poliuretanowe, poliwęglanowe, PCW i in.

Znajdują one liczne zastosowania m.in. jako izolatory w elektrotechnice i budownictwie, pochłaniacze fal, surowiec do wyrobu opakowań, filtrów, wypełnień itd.



103

Oznakowania tworzyw sztucznych i innych materiałów

	Politereftalan ETylenu - PET (PolyEthylene TErephthalat - PETE) Polietylen - butelki na wodę i napoje, włókno poliestrowe
	Polietylen dużej gęstości (High Density PoliEthylene lub PoliEthylene High Density). Istnieje jeszcze odmiana MDPE (Medium DensityPoliEthylene) - średnio gęsty polietylen - - butelki na mleko, oleje i detergenty, torby, zabawki, pojemniki (do użytku pod gołym niebem), imitacja drewna
	PoliChlorek Winyłu - PCW (PoliVinylo-Chlorane - PVC, czasem tylko V - Vinylo); PVC twardy - winidur - podobny z wyglądu do polipropylenu, PVC miękki - winiplast - podobny z wyglądu do polietylenu; ramy okienne, pojemniki na chemikalia, wykładziny i płytki podłogowe, części samochodowe.
	Polietylen małej gęstości (Low Density PoliEthylene lub PoliEthylene Low Density, czasem oznakowany tylko dwoma literami - PE) - torby na zakupy, naczynia jednorazowe, pojemniki, rury. Odmiana - LLDPE.
	PoliPropylen (PoliPropylene - PP) - zderzaki samochodowe i elementy wykończenia wnętrza aut, włókna przemysłowe (worki, maty, dywany), pojemniki do chłodziarek. Naczynia z PP oznakowane jako no BPA / BPA Free, czyli nie zawierające Bisfenolu A są dostosowane do kontaktu z żywnością

104

	PoliStyren - PS - PoliStyrene, EPS (twardy spieniony polistyren - mold), OPS (orientowany polistyren), PSP (miękkie). Zabawki, doniczki, kasety wideo, popielniczki, kadłuby małych jednostek wodnych (trunks), opakowania ochronne, opakowania mięsa
 	O - OTHER - wszelkie INNE tworzywa sztuczne (np. plastik poliwęglanowy PC - PolyCarbonate plastic) i laminaty folii z tworzyw sztucznych (PA - PolyAmide, SAN- Styrene AcryloNitrile, PAN - PolyAcryloNitrile, acrylic plastics). Do tej grupy zaliczane są też tworzywa sztuczne pochodzenia organicznego (tzw. bioplastics, np. PLA -PolyLactic Acid). To może być również mieszanina innych polimerów... Recykling: nie występuje (tylko wysypiska - landfill)
	Acrylonitrile Butadiene Styrene - akrylonitryl butadien styren, twardy, odporny na zarysowania, udary i chemikalia, wrażliwy na światło i promieniowanie UV - nadkola, przyciski, obudowy (komputery i monitory, RTV, AGD, telefony), części mebli, zabawki, rurociągi termoplastyczne

105

Oznakowania innych materiałów
substancje groźne dla środowiska, chemicznie aktywne i trujące

	baterie (ogniwa) ołowiowo-kwasowe (Lead-Acid) - akumulatory samochodowe
	baterie (ogniwa) niklowo-kadmowe (Nickel-Cadmium)
	baterie (ogniwa) niklowo-metalowo-wodorkowe (Nickel-Metal Hydride)
	baterie (ogniwa) litowe (Lithium)
	baterie (ogniwa) srebrowo-cynkowe (Silver-Oxide-Zinc)
	baterie (ogniwa) węglowo-cynkowe (Carbon-Zinc)
	baterie (ogniwa) alkaliczne (Alkaline) - czasami oznaczane cyfrą 9

106

Materiały celulozowe

 20 C PAP  20 PCB	karton, tektura falista, papier pakowy (C PAP - Cardboard PAPer, PCB - PaperCardBoard) i wyroby z tych materiałów kartonowe opakowania wyrobów z Chin mają jeszcze inne oznakowania: CB (CardBoard) lub CFB (Card FiberBoard)
 21 PAP	inny papier, mieszany, tektura - prasa, poczta, ulotki, papier piśmienny
 22 PAP	papier - PAPer papier piśmienny, do kopiarek i drukarek
 23 PPB  23 PBD	papier i tektura powlekane (PBD - PaperBoarD, inny skrót to PPB) - widokówki, opakowania mrożonek, okładki

107

Metale i szkła i inne

 40 FE	żelazo i stal blacha stalowa (FErrum) lub blacha stalowa ocynkowana
 41 ALU  alu	ALUminium
 50 FOR  51 FOR	50 drewno (FORest), 51 korek
 60 COT	bawełna
 61 TEX ...  69 TEX	różne materiały tekstylne
 70 GLS ...  79 TEX	szkła: 70 mieszane, 71 przezroczyste, 72 zielone, 73 brązowe, 74 bezołowiowe, 75 niskootłowiowe, 76 ołowiowe, 77 miedziowane, 78 srebrzone, 79 złoczone
 81 PapPet	papier (PAP) PET (Politereftalan ETylenu)
 84 PapAl	papier (Pap) powlekany aluminium (Al)

108

pozostałe

	papier laminowany tworzywem
	tworzywa sztuczne połączone z aluminium
	tworzywa sztuczne połączone ze stalową blachą ocynkowaną
	tworzywa sztuczne połączone z innymi metalami
	połączenie szkła z różnymi tworzywami sztucznymi
	szkło z aluminium
	szkło połączone ze stalową blachą ocynkowaną
	szkło połączone z różnymi metalami

kompozyty metamateriały

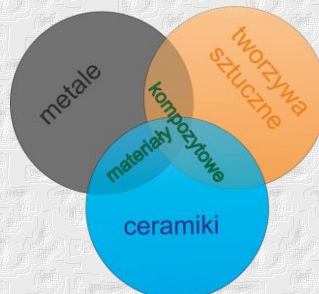
1

Kompozyty (materiały kompozytowe)

(łac. *compositus* = złożony) - materiał zbudowany z co najmniej dwóch różnych składników połączonych na poziomie makroskopowym w celu uzyskania materiału o nowych własnościach

Własności kompozytu zależą od

- własności faz składowych
- udziału objętościowego faz
- sposobu rozmieszczenia fazy rozproszonej w osnowie
- cech geometrycznych fazy rozproszonej



2

Materiały kompozytowe znane są od starożytności

W XIII w. p.n.e. budowano domy z bloków z mieszanki błotnej wzmocnionej słomą i końską sierścią

Od co najmniej V w. p.n.e. znane były materiały otrzymywane przez przesycanie wielu cienkich warstw papieru i tkanin chińską laką

Ok. 3600 lat p.n.e.) Egipcjanie znali drewnianą sklejkę

W średniowieczu konstruowano zbroje i miecze łącząc różne metale i drewno

1942 r. PYKRET – mieszanka lodu i drewna

Obecnie najbardziej rozpowszechnione są drewniane sklejki, płyty wiórowe, paździerzowe, gipsowo-kartonowe, beton zbrojony itp.

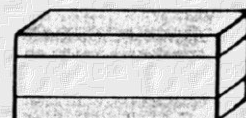
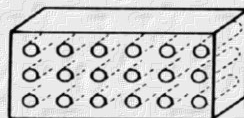
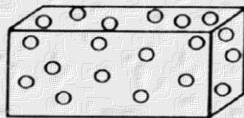
3

Kompozyty składają się z minimum 2 faz:

- ciągłej tzw. osnowy lub matrycy
- rozproszonej tzw. osnowy lub zbrojenia

Ze względu na postać fazy rozproszonej kompozyty dzielą się na:

- ziarniste
- włókniste
- warstwowe



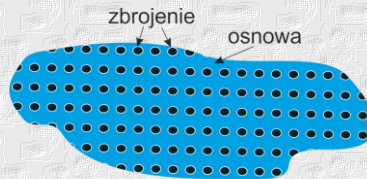
Podstawowe cechy kompozytów:

- dobre właściwości mechaniczne,
- wysoka wytrzymałość na różne czynniki,
- mały ciężar właściwy,
- możliwość uzyskiwania określonych cech – nieosiągalnych przez inne materiały

4

Rola osnowy

- utrzymywanie zbrojenia w określonym położeniu
- zapewnienie wytrzymałości na ściskanie
- przenoszenie naprężeń zewnętrznych na zbrojenie,
- zatrzymywanie rozprzestrzeniania się pęknięć,
- nadawanie wyrobom pożądanego kształtu

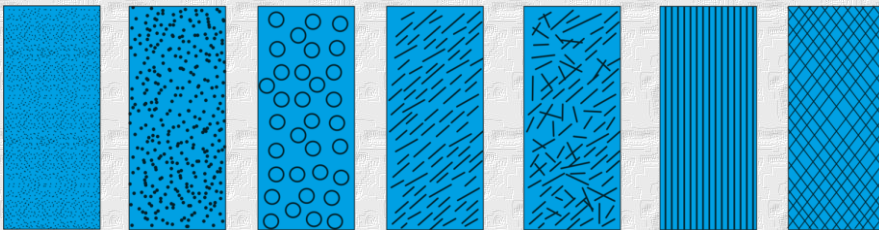


Jako osnowę najczęściej wykorzystuje się:

- polimery poliepoksydowe i poliestrowe
- metale Ti, Ni, Fe, Al, Cu lub ich stopy
- ceramikę Al_2O_3 , SiO_2 , SiC, TiO_2

5

- Zadaniem zbrojenia jest wzmacnianie materiału i poprawianie jego właściwości mechanicznych.
- Zbrojenie może mieć postać:
 - włókien ciągłych lub nieciągłych
 - rurek
 - prętów
 - granulatu
 - proszku
 - in.
- Zbrojenie może być
- zorientowane lub niezorientowane
- izotropowe anizotropowe



6

Podział kompozytów

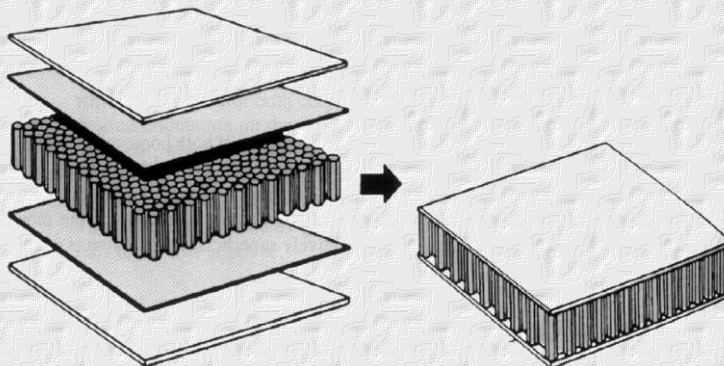
- pochodzenie (naturalne, sztuczne)
- przeznaczenie
- rodzaj osnowy
- rodzaj zbrojenia



7

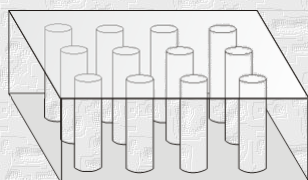
Kompozyty warstwowe

- Dwie wytrzymałe warstwy zewnętrzne rozdzielone warstwą słabszego i mniej gęstego materiału (tzw. rdzenia).
- Rolą rdzenia jest przeciwdziałać deformacjom spowodowanym siłą prostopadłą do powierzchni zewnętrznych. Często rdzeń ma strukturę plastra miodu.

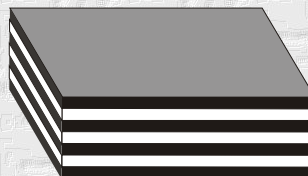


8

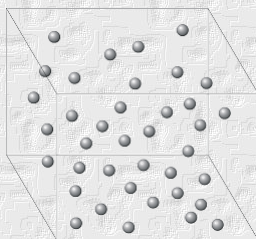
W 1986 r. Newnham przedstawił podział kompozytów na podklasy zależnie od ich struktury wewnętrznej wprowadzając oznaczenia 1-3, 0-3, 2-2 itd. odnoszące się do wymiarów zbrojenia i osnowy; np 1-3 oznacza jednowymiarowe włókna (ważna jest tylko ich długość) w trójwymiarowej osnowie.



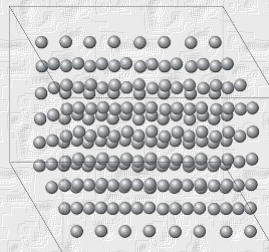
1-3



2-2



0-3



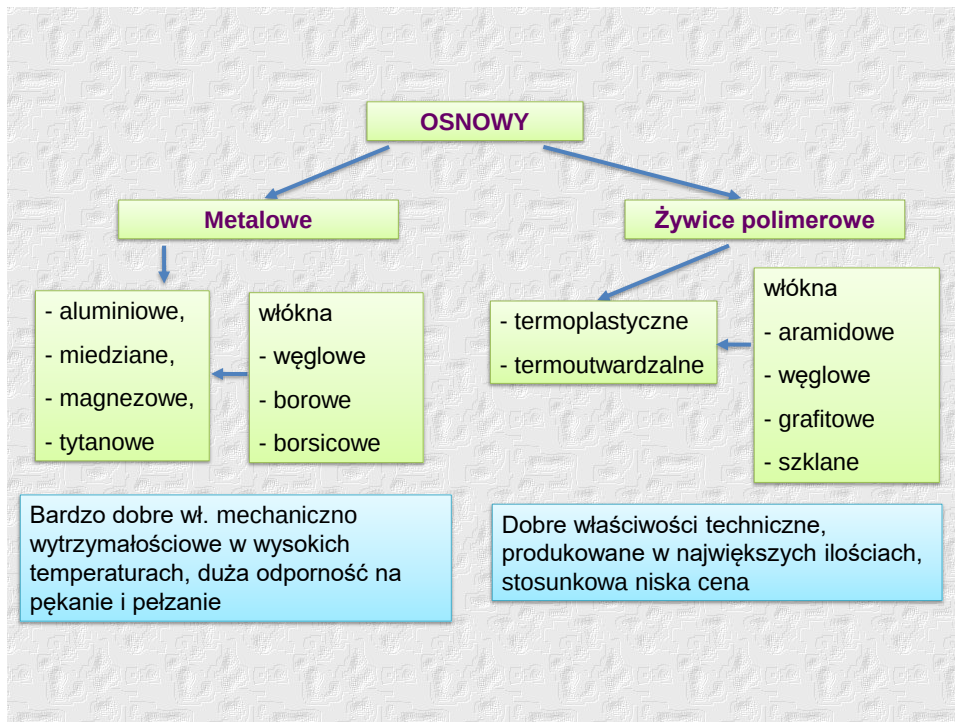
3-3

9

Typowe technologie wytwarzania

- Kompozyty cząsteczkowe – technikami metalurgii proszków,
- Kompozyty włókniste
 - przeróbka plastyczna (walcowanie, wyciskanie, prasowanie)
 - metody z ciekłą osnową (infiltracja ciekłych metali do porowatych kształtek)
- Ogólne metody wytwarzania kompozytów
 - kontaktowe
 - natryskowe
 - nawijanie włókien
 - taśmowe
 - itp.

10



11

Włókna

Charakteryzuje je duża sztywność i wytrzymałość, wielokrotnie większa od wartości odpowiednich charakterystyk dla materiału w postaci masowej (np. wytrzymałość na rozciąganie typowych stali jest rzędu 0,2-0,7 GPa, zaś wytrzymałość cienkich włókien stalowych wynosi ok. 4 GPa).

- **szklane** - najstarsze, najtańsze i najczęściej stosowane, 2 typy E(gorsze wł. mechaniczne), S (zastosowanie militarne)
- **grafitowe** – lepsze od szklanych ale droższe. Posiadają dobrze wykształconą i zorientowaną strukturę. Typy: wysokowytrzymałe, wysokomodułowe i ultrawysokomodułowe
- **węglowe** – podobne do grafitowych ale mniej uporządkowana struktura, obszary o zaburzonej strukturze krystalicznej
- **aramidowe** - zbudowane z poliamidów włóknotwórczych z grupami aromatycznymi w głównych łańcuchach polimeru. Im więcej w strukturze grup aromatycznych, tym większa odporność mechaniczna i termiczna (najbardziej znany jest KEVLAR = poli(fenyleno-1,4-diamid))
- **organiczne** – bawełna, juta, sisal po wynalezieniu włókien aramidowych stosowane na szeroką skalę w sprzęcie sportowym (nazwy Nomax, Kevlar)

12

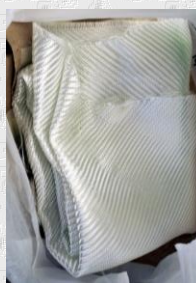
Własności wybranych żywic

żywica		parametry		
typ	rodzaj	ρ [kN/m ³]	E [GPa]	R [MPa]
TU	epoksydowa (Narmco, Vicotex)	10,8-13,7	2,1-5,5	40-85
TU	poliestrowa (Polimal)	10,8-13,7	1,3-4,1	40-85
TU	fenolowa	11,8-13,7	2,7-4,1	35-60
TP	nylonowa	10,8	1,3-3,5	55-90
TP	poliwęglanowa	11,8	2,1-3,5	55-70
TP	polietylenowa	8,8-9,8	0,7-1,4	20-35

13

Własności wybranych włókien w porównaniu ze stalą

	szklane E	szklane S	grafitowe	Kevlar 49	boron	stal
średnica w [μ m]	16	16	7-8	12	100-200	
ciężar właściwy ρ [kN/m ³]	25-25,5	24,5	13,8-18,6	14,1	25,5	78,5
wytrzymałość na rozciąganie S [GPa]	1,7-3,5	2,5-4,8	1,7-2,8	2,3-3,6	3,5	~ 4
wytrzymałość właściwa S/ρ [km]	68-136	103-197	123-163	161-257	135	51
moduł Younga E [GPa]	72	86	230-250	120-124	400-410	200
moduł właściwy E/ρ [km $\cdot$ 10 ³]	2,8	3,5	12,4-18,1	8,5-8,8	16	2,6



14

Laminaty

Laminatami nazywane są kompozyty złożone z dwóch materiałów o różnych właściwościach mechanicznych, fizycznych i technologicznych, w których zbrojenie jest układane w postaci warstw (*łac. lamina – cienka blaszka, płytka*)
 Rolę osnowy pełni warstwa adhezyjna.

Warstwy wzmocnienia mogą być w postaci włókien ciągłych ułożonych jednokierunkowo (tzw. rovingu), tkanin lub mat z włókna ciętego.

Laminat, ze względu na swoją strukturę, ma dobrą wytrzymałość w kierunku włókien, ale dużo słabszą w kierunku prostopadłym do warstw.

Typowym naturalnym laminatem jest drewno, w którym wytrzymałe i sprężyste, choć wiotkie włókna celulozowe są spajane w sztywne i odporne tworzywo przez ligninę (drzewnik) o wiele mniej wytrzymałą mechanicznie od celulozy.

Jednym z najpopularniejszych laminatów jest sklejka drewniana.



15

Laminaty znane i wytwarzane są od tysięcy lat. Do najstarszych (ok. V w. p. n.e.) należą laminaty na bazie chińskiej laki (sok z sumaka). Powstawały one zwykle poprzez przesycanie laką wielu cienkich warstw papieru lub tkanin.
 Ze względu na pracochłonność laminaty te były stosowane do produkcji ozdób rzadko do wykonywanie elementów uzbrojenia.

Pierwsze laminaty przemysłowe (początek XX w.) wytwarzane były poprzez prasowanie w wysokiej temperaturze warstw płótna (bawełnianego, konopnego ew. jedwabnego) nasyczonego termoutwardzalną żywicą fenoloformaldehydową.
 Tworzywo to zwane **bakelitem** znalazło liczne zastosowania w elektrotechnice jednak z uwagi na ciężar i koszty wytwarzania obecnie zostało wyparte przez laminaty nowszej generacji oraz tworzywa sztuczne.



16

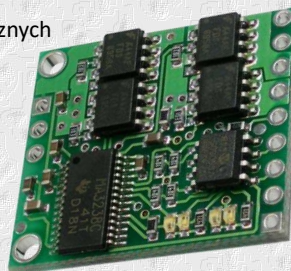
Laminaty na PCB

PCB ([ang.](#) Printed Circuit Board)

- płyta z połączeniami do montażu podzespołów elektronicznych

Do celów elektronicznych stosuje się najczęściej laminaty:

celulozowo – fenolowy
celulozowo – epoksydowy
szklano – epoksydowy
szklano – fenolowy
szklano – teflonowy
ceramiczne



Laminaty te produkuje się w wielu odmianach i grubościach **0,8...3,2 mm** na jedno- i dwuwarstwowe płytki oraz o grubości **0,1...0,76 mm** na obwody wielowarstwowe.

Grubość warstwy metalicznej jest również zróżnicowana i wynosi **0,018...0,105 mm**.

Do najtańszych i najbardziej rozpowszechnionych należy laminat o osnowie celulozowej (papierowej) nasycony żywicą fenolową (celulozowo – fenolowy). Ze względu na swoje właściwości dielektryczne i technologiczne jest głównie stosowany w sprzęcie powszechnego użytku. Wykazuje dużą odporność na wilgoć

17

Laminat o osnowie celulozowej (papierowej) nasycony żywicą epoksydową ma dobre właściwości mechaniczne i elektryczne, nadaje się do wykrawania w temperaturze pokojowej. Jest trudno palny.

Laminat o osnowie z włókien szklanych nasycony żywicą epoksydową ma znacznie lepsze właściwości dielektryczne i mechaniczne od poprzedniego, lecz jednocześnie jest kosztowniejszy. Stosuje się go w sprzęcie profesjonalnym.

Laminat o osnowie z włókien szklanych nasycony żywicą fenolową odznacza się dużą wytrzymałością na zginanie oraz dużą stabilnością wymiarową.

Laminat o osnowie z włókien szklanych związanych z teflonem jest ze względu na swe właściwości, zwłaszcza małą stratnością elektryczną, stosowany w obwodach mikrofalowych.

Laminaty ceramiczne mają zastosowania specjalne zwłaszcza w technice mikrofal

Stosuje się również laminaty elastyczne, które stwarzają korzystne warunki dobrego upakowania elementów w obudowie oraz możliwość łatwej zmiany ich położenia. Laminaty elastyczne składają się wyłącznie z cienkiej folii metalowej związanej z elastyczną folią teflonową, poliamidową i poliestrową.



18

FR-4

Materiał ten ma postać wzmacnianego włóknem szklanym laminatu epoksydowego i jest bardzo popularnym i wszechstronnym termoutwardzalnym tworzywem sztucznym wysokiej jakości.

Produkowany jest zazwyczaj w formie arkuszy, rur lub prętów.

Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, temperaturową i chemiczną przy jednocześnie niskiej gęstości, znikomej nasiąkliwości wodą, dobrymi własnościami elektroizolacyjnymi zarówno w warunkach suchych jak i wilgotnych.

Żywica epoksydowa wzbogacona jest związkami bromu i chloru dzięki czemu uzyskuje ogniotrwałość (samogaśnięcie).

Cechy te powodują, że materiał ten jest stosowany do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i mechanicznych.

Dla potrzeb elektroniki laminat pokrywa się jedno- lub obustronnie cienką warstwą miedzi (folia miedziana).

19

FR-4 - podstawowe parametry

Parametr	wartość
gęstość	1,850 g/cm ³
absorpcja wody	< 0.10%
temperatura pracy	140 °C
przewodność cieplna prostopadła	0,29 - 0,343 W/m·K
przewodność cieplna równoległa	0,81 – 1,059 W/m·K
twardość	110 w skali Rockwella
wytrzymałość na zginanie	> 345 MPa
wytrzymałość na rozciągani	> 310 MPa
wytrzymałość na ściskanie	> 415 MPa
wytrzymałość na udary	> 44 J/m
wytrzymałość na przebicie elektryczne	> 50 kV
wytrzymałość dielektryczna	20 MV/m
względna przenikalność elektryczna	4,8, 4,35 na 500 MHz, 4,34 na 1 GHz
stratność	0,017
moduł Younga	21-24 GPa
wsp. rozszerzalności cieplnej	$\alpha=1,4 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$, $\gamma=1,2 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$, $\alpha=7 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$
wsp. Poissona	0,118 – 0,136
prędkość dźwięku	3369-3902 m/s
impedancja akustyczna	6,64 MRayl

20

W celu uzyskania systemu połączeń folia miedziana, którą pokryte są laminaty poddawana jest najczęściej trawieniu selektywnemu, które polega na chemicznym usunięciu miedzi z obszarów, gdzie jest ona zbędna, czyli z miejsc położonych między ścieżkami przewodzącymi.

Obok trawienia stosowane jest także wycinanie, frezowanie lub odparowanie miedzi przy zastosowaniu wiązki lasera.

Jeśli płytką ma więcej warstw konieczna staje się realizacja połączeń międzywarstwowych

Istnieją co najmniej trzy metody

połączenia mostkowe są kłopotliwe technologicznie, gdyż można ich wykonać w całej płytce zaledwie kilka, zwiększenie zaś liczby mostków komplikuje układ i utrudnia montaż elementów dyskretnych.

połączenia nitowane wymagają stosowania specjalnych urządzeń, a jakość uzyskanych połączeń jest stosunkowo niska ze względu na zawodność ich działania, zwłaszcza w warunkach zmiennej temperatury lub korozyjnego działania środowiska.

metalizowanie otworów jest pod względem technologicznym w produkcji wielkoseryjnej i pod względem niezawodności sposobem najlepszym.

21

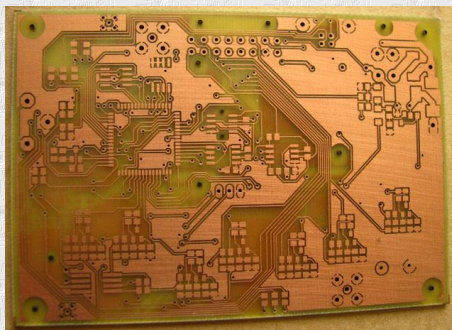
Są dwa rodzaje metalizacji: **kompleksowa** oraz **selektywna**

W metodzie kompleksowej po metalizacji chemicznej następuje metalizacja elektrochemiczna miedzią po czym kopiowany jest negatyw połączeń drukowanych.

W metodzie metalizacji selektywnej najpierw kopiowany jest negatyw połączeń drukowanych, a następnie metalizacja elektrochemiczna miedzią

Dalsze operacje w ww. metodach mają tę samą kolejność:

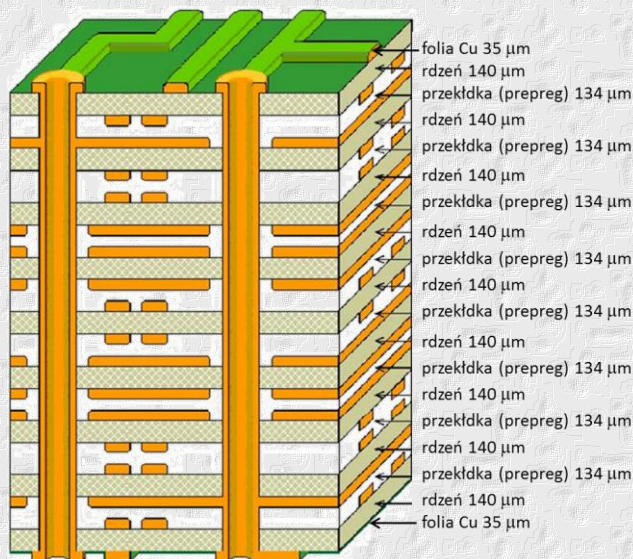
- metalizacja elektrochemiczna stopem Sn-Pb
- usuwanie emulsji ochronnej
- trawienie miedzi



22

PCB wielowarstwowe

Jeśli liczba połączeń jest tak duża, że nie mieszczą się one na jednej lub nawet dwóch powierzchniach laminatu stosuje się laminaty wielowarstwowe

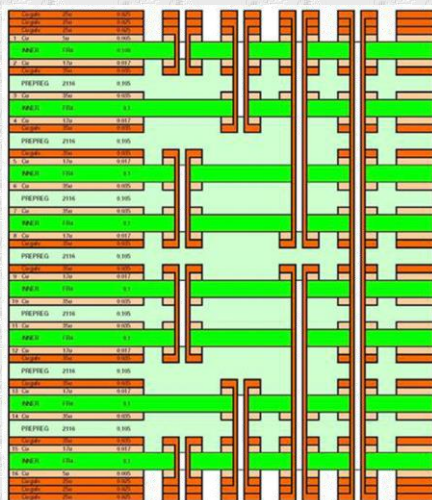


23

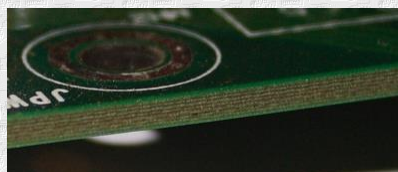
Osiągana obecnie liczba warstw sięga 64

Technologia 16 warstwowa na bazie FR-4

Cu 0,12 mm; izolacja 0,12 mm, otwory 0,2 mm, laminat 2,2 mm



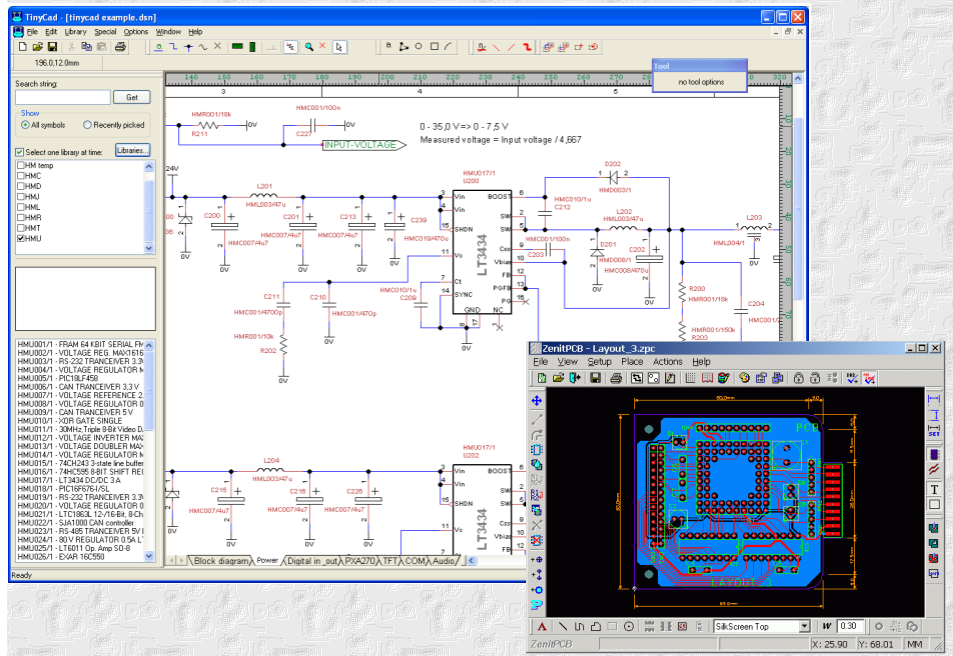
W warstwach pośrednich obok połączeń mogą być także montowane elementy.



Warstwy widać dopiero w powiększeniu

24

Wielowarstwowe PCB projektuje się komputerowo

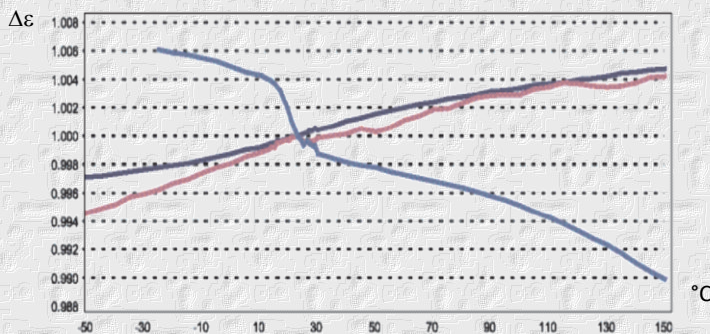


13

Laminaty epoksydowo szklane, zależnie od jakości, mogą być wykorzystywane do częstotliwości rzędu kilku GHz.

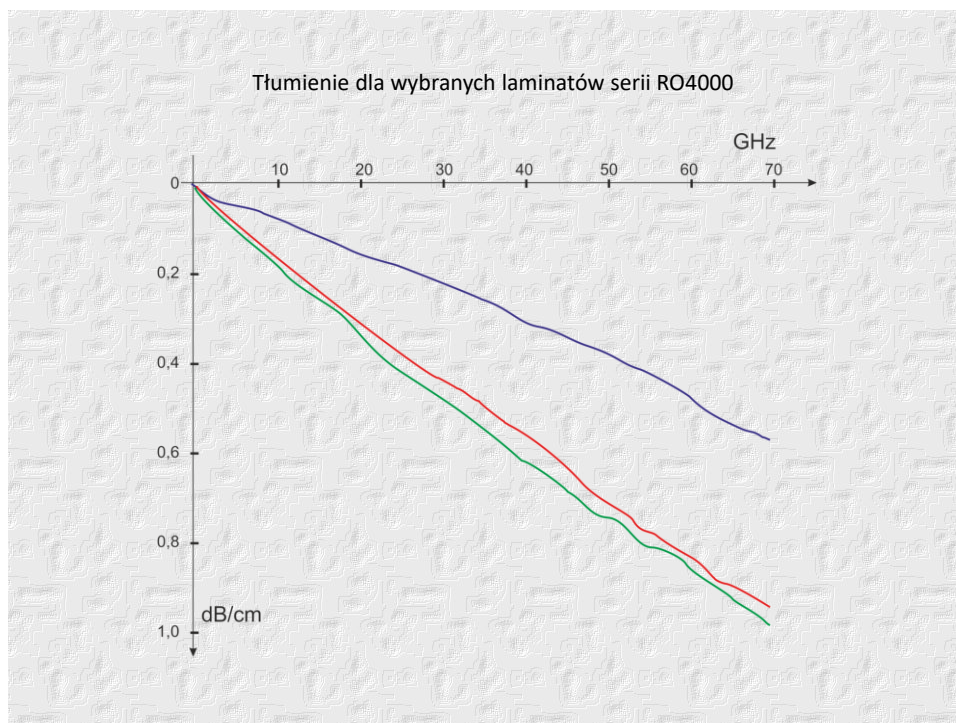
Dla częstotliwości wyższych stosuje się laminaty specjalne, które charakteryzują się stabilnością temperaturową oraz niskimi stratami.

Do najpopularniejszych należą laminaty i handlowych nazwach Duroid i Epsilam oraz różnego rodzaju laminaty ceramiczne.



zmiana przenikalności elektrycznej w funkcji temperatury dla trzech wybranych ceramicznych materiałów mikrofalowych

27



28

Zestawienie podstawowych własności różnych typów laminatów [1]

typ laminatu	maks. temp. pracy	ϵ_r	tg δ przy 1 kHz	absorpcja wody [%] po 24h	wsp. rozszerzalności cieplnej [10^{-6} /K]	zastosowanie
fenolowo-papierowy	120	4,8	0,04	0,65 - 1	25	tania elektronika użytkowa
szklano-epoksydowy	155	5,4	0,035	0,15	16	elektronika półprofesjonalna
szklano-poliestrowy	130	4,3	0,015	0,18	-	elektronika profesjonalna
aramidowo-epoksydowy	125	4,0	-	0,85	4,0	technika mikrofal
szklano-teflonowy (Duroid)	200	2,6	0,001	0,1-1,0	16,5	technika mikrofal
teflonowo-ceramiczny (Epsilam)	280	10,2	0,002	0,5-2,0	25	technika mikrofal

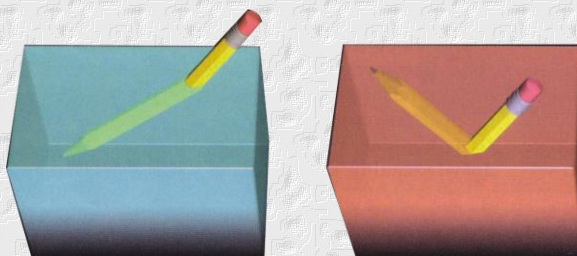
29

Metamateriały

Materiały, których własności zależą od ich struktury w skali większej niż cząsteczkowa.

Mają one szczególne znaczenie w optyce, fotonice i technice mikrofal gdzie ich własności umożliwiają wytwarzanie nieklasycznych typów soczewek, anten, modulatorów i filtrów.

Materiały takie mogą pozwalać na uzyskanie lewoskrętności bądź ujemnego współczynnika załamania



30

Metamateriał zbudowany jest zwykle z regularnej sieci przewodników i rezonatorów o rozmiarach mniejszych niż długość fali elektromagnetycznej, która propagować się ma w tym ośrodku.

